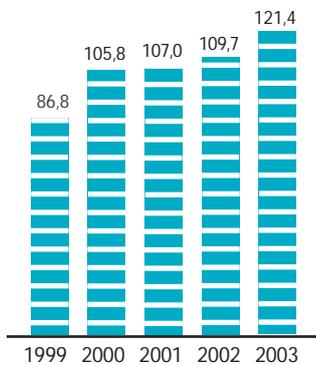


Geschäftsbericht 2003

Konzernangaben nach US-GAAP

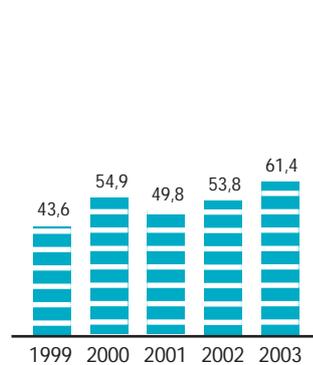
Umsatzerlöse

in Mio. Euro



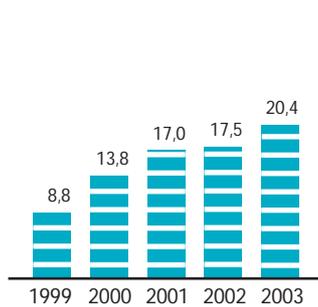
Bruttoergebnis vom Umsatz

in Mio. Euro



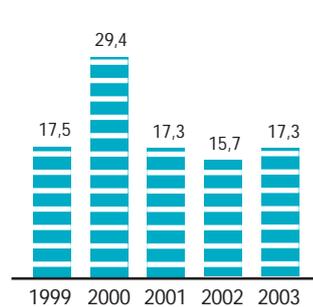
Forschung und Entwicklung

in Mio. Euro



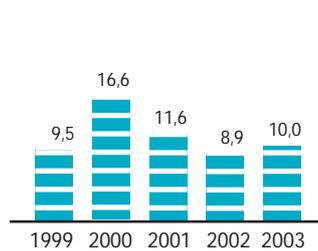
Ergebnis vor Ertragssteuer

in Mio. Euro



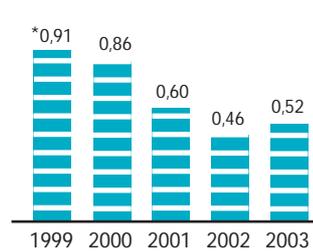
Jahresüberschuss

in Mio. Euro



Ergebnis pro Aktie

in Euro



*IPO im Okt.

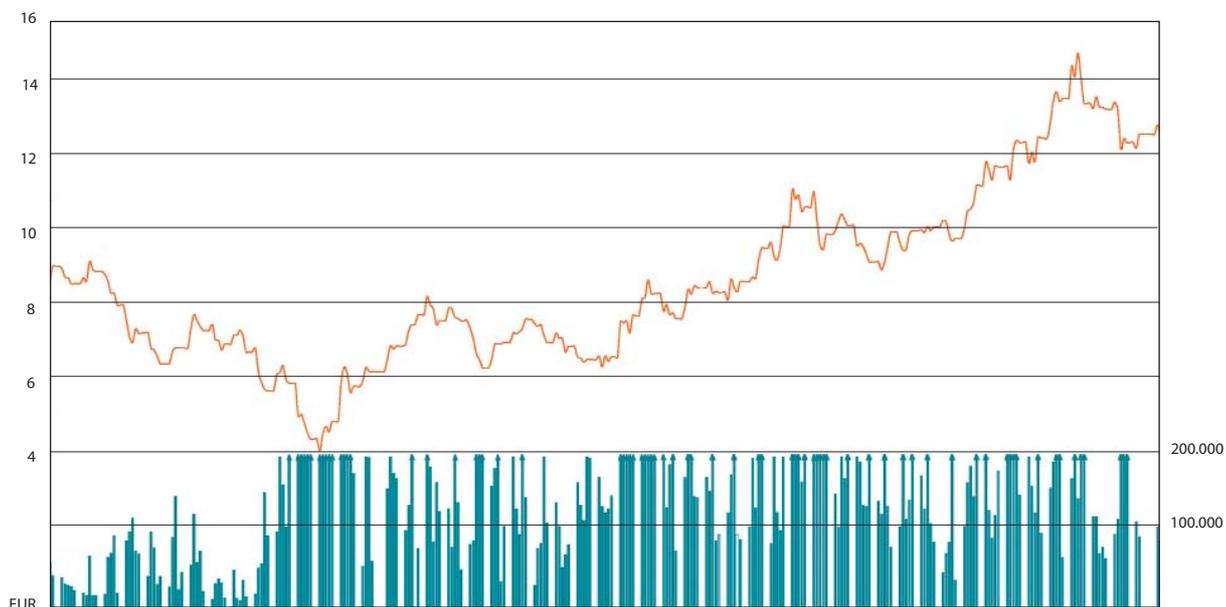
Ausgewählte Konzernzahlen nach US-GAAP

	2003	2002	2001	2000	1999
Umsatzerlöse in Mio. Euro	121,4	109,7	107,0	105,8	86,6
Herstellkosten in Mio. Euro	60,0	55,9	57,3	50,9	42,9
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. Euro	61,4	53,8	49,8	54,9	43,6
Forschungs- und Entwicklungskosten in Mio. Euro	20,4	17,5	17,0	13,8	8,8
Betriebsergebnis in Mio. Euro	21,6	18,3	17,0	27,7	23,3
Ergebnis vor Ertragssteuern in Mio. Euro	17,3	15,7	17,3	29,4	17,5
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag in Mio. Euro	6,9	6,7	5,8	12,6	7,7
Jahresüberschuss in Mio. Euro	10,0	8,9	11,6	16,6	9,5
Eigenkapital in Mio. Euro	124,7	112,4	113,1	120,0	112,7
Bilanzsumme in Mio. Euro	205,3	208,5	208,0	188,5	155,9
Ergebnis je Aktie in Euro	0,52	0,46	0,60	0,86	*0,91
Dividende je Aktie in Euro	**0,13	0,00	0,00	0,91	0,45
Mitarbeiter im Jahresmittel	874	830	624	514	477
Aktienkurs per 31. Dezember in Euro	12,40	8,05	14,50	25,50	41,00
Anzahl der Aktien per 31. Dezember in Mio. Stück	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3
Marktkapitalisierung per 31. Dezember in Mio. Euro	239	155	280	492	791

* IPO im Oktober 1999

** vorbehaltlich des Beschlusses der Hauptversammlung

Kurs und Handelsvolumen 2003



Stammdaten zur Aktie

Angaben zum Unternehmen

Sitz der Gesellschaft	Dortmund
Gründung	1984
Gezeichnetes Kapital per 31. Dezember 2003	19.300.000 Euro

Angaben zur Aktie

Aktienart	Inhaber-Stammaktien ohne Nennbetrag
ISIN	DE0005677108
WKN	567 710
Börsenkürzel	ELG
Heimatsbörse	Frankfurt
Marktsegment	Prime Standard
Indezugehörigkeit	TecDAX 30
Aktienbesitz	42,3 % Streubesitz 57,7 % EFH ELMOS Finanzholding GmbH
Designated Sponsors	HSBC Trinkaus & Burkhardt West LB Equity Markets

Daten zur Emission

Notierungsaufnahme	11. Oktober 1999
Angebotene Aktien	6.500.000 Stück Stammaktien ohne Nennbetrag, davon 4.000.000 Stück aus Kapitalerhöhung 2.500.000 Stück aus dem Besitz der EFH
Mehrzuteilungsoption	1.000.000 Stück aus dem Besitz der EFH, ausgeübt
Emissionskurs	22 Euro
Konsortialbanken	Gemeinsame globale Koordinatoren Crédit Suisse First Boston Deutsche Bank Konsorten Société Générale West LB

Equity Research über ELMOS

Baden-Württembergische Bank	Rüdiger Kühnle
Bank Vontobel	Bruno Winiger
Berenberg Bank	Dr. Oliver Wojahn
Crédit Agricole Indosuez Cheuvreux	Bernd Laux, Yasmin Majewski
Crédit Suisse First Boston	Jean Danjou, Antoine Badel
Dresdner Kleinwort Wasserstein	Annett Weber
DZ-Bank	Harald Schnitzer
HSBC Trinkaus & Burkhardt	Thorsten Zimmermann
ING BHF Bank	Manuel Deimel
*Kepler Equities	Ingo Queiser
KBC Peel Hunt	Isabell Friedrichs, Robert Willis
MainFirst Bank	Thomas Kessler
Merrill Lynch	Mark Power
M.M.Warburg & Co	Michael Bahlmann
Landesbank Rheinland-Pfalz	Thomas Hofmann
Puilaetco de Laet, Poswick & Cie.	Philippe Rochez
SES Research	Oliver Drebing
UBS Warburg	Laura Baker
West LB Equity Markets	Dr. Karsten Iltgen

* ehemals Bank Julius Bär

Editorial	4
Brief an die Aktionäre	9
Bericht des Vorstands	13
Gesamtwirtschaftliche Lage	13
Strategie und Geschäftsmodell	14
Tochterfirmen	17
Unternehmenssituation	18
Kunden und Produkte	19
Finanzlage	23
Investitionen	23
Forschung und Entwicklung	24
Personal- und Sozialbereich	24
Qualität und Umwelt	25
Risiko und Corporate Governance	25
Aktionärsstruktur	26
Ausblick	26
Vorstand der Gesellschaft	27
Investor Relations	31
Bericht des Aufsichtsrates	37
Mitglieder des Aufsichtsrates	39
Jahresabschluss nach HGB	43
Bericht zur Lage der Gesellschaft	59
Geschäft und Strategie	59
Lage der Gesellschaft	63
Risikobericht	65
Prognosebericht	68
Beziehungen zu verbunden Unternehmen	69
Abschluss nach US-GAAP	73
Glossar	99
Finanzkalender / Impressum	101







Mit Menschen, die nicht auf demselben Weg wandeln wie Du selbst, solltest Du keine gemeinsamen Pläne schmieden.

Konfuzius

Verbindungen und Perspektiven

Elmos wird 20.

Ein jungliches Alter: belastbar, strebsam, unverbraucht, wissbegierig, energiegeladen, voller Elan, aufnahmefähig, mobil, flexibel – ein Alter, das viele Hoffnungen verheißt, ein Alter mit Perspektiven.

So fing es an:

Drei Visionäre mit Spürsinn, Unternehmergeist und Umsetzungskraft finden sich; ein Naturwissenschaftler, ein Unternehmensberater und ein Unternehmer. Sie verbindet eine großartige Idee: Die Entwicklung mikroelektronischer Schaltungen auf Siliziumbasis und deren Produktion in kleinen Stückzahlen für die sie einen Markt entdeckt haben, einen Markt mit Perspektiven. Eine nachhaltige Verbindung.

So läuft es:

Der ganzheitliche Ansatz als Kreislaufprozess. Das Unternehmen erfasst Kundenwünsche, entwickelt Lösungen als reife Prototypen, setzt sie in Produkte mit höchster Qualität um und bringt sie auf den Markt. So schließt sich der Kreislauf: Kundenbedarf - Entwicklung - Produkt - Markt. Kundennähe, exzellente Entwicklungsarbeit und Passgenauigkeit der Produkte bilden eine Unternehmensstrategie mit Perspektiven. Sie schafft eine enge Verbindung zwischen Kunden und Unternehmen.

So ist es:

Die Gründeridee ist verwirklicht und optimiert, steht jetzt als prosperierendes Unternehmen mit erstklassiger Kompetenz, weltweiter Reputation wegen seines hohen technischen Kenntnis- und Fertigungsstandes, hat ausgezeichnete Perspektiven. Sein Erfolg ist programmiert.

Neue Signale sind gesetzt: Die ELMOS Semiconductor AG ist an der deutschen Börse (TecDax 30) gelistet. Als Unternehmen, dessen Kurs einen signifikanten Aufwärtstrend verzeichnet.

*Wer sich nicht über seine Zukunft Gedanken macht,
der wird sich bestimmt bald über sein Heute sorgen müssen.*

Konfuzius

Auf was bauen wir?

Das Vertrauen unserer Kunden, die auf kontinuierliche und progressive ELMOS-Entwicklungen mit höchster Qualität setzen, ist Grundstein unserer gesamten Arbeit und Grundlage unseres wachsenden Umsatzes und steigenden Gewinns.

Unsere anerkannte fachliche Kompetenz in der Halbleiterbranche ist Konsequenz eines hochengagierten und leistungsstarken Mitarbeiterstammes mit hohem entwicklungs- und fertigungstechnischen Know-how auf aktuellem wissenschaftlichen Stand.

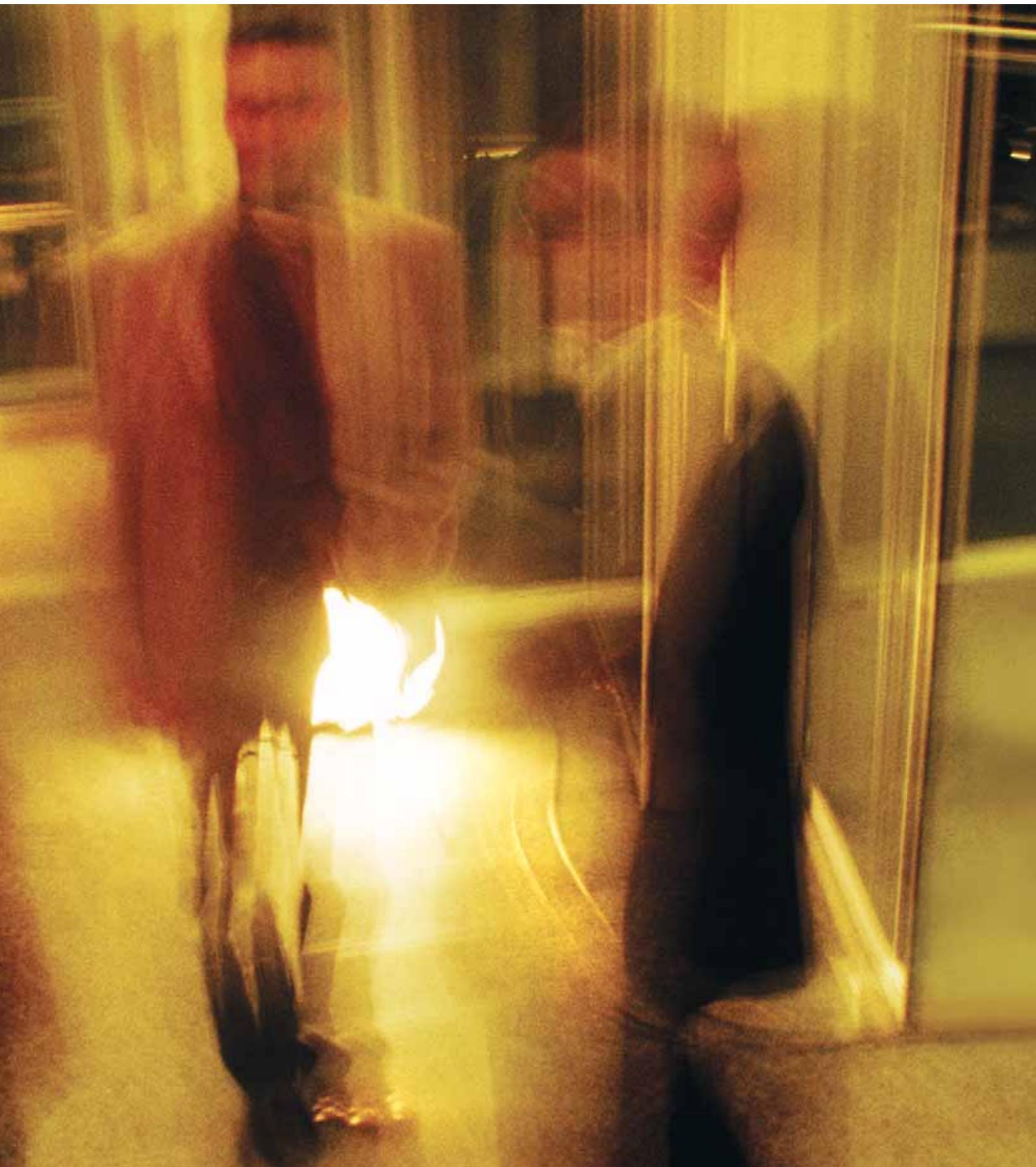
Als Marktführer für kundenspezifische Schaltkreise müssen wir der Konkurrenz entwicklungstechnisch immer voraus sein. Wir folgen nicht dem technischen Fortschritt, sondern bestimmen ihn mit unserer technologischen Kompetenz.

Wir folgen dem Grundsatz: Alles aus einer Hand, nutzen die aus den Verbindungen resultierenden Synergieeffekte und kommen damit den Wünschen unserer Kunden entgegen, deren Vertrauen wir mit anderen Produkten bereits gewonnen haben.

Das Segment kundenspezifische Schaltkreise in der Halbleiterbranche ist nicht nur an vielen Kundenstandorten in der Bundesrepublik von großem Interesse, sondern darüber hinaus ebenso in Europa und zunehmend auch für die US-amerikanische und asiatische Industrie. ELMOS ist flexibel und folgt der expandierenden Nachfrage mit der Ausweitung seines Produktions- und Vertriebsnetzes.

In diesem Sinne erwarten wir auch für die nächsten Jahre eine erfolgreiche Entwicklung.







Das Gründerteam

Schon beinahe Geschichte: Die Verbindung dreier höchst unterschiedlicher Menschen, die ELMOS ins Leben rufen: ein Unternehmer, ein Universitätsprofessor und ein Unternehmensberater gründen in Dortmund auf der grünen Wiese ein Unternehmen. Es soll mikroelektronische Schaltungen auf Siliziumbasis entwickeln und herstellen. Die Idee, Halbleiterchips in mittleren Stückzahlen selbst zu produzieren, entstand, weil die etablierte Industrie damals keine individuellen Lösungen in geringen Stückzahlen anbieten kann und will. Alle drei sind miteinander verbunden durch ihre zukunftssträchtige Idee, ihr fachliches Know-how und ihre ambitionierte Durchsetzungskraft.

Liebe Aktionäre,

wir sind mitten in einem neuen Halbleiterboom. Für 2004 ist ein Wachstum des Halbleitermarktes von ca. 23 Prozent vorausgesagt; 2005 sollen dann weitere 13 Prozent folgen. In der letzten Woche kam dann passend eine Pressemeldung der Infineon AG, dass bereits das Bestellvolumen des ersten Quartals um rund 10 Prozent über der Lieferkapazität läge und dass erfreulicherweise auch die Preise wieder anziehen werden. Ist damit alles in bester Ordnung?

Wir sehen die Situation differenzierter! Im Jahr 2000 lag der Halbleiterumsatz bei etwa 204 Milliarden USD, um dann dramatisch um 32 Prozent auf rund 139 Milliarden USD einzubrechen. Die Folge waren erhebliche Kapazitätsanpassungen, die vielfach Arbeitsplätze vernichteten und zu hohen Verlusten der betreffenden Unternehmen führten. Selbst heute werden noch hochmoderne, aber leere Fabriken zum Verkauf angeboten. 2002 war ein bescheidenes Wachstum um 2 Prozent auf 141 Milliarden USD zu verzeichnen, dem mit einem Plus von 18 Prozent auf 166 Milliarden USD ein gutes Jahr 2003 folgte. Folgen wir den realistischen Prognosen für die Jahre 2004 und 2005, so wird der Gesamtmarkt dann bei rund 231 Milliarden USD liegen. Im Fünfjahreszeitraum wird er dann um 13 Prozent oder durchschnittlich nur 2,5 Prozent pro Jahr gestiegen sein.

Ein wachstumsorientiertes Halbleiterunternehmen wie ELMOS kann bei derartigen Nachfrageschwankungen nicht überleben; hohe Verluste, die kein Kapitalgeber bereit wäre zu finanzieren, wären die Folge. Wir müssen andere Strategien, Technologien, Märkte und Produkte suchen, die ein langfristiges Wachstum von mehr als 20 Prozent p.a. ermöglichen. Im Bereich Automobilelektronik sehen wir ein derartiges großes Marktpotenzial, dass wir deshalb unsere Entwicklungskapazitäten von 1999 bis 2003 mehr als verdoppelt haben. Heute arbeiten weltweit über 150 Entwicklungsingenieure daran, ELMOS-Prozess- und Designtechnologien vor allem in kundenspezifische Produkte umzusetzen. Unser Erfolg sind 132 neue Entwicklungsprojekte mit einem zukünftigen Produktionsvolumen von mehr als 1 Milliarde Euro. Im gleichen Zeitraum 1999 bis 2003 hatten wir Produk-

tionsumsätze von rund 531 Millionen Euro erzielt, dies entspricht einer Wachstumsrate von durchschnittlich rund 25 Prozent p.a. Damit sind wir für die Zukunft gut gerüstet, wir werden im Kernbereich Halbleiter sehr gute Jahre vor uns liegen haben.

Der Kauf der Silicon Microstructures, Inc., (SMI), und der European Semiconductor Assembly B.V. (eurasem) erweitert unser Technologiepotenzial erheblich. Dies wird von unseren Kunden erkannt und honoriert. SMI hat im Jahr 2003 ein Wachstum von rund 56 Prozent realisiert. Wir konnten für SMI sehr große Mikromechanik-Entwicklungsprojekte im Automobilbereich gewinnen, was deutlich über unseren Erwartungen lag. eurasem war bedauerlicherweise nicht so erfolgreich. Obgleich der Umsatz verdoppelt werden konnte, haben wir die wirtschaftlichen Ziele 2003 klar verfehlt und werden 2004 durch Kostensenkungsmaßnahmen und Aufbau von Testmöglichkeiten die Wertschöpfung erhöhen.

Die starke Wachstumsorientierung konnten wir uns nur erlauben, weil wir zwischen 2001 und 2003 die Bruttomarge von 47 Prozent auf fast 51 Prozent vom Umsatz ausweiten konnten. So war es uns möglich, im gleichen Zeitraum die Entwicklungsaufwendungen um fast 20 Prozent auf über 20 Millionen Euro oder rund 17 Prozent vom Umsatz zu steigern, ohne eine solide und starke Ertragsorientierung aus dem Auge zu verlieren. Mit einem Ergebnis von mehr als 10 Millionen Euro nach Steuern stieg unsere Eigenkapitalquote im Konzern auf rund 61 Prozent an.

Wir erwarten bis Mitte des Jahres mit dem Fraunhofer-Gesellschaft in München durch eine Vertragsvereinbarung dahingehend zu gelangen, dass uns die in Duisburg befindliche 200mm-Wafer Halbleiterlinie zur Kapazitätserweiterung der ELMOS ab 2006 zur Verfügung steht. Damit werden wir unser Wachstum 2007 und 2008 mit moderaten Zusatzinvestitionen – ohne externe Kapitalmarktmaßnahmen – realisieren können.

Wir sind von unserem Weg überzeugt und möchten uns für Ihr Vertrauen bedanken.

Knut Hinrichs
Vorstandsvorsitzender







Der Standort Dortmund

Man hätte ELMOS überall ansiedeln können, denn die drei Gründer zeichnen sich durch hohe Flexibilität und Mobilität aus. Damals treibt die Montankrise ihrem Höhepunkt entgegen. Mit dem Niedergang der Stahlindustrie versuchen die Städte des Ruhrgebiets durch Ansiedlung neuer Unternehmen den notwendigen Strukturwandel einzuleiten. Dortmund entschließt sich, auf High-tech zu setzen. Diese Stadt und das Land Nordrhein-Westfalen offerieren dazu höchst attraktive Angebote und Bedingungen. So werden in der Nähe der Uni ein Technologiepark und ein Technologiezentrum eingerichtet. Nicht zuletzt tragen eine günstige Anschubfinanzierung durch das Land NRW, die Stadt, ortsansässige Banken und private Risikokapitalgeber mit innovativen Bauherrenmodellen einen erheblichen Teil zum erfolgreichen Start bei.



Gesamtwirtschaftliche Lage

Mit dem Jahr 2003 ist ein politisch und wirtschaftlich sehr schwieriges Jahr zu Ende gegangen. Besonders das erste Halbjahr war von starker Ungewissheit, von internationalen Konflikten und Krisen mit ungewissem Ausgang geprägt. Der Irak-Krieg und die SARS-Angst führten zu Tiefstständen der Kurse an den Aktienmärkten. Im zweiten Halbjahr entschärften sich diese Spannungen und die Konjunktur entwickelte sich überraschend positiv. Vor allem in den USA kam der Aufschwung in Gang, der allerdings mit einem deutlichen Kursverlust des Dollars einherging. Für die exportorientierten Branchen der Bundesrepublik Deutschland verdüsterte sich damit das Bild.

Positive Zukunftserwartungen führten dazu, dass zum Jahresende an allen Wertpapierbörsen der Welt Höchststände notiert wurden, wobei besonders die Technologiewerte profitierten.

Für den Halbleitermarkt war 2003 nach zwei extrem schwierigen Jahren erstmals wieder ein Jahr des Wachstums. Nach den Verunsicherungen des ersten Halbjahres entwickelte sich das zweite Halbjahr sehr erfreulich. Bezogen auf das Gesamtjahr bedeutet dies 2002 ein Wachstum von 18 Prozent (139,0 Milliarden USD) und auf 166,4 Milliarden USD im Jahr 2003. Die allgemeine Erholung, die von den dominierenden Marktsegmenten Datenverarbeitung, Telekommunikation und Consumer ausging, spiegelt sich in den Kursgewinnen der Halbleiteraktien wider. Der Erneuerungsbedarf bei Geräten der Datenverarbeitung und Telekommunikation und die allmählich schwächer werdende Verbraucherzurückhaltung treiben den Aufschwung an. Dadurch stieg die Auslastung der weltweiten Halbleiterfertigungskapazitäten wieder auf Werte wie im Spitzenjahr 2000. Mitgezogen wurden auch die Zulieferfirmen für Halbleiterfertigungseinrichtungen, die erstmals wieder an wachsenden Investitionen der Branche partizipieren konnten.

Die für EL MOS als Halbleiterlieferant sehr wichtige Automobilindustrie hatte ebenfalls kein einfaches Jahr. Die Prognosen, insbesondere für den amerikanischen Markt, waren eindeutig negativ und auch in

Europa wurde mit einem Rückgang von einigen Prozent gerechnet. So zeigten sich aber die Zulassungen in den USA mit 16,5 Millionen Fahrzeugen nur um 2 Prozent unter dem schon schwachen Vorjahreswert. Allerdings verloren die US-Hersteller GM, Ford und Chrysler weiter deutlich an Marktanteil gegenüber der europäischen und asiatischen Konkurrenz.

In Europa konnte mit 14,2 Millionen Zulassungen ein Rückgang um 1 Prozent beobachtet werden, der allerdings stark durch den um 6 Prozent schwächeren französischen Markt beeinflusst wurde. Diese insgesamt negative Entwicklung wurde größtenteils durch das Wachstum in Fernost, vor allem in China, kompensiert, so dass der Weltmarkt insgesamt nur geringfügig um rund 1 Prozent schrumpfte.

Die deutschen Premium-Hersteller entwickelten sich unterschiedlich. BMW konnte seine Erfolge mit 1,1 Millionen verkauften Fahrzeugen fortschreiben, d.h. einem Zuwachs von fast 5 Prozent. Darin steckt ein Absatzplus von rund 2 Prozent für die Marke BMW und 22 Prozent für die Marke Mini. Bemerkenswert ist außerdem, dass die Marke BMW im vierten Quartal um 18 Prozent zulegen konnte, wohl als Folge der neuen Modelle der 5er und 6er Serie und des X3. DaimlerChrysler hatte ein schwieriges Jahr mit einem Absatzrückgang um 4 Prozent auf 3,8 Millionen Fahrzeuge. Vor allem Chrysler erlitt Einbußen von 5 Prozent, aber auch Mercedes konnte sich mit minus 2 Prozent diesem Trend nicht vollständig entziehen. Audi war erfolgreich mit einem Plus von 4 Prozent und auch VW konnte trotz der weltweit flauen Märkte wieder mehr als 5 Millionen Autos absetzen.

Wichtig ist hier zu bemerken, dass das Umsatzwachstum der Automobilelektronik weniger aus dem Fahrzeug-Wachstum als viel mehr aus der zunehmenden Elektronikausstattung der Autos generiert wird. Die immer höheren Anforderungen an Umweltverträglichkeit, Sicherheit und Komfort sowie der zunehmende Ersatz mechanischer Funktionen durch Elektronik geben hierfür den Ausschlag.

Der automobilen Halbleitermarkt zeigt daher eine wesentlich höhere Stabilität. Er zeichnet sich durch lange Produktlebensdauern und höchste Qualitätsanforderungen aus. Außerdem ist er durch langfristige



Kunden-Lieferanten-Beziehungen und hohe Planungssicherheit infolge der langen Produktlebensdauer gekennzeichnet. Dieser Markt umfasst nur rund 6 bis 8 Prozent des Gesamtmarktes und betrug im Jahr 2000 rund 14,1 Milliarden USD. Durch Abbau der Vorräte der Jahre 2000 und 2001 reduzierte sich der Gesamtmarkt um rund 10 Prozent auf 12,6 Milliarden USD in 2001, stieg in der Folge 2002 um rund 5 Prozent verhalten wieder an und erreichte 2002 13,3 Milliarden USD. Im Jahr 2003 war erneut ein moderates Wachstum von rund 5 Prozent auf 13,8 Milliarden USD zu verzeichnen. Während im Betrachtungszeitraum 2000 bis 2003 der automobiler Halbleitermarkt um 2 Prozent gefallen ist, erhöhten sich die Umsatzerlöse der ELMOS um 15 Prozent.

Das Marktsegment der kundenspezifischen Halbleiterschaltkreise, sogenannte ASICs, ist wegen der vergleichsweise geringen Jahresstückzahlen (0,1–10 Millionen p.a.) nicht im Fokus der großen Halbleiterhersteller, sondern wird von kleinen und mittleren Firmen bedient. ELMOS zielt dabei insbesondere auf Mixed-Signal-ASICs für automobiler Anwendungen. Die Wettbewerber dort sind vor allem Bosch und Melexis. Die Übernahme der Mietec in Belgien von Alcatel durch AMI Semi hat einen weiteren Wettbewerber im Markt entstehen lassen.

Weiter verstärkt hat sich 2003 der Druck der Kunden in Bezug auf Übernahme von Forschungs- und Entwicklungsarbeiten sowie von Systemverantwortung

durch die Lieferanten. Im ASIC-Markt bedeutet dies, dass nur in abnehmendem Maße die Kunden zur Finanzierung von Auftragsentwicklungen bereit sind, d.h. ein Großteil der Produktentwicklungskosten vom Halbleiterhersteller vorfinanziert werden müssen und erst über die Serienproduktion amortisiert werden können. Darüber hinaus werden immer mehr Systementwicklungen von den Fahrzeugherstellern in die Hände der Systemzulieferer (OEM) gelegt, die nun ihrerseits Systemverantwortung an ihre Zulieferer, also die Halbleiterhersteller weitergeben. Dies stellt einerseits ein Problem, aber andererseits auch eine Chance dar, da der Halbleiterhersteller eigenes Know-how und eigene Innovationskraft einbringen und dadurch seine Wettbewerbsposition verbessern kann.

Strategie und Geschäftsmodell

Die ELMOS Semiconductor AG entwickelt, produziert und vertreibt anwendungsspezifische mikroelektronische Schaltkreise (ASICs = Application Specific Integrated Circuits) vornehmlich für die Automobilindustrie. Auch im Jahr 2003 entfallen ca. 91 Prozent des Umsatzes auf dieses Marktsegment. ELMOS hat sich in den vergangenen Jahren eine führende Marktposition im europäischen Markt für Automobilelektronik erarbeitet und wird von Gartner-Dataquest als weltweite Nr. 3 im Segment „Automotive ASIC“ gesehen.

Halbleiterhersteller für den Automobilbereich nach weltweiten ASIC-Umsätzen 2002

Rang	Firma	2001 mUSD	2002 mUSD	Wachstum 2001-2002	Anteil 2002
1	NEC Electronics	114	121	6 %	15%
2	Philips Semi	93	97	4%	12%
3	ELMOS Semi	83	85	2%	11%
4	AMI Semi	19	84	342%	11%
5	Melexis	49	55	12%	7%
	Andere	368	349	-5%	44%
	Summe	726	791	9%	100%

Quelle: Gartner 2003

ASICs von ELMOS werden von nahezu allen europäischen Fahrzeugherstellern eingesetzt und sind ideale Systeme für die Verbesserung der Umweltverträglichkeit eines Kraftfahrzeugs sowie die Sicherheit und den Komfort der Fahrzeuginsassen kompakt, zuverlässig und kostengünstig aufzubauen.

Seit Firmengründung gilt die ELMOS-Strategie, mit eigenem Know-how geschützte Nischenmärkte zu bedienen. Dies unterscheidet ELMOS signifikant von den Wettbewerbern. Hier hat ELMOS sowohl durch die automotive-gerechte Hochvolt-CMOS-Technologie als auch durch die systemgerechte Integration von analogen und digitalen Funktionen mit On-Chip Treiberleistungen ein herausragendes Instrumentarium, um sich als Unternehmen zu profilieren. Diesem Anspruch werden die Entwicklungsingenieure von ELMOS dadurch gerecht, dass sie durch die Ausweitung des Entwicklungsumfangs einen Mehrnutzen für den Kunden im Vergleich zu den Standard- bzw. Applikationsspezifischen-Schaltkreisen offerieren. Die ELMOS Profitabilität resultiert aus der gelebten Win-Win-Beziehung mit dem Kunden, wobei die kundenspezifische Integration über den Produktlebenszyklus von mindestens fünf bis zu 20 Jahren der ELMOS als Alleinversorger eine stabile Auslastung gewährt.

Dieses Geschäftsmodell erfordert eine enge Kunden-Lieferantenbeziehung, die sich in der verteilten Struktur von Niederlassungen, Tochterfirmen und

Partnerfirmen für die Vertriebs- und Applikationsunterstützung widerspiegelt.

In Europa sind dies die Niederlassungen in München und Stuttgart und die Tochterfirmen ELMOS France und GED ebenso wie die Partner DMOS, MAZ, MECHALESS. ELMOS NA bedient den nordamerikanischen Markt von ihrem Sitz Detroit aus, dem Zentrum der amerikanischen Automobilindustrie.

Die produzierenden Tochterfirmen eurasem in den Niederlanden und SMI in den USA erweitern das ELMOS-Technologie- und Produktportfolio durch spezielle Gehäusetechnologien bzw. mikro-mechanische Bauelemente, sogenannte MEMS, die bevorzugt in der Sensorik eingesetzt werden.

eurasem European Semiconductor Assembly B.V. ist ein hochqualifizierter Dienstleister für die Halbleiterindustrie. eurasem entwickelt und fertigt Gehäuse für elektronische Halbleiterkomponenten und Sensoren. Neben Standard-JEDEC Gehäusen gehören insbesondere kunden- und applikationsspezifische Spezialgehäuse zum Produktportfolio der eurasem.

SMI Silicon Microstructures, Inc., in Kalifornien, USA, bietet die Entwicklung und Herstellung von MEMS-Sensoren an. SMI ist im Sensorgeschäft gut etabliert und zählt zu den Technologieführern im Bereich der hochpräzisen Drucksensoren in Silizium.





Neben Drucksensoren entwickelt SMI unter anderem auch Sensoren für Beschleunigung und Drehbewegungen, die speziell für die Automobilindustrie hochinteressant sind.

Durch diese sich ergänzenden Angebote ihrer Tochterfirmen kann ELMOS den wachsenden Kundenwünschen nach erweiterter Übernahme von Systemverantwortung durch den Lieferanten entsprechen. Gleichzeitig kann ELMOS die eigene Marktnische erweitern, indem mikromechanische Sensoren und signalverarbeitende ASICs in einem speziellen Gehäuse zu einem anwendungsspezifischen mechatronischen Modul zusammengefasst werden. Diese Produkte werden von ELMOS unter dem Logo „ASIC *plus* - more than a chip“ vermarktet.

Derartig innovative Lösungen werden beispielsweise zur Reifendrucküberwachung gefordert. Hier spielen Baugröße, Robustheit, einfache Montage und Wettbewerbsfähigkeit eine wichtige Rolle.

Neben dem Kerngeschäft im automobilen Markt ist ELMOS auch in anderen Märkten tätig. Hierbei operiert ELMOS stets aus einer geschützten Position heraus, die entweder durch die eingesetzte Hochvolt-CMOS-Technologie oder ein spezielles Anwendungs-Know-how entsteht. In der Regel sind diese wettbewerbsdifferenzierenden Merkmale durch Patente geschützt.

Das zukünftige Wachstum der ELMOS-Gruppe steht somit auf mehreren Säulen:

- konsequenter Ausbau des Kerngeschäftes durch wachsende Designkompetenz
- zunehmende Übernahme von Applikationsunterstützung und Systemverantwortung
- Entwicklung und Lieferung von innovativen mechatronischen Modulen
- weitere Erschließung des amerikanischen und später des asiatischen Marktes

ASIC <i>plus</i> - more than a chip	SMI	ELMOS Semi	eurasem
Applikation	Sensor	Elektronik	Verpackung (Package)
Reifendruck Überwachung	Drucksensor	Mikrocontroller Signalaufbereitung Signalübertragung (RF)	Funktionales Gehäuse ggf. pre-molded Gehäuse
	<i>ggf. auch als co-integrierte</i>	<i>Version Sensor + ASIC</i>	
Luftdruckmessung im Ansaugkanal (Motorsteuerung)	Drucksensor	Mikrocontroller Signalaufbereitung Kommunikations-Schnittstelle	Cavity-molded Gehäuse Pre-molded Gehäuse
	<i>ggf. auch als co-integrierte</i>	<i>Version Sensor + ASIC</i>	
Diebstahlwarnanlage Neigungssensorsystem	xy-Beschleunigungssensor (low-g)	ASIC	Duroplast Gehäuse mit Stressentkopplung
Airbag-Sensorsystem	Beschleunigungssensor (high-g)	Signalaufbereitung Codierung Kommunikations-schnittstelle	Kundenspezifisches funktionales Gehäuse mit Stressentkopplung
Mechatronische Zündmodule	–	SOI-ASIC	Leadframe-basierendes Spezialgehäuse, ggf. zusätzliche Passiv-Komponenten

Tochterfirmen

ELMOS France

ELMOS France ist die erfolgreichste ausländische Tochterfirma der ELMOS AG. In Nanterre am Stadtrand von Paris gelegen, betreut ELMOS France den wichtigen Regionalmarkt Frankreich und bietet Applikations- und Designunterstützung mit derzeit 12 Mitarbeitern vor Ort.

ELMOS North America

Die ELMOS North America mit Sitz in Farmington-Hills bei Detroit beschäftigte 2003 zum Jahresende 24 Mitarbeiter. ELMOS NA ist ein Designhaus, das die amerikanischen Kunden vor Ort bedient.

eurasem

eurasem B.V. in Nijmegen, Niederlande, ist ein hochspezialisierter Assembler für die Halbleiterindustrie und bietet als Dienstleistung die Häusung und Verkapselung von Bauelementen an. Damit steht eurasem im direktem Wettbewerb zu den großen Assembly-Firmen in Fernost. Neben Standardgehäusen für ELMOS bietet eurasem auch kundenspezifische Spezialgehäuse an, die sich teilweise durch patentiertes Know-how vom Wettbewerb absetzen können. Dadurch ist eurasem ein wichtiges Element der ELMOS Strategie „ASIC *plus*“, die auf intelligente Module mit mikromechanischen Sensoren und ASICs in einem anwendungsspezifischen Gehäuse zielt. eurasem beschäftigte zum Jahresende 161 Mitarbeiter.

In den vergangenen Jahren wurden die Betriebs-einrichtungen von eurasem nach dem modernsten Stand der Technik ausgebaut. Zum Jahresende deckte eurasem etwa 54 Prozent der Assembly-Leistungen für ELMOS ab und verarbeitete etwa 4 Millionen Bauteile im Monat.

Im Jahr 2003 wurde der Umsatz von 7,0 Millionen Euro im Vorjahr auf 11,3 Millionen Euro nahezu verdoppelt. Darin enthalten waren 6,9 Millionen Euro Dienstleistungen für ELMOS und etwa 4,4 Millionen Euro Leistungen für Dritte.

Zur Ergebnisverbesserung wurde eine Neuausrichtung des eurasem-Geschäftsmodells vorgenommen.

Interne Kosteneinsparungspotenziale sollen durch die Zusammenfassung von Funktionseinheiten mit ELMOS realisiert werden. eurasem wird in Zukunft verstärkt den Bedarf innerhalb der ELMOS-Gruppe bedienen und nur noch beschränkt für Dritte tätig sein. Ausgenommen hiervon sind selbstverständlich die existierenden Kunden, die eurasem als verlässlicher Partner weiter versorgen wird.

ELMOS plant, neben dem Assemblieren von Bauelementen auch mit dem Test der assemblierten Bauelemente zu beginnen. Dies wird innerhalb des heutigen Fertigungs-Reinraumes geschehen. Die dazu benötigte Freifläche entsteht durch den Umzug sämtlicher Büro- und Nebenbereiche in das benachbarte Gebäude, das Ende 2003 von ELMOS erworben wurde.

SMI

Die Tochterfirma Silicon Microstructures, Inc., im kalifornischen Silicon Valley entwickelte sich 2003 weiterhin erfolgreich als Produzent mikromechanischer Bauteile. Mit der eigenen Waferfertigung am Stadtrand von San Jose in Milpitas ist SMI eines der wenigen Unternehmen der Branche, das über stabile Serienfertigungseinrichtungen und -fähigkeiten verfügt. Dadurch gelingt es Zug um Zug, weitere Produktionsaufträge für Dritte zu erhalten und somit dank besserer Auslastung den Betrieb der eigenen Fabrik profitabler zu gestalten.

Die im Berichtsjahr weitgehend abgeschlossene vollständige Renovierung der Fertigungsräume gibt SMI ein klares Alleinstellungsmerkmal in der Branche. Durch die schon teilweise erfolgte und in 2004 noch fort zu führende Umstellung auf 150mm Wafer wird auch die Profitabilität entscheidend verbessert werden.

Der Ausbau von SMI wurde 2003 planmäßig fortgesetzt. Wegen der Flaute im Halbleitermarkt konnte 150mm Equipment zu günstigen Preisen eingekauft werden. Auch innerhalb der ELMOS Gruppe konnten Geräte zu SMI transferiert werden, die den Anforderungen an zukünftige Strukturgrößen und Prozess-Technologien in der Dortmunder Waferfertigung nicht mehr genügten. In der Mikromechanik liegen hingegen die Ansprüche an die Lithographie bei rund 1µm.



Anfang des Jahres 2003 wurden alle früher noch an den Orten Fremont und Los Angeles verteilten Unternehmensaktivitäten am Standort Milpitas zusammengefasst und die Produktionsmannschaft neu aufgestellt. SMI beschäftigte zum Jahresende 75 Mitarbeiter.

Der Ausbau der Reinräume führte zu zeitweisen Beeinträchtigungen der Produktion; besonders betroffen hiervon war das zweite Halbjahr. Erfreulicher Weise konnte der Umsatz von 6,9 Millionen USD im Vorjahr auf 10,8 Millionen USD gesteigert werden. Der Jahresfehlbetrag betrug unverändert nur 0,2 Millionen Euro, die Book-to-bill-Rate verbesserte sich auf einen Wert von 1,03.

Wichtig für SMI war die Vorstellung neuer Produkte im Berichtsjahr. So konnte der monolithisch co-integrierte Drucksensor, der gemeinsam von ELMOS (CMOS-Wafer), SMI (Mikromechanik) und eurasem (Spezialgehäuse) gefertigt wird, und ein erstes Beispiel für die „ASIC *plus*“ Strategie ist, bereits im Sommer auf der Sensor-Messe in Nürnberg vorgestellt werden. Dieses Produkt zeichnet sich durch eine bislang unerreichte Linearität und Präzision aus, die durch die on-chip Kalibrierung und den eingesetzten Signalprozessor erreicht wird.

Ein weiteres Highlight war die Fertigstellung des kleinsten Drucksensorchips der Welt (0,65mm Kantenlänge), der nur durch die Anwendung modernster Fertigungsmethoden so klein gehalten werden konnte. Mit mehr als 20.000 Chips pro 150mm Wafer wird dieses Produkt sehr erfreuliche Margen liefern.

Schließlich wurden erste Muster einer neuen Generation von Beschleunigungssensoren vorgestellt und diese bereits für konkrete Kundenprojekte weiter entwickelt. Mit einem europäischen Schlüsselkunden wurde die Entwicklung eines Drehratensensors (Gyro) begonnen.

Unternehmenssituation

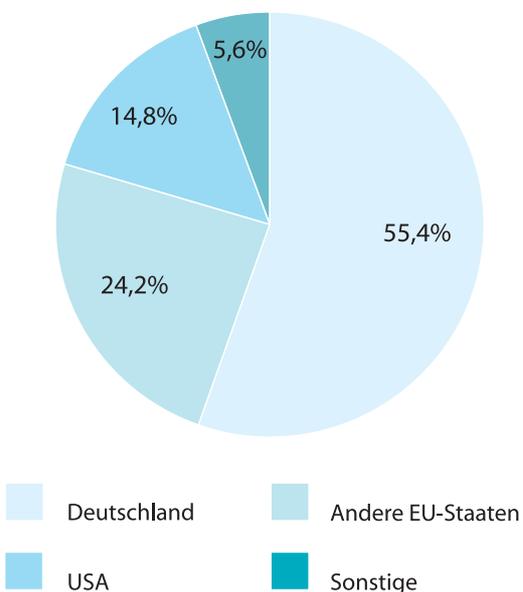
Das Jahr 2003 war für ELMOS ein Jahr mit zweistelligem Umsatzwachstum. So stieg der Umsatz der ELMOS-Gruppe wechsellkursbereinigt von 109,7 Millionen Euro im Vorjahr um 13 Prozent auf 123,7 Millionen Euro im Berichtsjahr. Der niedrige Dollarkurs drückte die USA-Umsätze deutlich, so dass netto ein Umsatz von 121,4 Millionen Euro erreicht wurde.

Die Umsatzbeiträge der Segmente beliefen sich auf 107,7 Millionen Euro im Bereich Halbleiter (89 Prozent), 9,3 Millionen Euro für die Mikromechanik (8 Prozent) und 4,4 Millionen Euro im Segment Assembly (4 Prozent vom Umsatz). Im Geschäftsjahr konnten damit alle Segmente gegenüber dem Vorjahr zunehmen.

Ein Blick auf die regionale Verteilung zeigt Deutschland als wichtigsten Markt mit einem Umsatzzuwachs von über 18 Prozent. Rest-Europa war um fast 5 Prozent, USA wechsellkursbedingt nur um rund 1 Prozent rückläufig.

Unter Berücksichtigung der besonderen Ereignisse in der ersten Jahreshälfte, u.a. SARS und der Irak-Krieg, verlief das abgelaufene Geschäftsjahr sehr erfreulich.

Umsätze nach Region



Kunden und Produkte

Bereits wie im Vorjahr führte auch im Berichtsjahr die französische Valeo die Liste unserer Top 10 Kunden an. Valeo bezieht mehr als 25 unterschiedliche ELMOS-Produkte für Anwendungen in der Karosserie-Elektronik und für Lichtmaschinenregler. Durch die ansteigende Serienlieferung von Airbag-Steuer-ICs der neuen Generation setzte sich das Stückzahlwachstum im Berichtsjahr fort, wodurch Autoliv 2003 wieder unser zweitwichtigster Kunde wurde. Erfreulich für ELMOS ist durch die Übernahme der Visteon Division für Sicherheitssysteme durch Autoliv der verbesserte Zugang zum amerikanischen Markt.

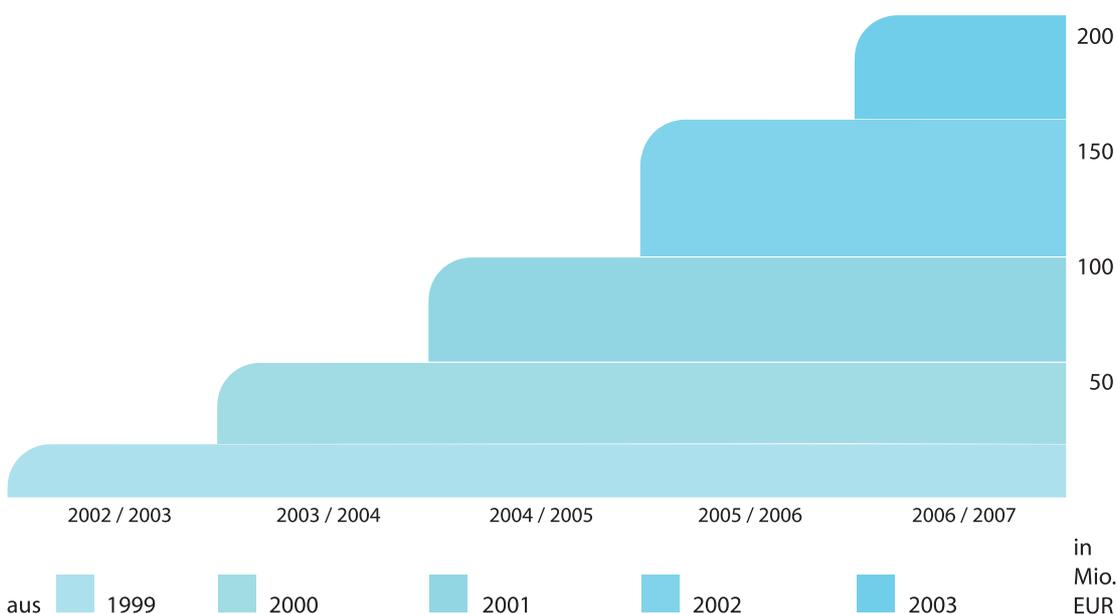
Insgesamt konnten im Berichtsjahr 31 neue Projekte gewonnen werden. Diese Projekte bedeuten ein zukünftiges Umsatzvolumen von 227 Millionen Euro. Die Mehrzahl dieser Projekte sind kundenspezifische Design-Wins überwiegend für automobiler Anwendungen. Diese Aufträge werden erst in etwa drei Jahren in die Serienproduktion einmünden und dann entsprechende Umsatzbeiträge liefern, da soviel Zeit für die Produktentwicklung sowie die Qualifikation und Kundenfreigabe erforderlich ist.

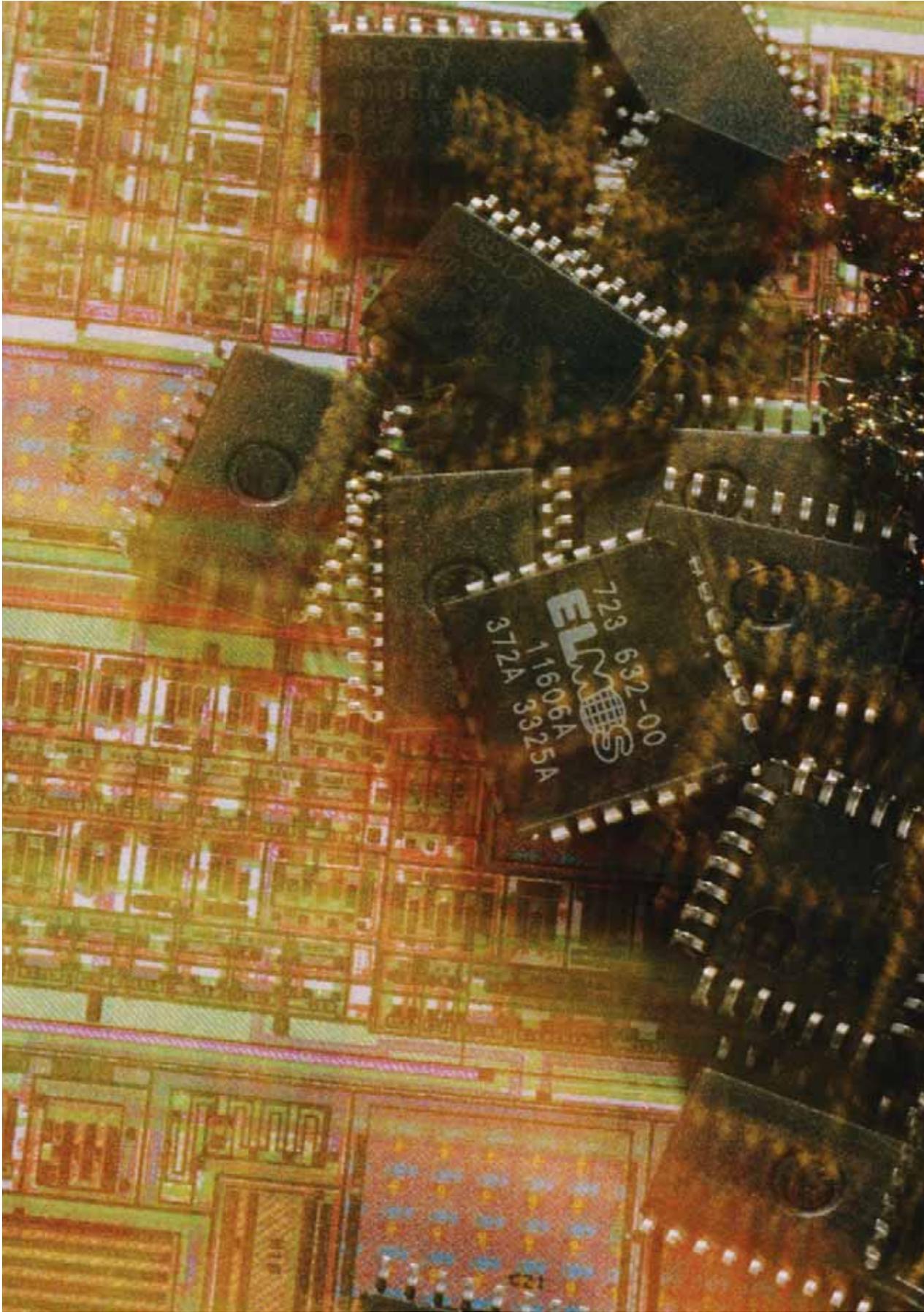
Die Anstrengungen zur Vermarktung von anwendungsspezifischen Standardprodukten (ASSP) waren erfolgreich. So konnten 10 Design-Ins für solche ASSPs gewonnen werden. ELMOS ASSPs sind in der Regel Derivate oder Verallgemeinerungen von ASICs, die sich stets durch innovative Eigenschaften auszeichnen. Daher werden auch mit diesen Produkten vergleichbare Verkaufspreise und Margen wie im ASIC Geschäft erzielt.

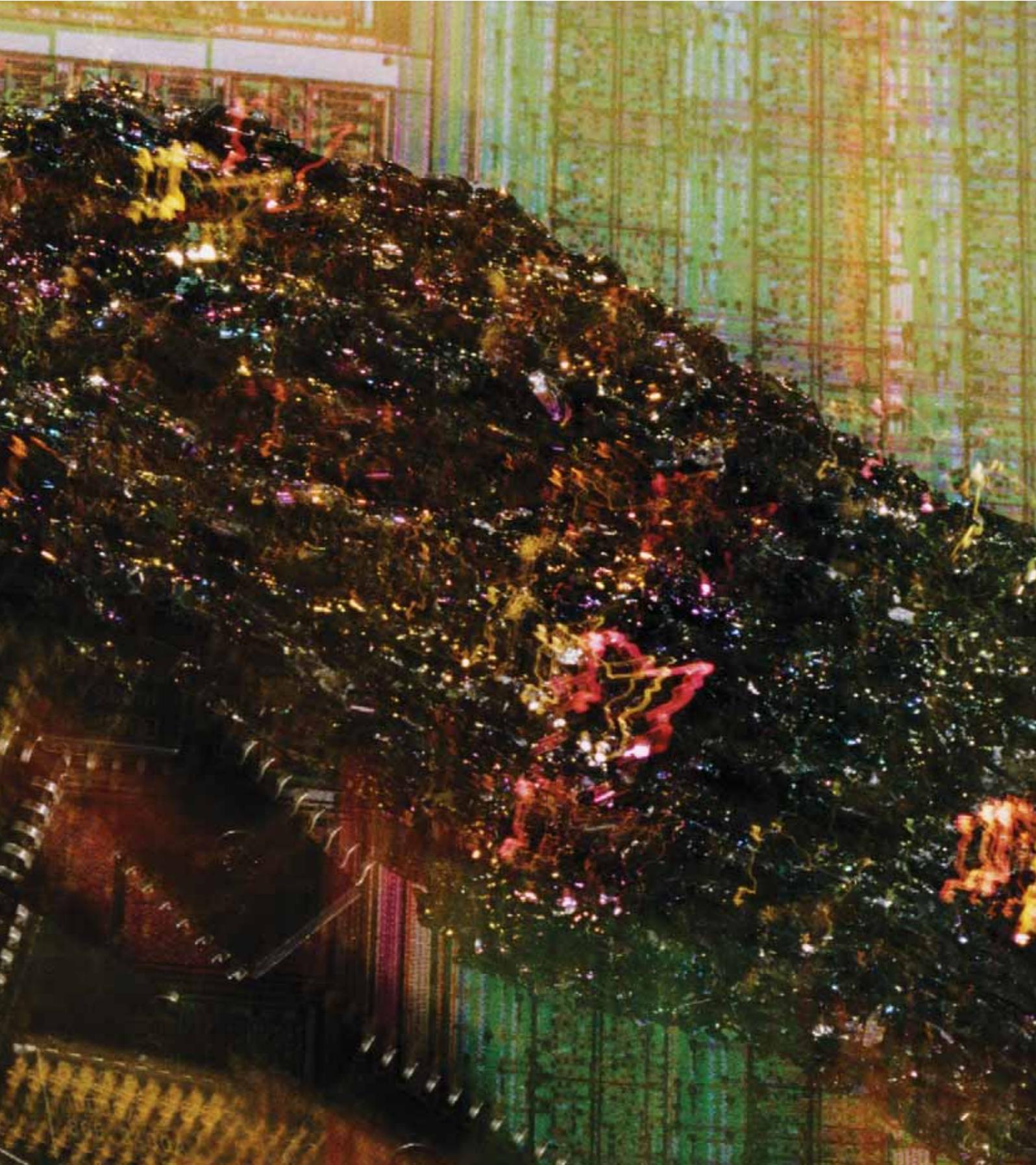
Das Jahr 2003 war ein Jahr mit zahlreichen Produktanläufen. Viele der in den Jahren 1999 und 2000 begonnenen Entwicklungsprojekte konnten abgeschlossen und in die Produktion übergeführt werden.

Von den neuen Produkten wurde auch der Auftragseingang im Laufe des Jahres positiv beeinflusst. So entwickelte sich die Book-to-bill-Rate für das Kerngeschäft Halbleiter sehr erfreulich und erreichte einen Wert von 1,13 gegenüber dem Vorjahreswert von 1,03. Bezogen auf das gesamte Jahr 2003 wurden mit 116 Millionen Euro rund 19 Prozent mehr Aufträge an ELMOS erteilt als im Vorjahr.

Zukünftige Umsatzbeiträge generiert durch zurückliegende Design-Wins









Das Geschäftsmodell

Der zentrale Gedanke des ELMOS Geschäftsmodells basiert auf dem ganzheitlichen Produktions- und Vermarktungsansatz und der intensiven innovationsfördernden Wechselwirkung zwischen Kunde – Entwicklung – Produktion.

Zunächst hat der Kunde eine Produktvorstellung. Daraufhin entwickelt ELMOS eine entsprechende Lösung unter Zuhilfenahme der Systemintegration auf Siliziumbasis. Im dritten Schritt werden maßgeschneiderte Produkte exklusiv bei ELMOS für höchste Qualitätsanforderungen produziert.

Finanzlage

Der Umsatz konnte 2003 um knapp 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 121,4 Millionen Euro gesteigert werden. Dabei trugen die Tochterfirmen ELMOS France 27,0 Millionen Euro, ELMOS NA 7,2 Millionen Euro, eurasem 4,4 Millionen Euro und SMI 9,3 Millionen Euro bereinigt um konzerninterne Umsätze bei.

Das Bruttoergebnis für das Gesamtjahr lag bei einem Wert von knapp 51 Prozent vom Umsatz und damit über dem Wert des Vorjahrs von 49 Prozent. Dies ist um so bemerkenswerter, da eine Vielzahl von Neuanläufen im Berichtsjahr getätigt wurde. Die ansteigende Auslastung der Produktion im Halbleiterbereich, Mikromechanik und Assembly lassen eine weitere Verbesserung der Bruttomarge erwarten.

Die Verwaltungskosten stiegen von 12,0 Millionen Euro geringfügig auf 12,8 Millionen Euro. Die Aufwendungen für die intensive Forschung und Entwicklung lagen mit 20,4 Millionen Euro (Vorjahr 17,6 Millionen Euro) bei rund 17 Prozent vom Umsatz. Marketing und Vertriebskosten stiegen leicht auf knapp 6 Prozent vom Umsatz, entsprechend 6,6 Millionen Euro.

Das Betriebsergebnis erhöhte sich dadurch auf 21,6 Millionen Euro, das sind 18 Prozent vom Umsatz, nach 18,3 Millionen Euro oder 16,6 Prozent vom Umsatz im Vorjahr.

Dank Kurssicherungsmaßnahmen konnten trotz der drastischen Veränderung der Währungsparitäten die Wechselkursverluste auf einem niedrigen Niveau von 0,1 Millionen Euro gehalten werden.

Sonstige Erträge bestehen im Wesentlichen aus öffentlichen Zuschüssen für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben in Höhe von 0,6 Millionen Euro. Die Restrukturierungsaufwendungen im Konzern, die mit dem Abbau von Mitarbeitern verbunden waren, beliefen sich auf einmalig fast 1,0 Millionen Euro im vierten Quartal 2003. Sie sollen zukünftig zu Einsparungen von rund 1,0 Millionen Euro im Quartal führen.

Die Zinsbelastungen waren im Berichtsjahr mit 3,8 Millionen Euro etwas höher als die 3,6 Millionen Euro im Vorjahr.

Das Ergebnis vor Steuern liegt mit 17,3 Millionen Euro um rund 10 Prozent über dem Vorjahreswert von 15,7 Millionen Euro; das Ergebnis nach Steuern erreicht 10,0 Millionen Euro gegenüber 8,9 Millionen Euro im Jahr 2002. Dies entspricht einem Ergebnis pro Aktie in Höhe von 0,52 Euro.

Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat vorgeschlagen, eine Dividende in Höhe von 0,13 Euro pro Aktie zu zahlen und den Rest des Jahresüberschusses zu thesaurieren.

Investitionen

Investitionen	2003	2002
	mEUR	mEUR
Halbleiter	17,5	20,8
Mikromechanik	3,9	10,8
Assembly	3,9	2,5
Konzern	25,3	34,1

Insgesamt wurde im Konzern im Berichtsjahr mit 25,3 Millionen Euro (34,1 Millionen Euro im Vorjahr) deutlich weniger investiert. In dieser Summe enthalten sind 3,4 Millionen Euro für die Ende 2002 abgeschlossene Aufstockung des Verwaltungsgebäudes in Dortmund, die erst im vierten Quartal 2003 vom Finanzinvestor abrechnet und damit bilanzwirksam wurde. Dieser Gebäudeteil ist ebenso wie die übrigen Gebäude am Standort Dortmund im Rahmen eines Finanzleasings langfristig angemietet.

Im Bereich Halbleiter wurden im Berichtsjahr Kapazitätserweiterungsinvestitionen in Fertigungseinrichtungen getätigt. Sie lagen damit um 32 Prozent unter dem Vorjahr und beliefen sich auf etwa 14,1 Millionen Euro. Dank der abgeschlossenen Investitionen in den Ausbau der Produktions-Infrastruktur befinden sich diese auf dem modernsten Stand der Technik für Prozesse mit Strukturbreiten bis 0,35 Mikrometer. Die Maschinen-Kapazität liegt bei etwa 400 Waferstarts pro Tag, wovon zum Jahresende 2003 etwa 275 Waferstarts pro Tag genutzt wurden,



d.h. die Auslastung betrug rund 69 Prozent. Die Kapazität kann durch Rekrutierung weiterer Mitarbeiter und ggf. die Investition in wenige Engpass-Maschinen auf bis zu 500 Waferstarts pro Tag erweitert werden.

Im Bereich Assembly fielen im letzten Quartal 2003 Investitionen in Höhe von 1,7 Millionen Euro auf den Erwerb des Nachbargebäudes an. Neben diesem Gebäudekauf beliefen sich die Investitionen bei eurasem für Umbauten und Maschinenausrüstung auf 2,2 Millionen Euro.

Die Investitionen bei SMI betrugen 2,7 Millionen Euro für die Modernisierung der Reinräume und 1,2 Millionen Euro für Maschinen.

Forschung und Entwicklung

Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung stiegen um 2,8 Millionen Euro und lagen bei 17 Prozent vom Umsatz. Die F & E-Arbeiten der Technologen und Prozessingenieure im Laufe des Jahres 2003 konzentrierten sich auf den Abschluss der Entwicklung einer 0,5 Mikrometer Submicron-Hochvolt-Prozesstechnologie mit Mehrlagen-Verdrahtung. Parallel dazu liefen mehrere Projekte zur Optimierung von Baugröße und Eigenschaften wichtiger Hochvoltbauelemente, die für typische ELMOS-Anwendungen von Bedeutung sind. Außerdem wurde ein Projekt zur effizienten Realisierung von Leistungstransistoren in system-on-chip Anwendungen gestartet. Die SOI-Technologie wurde weiter perfektioniert und die Chip-Ausbeute verbessert.

Erfolgreich abgeschlossen wurde das Projekt zur Integration der Motorola HC12-Zellbibliotheken und der Motorola Design-Methodik in die ELMOS-Designumgebung, das mit ersten Produkt-Demonstratoren verifiziert wurde. Die Arbeiten für die Integration des Motorola Flash-Memory-Moduls in den Hochvolt-CMOS-Prozess wurden planmäßig fortgeführt.

Zur besseren und schnelleren Umsetzung in Produkte des Patentpakets „HALIOS“ wurden im Berichtsjahr die vorher getrennten Arbeitsgruppen um den HALIOS Erfinder und die ELMOS HALIOS Designer

zusammengeführt. Daraus entstand die Firma MECHALESS, die am Standort Karlsruhe nun unter einem Dach mit 17 Mitarbeitern HALIOS Anwendungs- und Software-Know-how mit dem ASIC-Design vereinigt. ELMOS ist an MECHALESS mit 49 Prozent beteiligt.

Inzwischen werden mehr als 10 HALIOS-Projekte bearbeitet, davon über fünf für automobiler Kunden. Mit der Anwendung „Micromouse“ konnte erfolgreich das Interesse eines großen Herstellers von Mobiltelefonen geweckt und bis in die Produktendausscheidung vorgedrungen werden. Durch diesen Erfolg wurde bei diesem Kunden die Basis für den Auftrag eines Folgeprojekts geschaffen.

Personal- und Sozialbereich

Die ELMOS Gruppe beschäftigte zum Jahresende 2003 insgesamt 871 Mitarbeiter, davon 565 am Standort Dortmund. 25 junge Leute werden bei ELMOS für Berufe vom Mikrotechnologen bis Industriekaufmann ausgebildet. Das Durchschnittsalter liegt bei „jungen“ 34 Jahren.

Als High-tech-Unternehmen hängt ELMOS in besonderem Maße vom Know-how der Mitarbeiter ab. Denn deren Motivation, Wissen und Flexibilität sind die Voraussetzung für den langfristigen Erfolg des Unternehmens. Besonders in der Entwicklung neuer Produkte und Verfahren sind die Mitarbeiter die entscheidenden Kriterien für das Wachstum und die Innovationskraft. Am Standort Dortmund im bevölkerungsreichsten Bundesland Deutschlands hat ELMOS bisher stets auf eine große Zahl von gut ausgebildeten Jungingenieuren zugreifen können, denn im näheren Umkreis von Dortmund befinden sich mehr als fünfzig Universitäten und Hochschulen. ELMOS hat als einziger Halbleiterhersteller in der Region eine Ausnahmestellung und daher ist auch in Zeiten mit rückläufigen Studentenzahlen in den Ingenieurwissenschaften der Nachwuchs gesichert. Schon seit der Gründung kooperiert ELMOS eng mit den umliegenden Universitäten, Hochschulen und Instituten, wobei viele Mitarbeiter als Studienpraktikanten bei ELMOS begonnen und heute Führungsaufgaben übernommen haben.

Seit Jahren kooperiert ELMOS mit der Ruhrkohle AG auf dem Gebiet der Ausbildungsförderung. So wurde gemeinsam eine beispielhafte Weiterbildungseinrichtung geschaffen, die jungen Leuten das Erlernen von Berufen im Umfeld der Mikrotechnologien ermöglicht. Zu Lehrzwecken wurde ein richtiger Reinraum aufgebaut und mit halbleitertypischen Anlagen ausgerüstet.

ELMOS-Mitarbeiter waren durch das Gratisaktienprogramm aus dem Börsengang 1999, das jedem Mitarbeiter zu jeder selbst erworbenen Aktie jeweils eine Gratisaktie aus dem Paket der Altgesellschafter gewährt, beteiligt. Zudem partizipieren sie am Erfolg des Unternehmens über jährliche Aktienoptionsprogramme. So wurde im Dezember 2003 durch den Aufsichtsrat dem vom Vorstand vorgeschlagenen Aktienoptions-Plan für 2003 zugestimmt, der die Ausgabe von bis zu 240.000 Aktienoptionen an die Mitarbeiter vorsieht. Weiter wurde die Ausgabe von bis zu 60.000 Aktienoptionen an die Vorstandsmitglieder beschlossen.

ELMOS-Vorstand und -Mitarbeiter arbeiten in Dortmund vertrauensvoll zusammen. Eine Mitarbeitervertretung mit selbst gegebener Satzung, die in zahlreichen Ausschüssen die Belange der Mitarbeiter untereinander und im Verhältnis zur Geschäftsleitung vertritt, wurde ins Leben gerufen. So gibt es Ausschüsse für soziale Fragen, Personalangelegenheiten, Mitarbeiterförderung und Wirtschaft.

Qualität und Umwelt

ELMOS besitzt seit mehr als 10 Jahren ein Qualitätsmanagementsystem, das alljährlich gemäß den Forderungen der DIN ISO 9001 und der Normen QS 9000 und VDA 6.1 zertifiziert wurde. Diese Normen wurden inzwischen in der ISO / TS 16949, die weltweit Gültigkeit hat, zusammen gefasst. ELMOS Dortmund, ELMOS NA in Detroit und erstmalig auch die Tochterfirmen ELMOS France und GED in Frankfurt an der Oder wurden daher im Berichtsjahr gemäß der neuen Norm auditiert und zertifiziert.

Für die exzellente Qualität ihrer Produkte gewann ELMOS den begehrten „Delphi Electronic Europe Supplier of the Year 2003“ Preis.

Außerdem hat ELMOS sich Mitte des Berichtsjahres einem sogenannten Öko-Audit nach der Umweltnorm DIN EN ISO 14001 unterzogen und im Anschluss das Zertifikat erhalten.

Risiko und Corporate Governance

In einem kapitalintensiven Unternehmen wie ELMOS kommt einem funktionierenden Risikomanagementsystem eine große Bedeutung zu. ELMOS hat daher im Berichtsjahr das im Vorjahr eingeführte Risikomanagementsystem gelebt und erprobt. Dabei ergaben sich laufende Verbesserungen und Ergänzungen, die von unserer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Jahresende kritisch auf Konformität mit den Anforderungen des §91 (2) AktG geprüft und für geeignet befunden wurden. Auch im Jahr 2004 wird das System kontinuierlich erweitert und weiter verfeinert werden.

Die von der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex aktualisierten Empfehlungen wurden im Berichtsjahr in fast vollständigem Umfang in die ELMOS-Satzung sowie die Geschäftsordnungen für Vorstand und Aufsichtsrat übernommen und am 19. Dezember 2003 eine entsprechende öffentliche Erklärung abgegeben.





Lediglich in vier Punkten weicht ELMOS von den Soll-Empfehlungen ab: beim Selbstbehalt der D&O-Versicherung der Organmitglieder, bei der Bildung von Aufsichtsrats-Ausschüssen und beim individualisierten Ausweis aller Einkünfte der Mitglieder des Vorstandes und der Mitglieder des Aufsichtsrates. Die Erklärung kann auf der Internetseite der Gesellschaft eingesehen werden.

Aktionärsstruktur

Das Stammkapital der ELMOS Semiconductor AG umfasst 19.300.000 Aktien ohne Nennwert. Von diesen Aktien werden 58 Prozent von der ELMOS Finanzholding EFH gehalten, die damit das stabile Rückgrat der ELMOS AG darstellt. Die EFH ist im Besitz der Herren Knut Hinrichs, Dr. Klaus Weyer und Prof. Dr. Günter Zimmer. Weitere 43 Prozent der Aktien können institutionellen Investoren im In- und Ausland zugeordnet werden. Dabei hält keiner dieser Investoren mehr als 5 Prozent der Aktien.

Ausblick

Für das Jahr 2004 wird allgemein ein starkes Wachstum der Halbleitermärkte erwartet. Nach Jahren der Rezession soll der Aufschwung des zweiten Halbjahrs 2003 weiter an Fahrt gewinnen und zu einem Anwachsen des Halbleitermarktes um mehr als 20 Prozent auf rund 200 Milliarden USD führen.

Auch für die Automobilelektronik wird weiteres Wachstum erwartet. So geht man allgemein von einer Erholung der Zulassungszahlen aus, da z.B. in Deutschland der Bestand an alten Fahrzeugen auf Rekordhöhe ist und diese zur Erneuerung anstehen. Auch die Modelloffensive der deutschen Fahrzeughersteller, die im vergangenen Jahr mehr als 65 neue Modelle in den Markt schickten, wird die Verkaufszahlen steigen lassen.

Unabhängig davon wird der Trend zu weiter steigendem Elektronikanteil in den Fahrzeugen anhalten. Bei europäischen Mittel- und Oberklasse-Fahrzeugen wird hier schon ein Wert von mehr als 30 Prozent erreicht. In diesem Wachstumsmarkt ist ELMOS mit ihrer spezialisierten, auf Automobilanforderungen ausgerichteten Prozesstechnologie und dem langjährigen Anwendungs-Know-how bestens positioniert.

Die zahlreichen neuen Serienprodukte aus dem Vorjahr werden den Umsatz steigern. Aus den Design-Wins der Jahre 2000 / 2001 werden auch im Jahr 2004 wieder um etwa 30 neue Produkte in die Serienfertigung überführt. Dies wird zu einem Anstieg der Waferstarts pro Tag auf mehr als 300 führen.

Bei SMI werden sich die positiven Effekte aus der neuen Fertigung erst im zweiten Halbjahr 2004 zeigen. Hinzu kommt der Effizienzgewinn durch die Umstellung der wichtigsten Produkte von 100mm auf 150mm Waferdurchmesser. Ferner werden in der zweiten Jahreshälfte größere Foundry-Lieferungen beginnen, für die derzeit die Qualifikationslose gefertigt werden.

Bei eurasem erwarten wir durch die Restrukturierungsmaßnahmen ein deutliches Absinken der Kostenbasis und eine signifikante Ergebnisverbesserung. Weiterhin ist der Ausbau des Fertigungsstandortes in Nijmegen auch für das Testen von assemblierten Bauteilen in 2004 geplant.

Damit wird das Jahr 2004 für die ELMOS-Gruppe ein Umsatzwachstum von 15 bis 20 Prozent bringen und Rohertrag und Betriebsergebnis sollen wieder Zielwerte von 50 bzw. 20 Prozent erreichen. Die Investitionen des Jahres 2004 werden auf dem Niveau des Jahres 2003 liegen.

Dortmund, im Februar 2004

Der Vorstand

Knut Hinrichs

Dr. Klaus Weyer

Dr. Peter Thoma

Reinhard Senf

Vorstand der Gesellschaft



Dr. Klaus Weyer

Knut Hinrichs

Dr. Peter Thoma

Reinhard Senf





Die ersten Kunden

Die preiswerte Fertigung in großen Stückzahlen ist das Erfolgsrezept der Halbleiterbranche. Auch ein kleiner Anbieter muss sich daher auf einen Markt mit einer Mindestgröße fokussieren. Die ersten Kunden sind Rowenta, Leica, Motometer, und schließlich eröffnet die Beteiligung eines Automobilherstellers den Zugang in den aufsteigenden Markt für Automobilelektronik. Diese Marktnische erweist sich als strategisch richtig für ELMOS. Den Einstieg schafft das Unternehmen Ende der achtziger Jahre, als scheinbar unlösbare Qualitätsprobleme dazu führen, dass ELMOS von BMW mit einem Entwicklungsprojekt beauftragt wird und sich damit zum Spezialisten für integrierte Lösungen wandelt. Weitere Systemzulieferer der Automobilhersteller „trauen“ sich zunehmend, auch eigene Entwicklungen mit ELMOS zu projektieren.



Ein Jahr TecDAX

Die Aktie der ELMOS Semiconductor AG, seit Beginn des Jahres 2003 im Prime Standard Segment der Deutschen Börse vertreten, konnte im zurückliegenden Jahr eine beachtliche Entwicklung durchlaufen.

Kursentwicklung

So startete die ELMOS-Aktie zum Jahresbeginn 2003 mit einem Wert von 8,61 Euro. Jedoch gab der Aktienkurs zunächst deutlich nach. Gründe hierfür waren Defizite in der Finanzkommunikation, so dass die durchgeführten Anpassungen der Bilanzierung an internationale Vorgaben der Halbleiterindustrie, obgleich ausführlich im Jahresbericht beschrieben, missverständlich interpretiert wurden. Der Tiefpunkt wurde mit einem Aktienkurs von 4,28 Euro Ende März des Jahres durchschritten, gleichbedeutend mit einer Werthalbierung gegenüber dem Jahresanfang.

Anschließend konnte sich die Aktie jedoch wieder deutlich erholen und überschritt Mitte Juli erstmalig den Jahresanfangskurs. Sowohl die kontinuierliche Pflege der Anleger im privaten als auch im institutionellen Bereich, wie auch die Erkenntnis über die offensichtliche Unterbewertung der Gesellschaft, deren Marktkapitalisierung zeitweilig unter der Bilanzsumme lag, führten zu signifikanten Kursanstiegen. So erreichte der Börsenkurs der Gesellschaft Anfang Dezember den Jahreshöchstwert von 14,43 Euro, ein Anstieg um fast 68 Prozent gegenüber dem Jahresanfang. Gegenüber dem Tiefststand von Ende März bedeutete dieser Anstieg sogar eine Wertsteigerung um 237 Prozent. Zum Jahresende schloss die Aktie bei einem Kurs von 12,40 Euro.

Bei einer unveränderten Anzahl von 19,3 Millionen Aktien betrug die Marktkapitalisierung 2003 im Durchschnitt rund 166,0 Millionen Euro, in der Spitze sogar 278,5 Millionen Euro. Zum Jahresende konnte eine Marktkapitalisierung von rund 239,3 Millionen Euro festgehalten werden. Damit bewegte sich die Marktkapitalisierung auf einem vergleichbaren Niveau mit der von 2001.

Handelsvolumen

Ebenfalls sehr erfreulich ist das stark gestiegene Interesse an der ELMOS-Aktie. Dies zeigt sich unter anderem an der positiven Entwicklung des Handelsvolumens. Durchschnittlich wurden 2003 täglich 88.460 Aktien auf dem Frankfurter Parkett gehandelt, im Vorjahr waren es noch 33.900 Stück pro Börsentag. Das höchste Handelsvolumen wurde am 27. März mit einem Umsatz von 398.250 Stück erreicht. Begünstigt wurde das gestiegene Interesse an der Aktie durch die Abschaffung des krisengeschüttelten Neuen Marktes und die Notation der ELMOS im neu geschaffenen Börsensegment Prime Standard und die Aufnahme in den Technologieauswahlindex TecDAX 30. Der TecDAX 30 bildet die größten Technologieunternehmen des Prime Standard ab, die aufgrund ihrer Marktkapitalisierung und Orderumsatz den DAX-Werten nachfolgen. Durch die hohen Transparenzaufgaben des Prime Standard und des Auswahlindex TecDAX 30 wurde das Vertrauen in Wachstumstitel und damit auch in ELMOS gefestigt.

In der Gegenüberstellung mit diesen und anderen Indizes schneidet ELMOS im Jahr 2003 gut ab. Die zum Vergleich herangezogenen Indizes TecDAX 30, welcher vor dem 24. März mit dem NEMAX 50 gleichgesetzt wurde, und den branchenspezifischen Index SOX (Philadelphia Semiconductor Index) schlossen auf Jahresebene mit praktisch identischer Performance. Vor dem Hintergrund der niedrigen Kursstände Ende März unterstreicht dies die überraschende Aufholjagd der ELMOS-Aktie bis zum Jahresende.

IR-Tätigkeiten

Auch im abgelaufenen Jahr hat ELMOS konsequent die Bedürfnisse nach Informationen bei den Anlegern in aller Welt befriedigt. Auf 32 Roadshows, die an den relevanten Finanzplätzen Deutschlands, Europas und Amerikas durchgeführt wurden, standen der Vorstand und das Investor-Relations-Team den institutionellen Anlegern Rede und Antwort. Darüber hinaus nahmen ELMOS-Vertreter an sechs Technologie-Konferenzen und Aktien-Informationstagen für institutionelle und Retail-Anleger teil. In den insgesamt über 150 Einzelgesprächen, auch

One-on-Ones genannt, wurden Fragen zur Unternehmensstrategie erläutert, ebenso wie Antworten zu Finanz- und Ertragsthemen gegeben wurden. Ein weiterer Baustein in der Kommunikation mit den Anlegern sind die Conference Calls, die nach den jeweiligen Quartalsberichten stattfinden. Die Möglichkeit zeitnah und direkt Fragen zu den aktuellen Finanzzahlen zu stellen, wird in wachsendem Maße weltweit von Analysten in Anspruch genommen.

Höhepunkte in der engen Zusammenarbeit mit den Anlegern sind die zweimal pro Jahr stattfindenden Analystentage, darunter der hausinterne Analystentag „Chips & More“ im November. Zum zweiten Mal nutzen über 30 Teilnehmer verschiedener Institutionen die Gelegenheit, sich vor Ort über Strategie, Produkte und Zukunftsaussichten zu informieren. Dazu standen ihnen die Vorstandsmitglieder und das Management in Vorträgen und Einzelgesprächen zur Verfügung. Der nachhaltige Erfolg dieser Veranstaltung ist durch die gute Resonanz bei den Fondmanagern, Bankern und Analysten gekennzeichnet und sichert dieser Kommunikationsplattform einen festen Platz im Finanzkalender.

Kursentwicklung der ELMOS-Aktie im Vergleich zu TecDAX und SOX



Trotz einiger Fluktuationen konnte nicht nur die Anzahl der Analysten voneinander unabhängiger Institutionen auf insgesamt 19 gehalten werden, auch die Verteilung des Aktien-Freefloats, soweit zuordenbar, blieb praktisch auf Vorjahresniveau. Zwar gaben einige Fonds und Anleger, getrieben durch den Niedergang des Neuen Marktes, ihre Aktienpakete ab. Dennoch verblieben zum Jahreswechsel gemäß Thomson Financial rund 22 Prozent des Freefloats bei Anlegern im angelsächsischen Raum, davon 12 Prozent in Großbritannien und 10 Prozent in den USA. Dagegen entfielen auf Deutschland rund 8 Prozent, auf die Schweiz und die Niederlande jeweils rund 5 Prozent, auf Luxemburg etwa 2 Prozent und auf Frankreich etwa 1 Prozent der frei handelbaren rund 8,2 Millionen Stück Aktien.

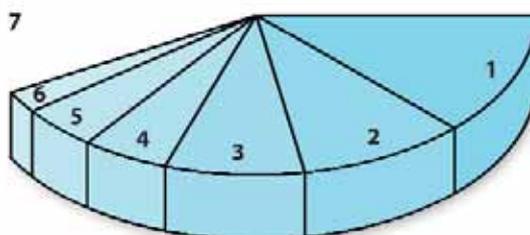
Derartige Stabilität kann auch auf die Zugehörigkeit zum Prime Standard Segment der Deutschen Börse und auf die dazugehörigen hohen Transparenzaufgaben zurück geführt werden. Auch dass ELMOS von Anfang an zum Technologie-Auswahlindex TecDAX gehört und den Deutschen Corporate

Governance Kodex bis auf vier Abweichungen, nachzulesen in den Erläuterungen zum HGB-Abschluss, erfüllt, sind weitere Mosaiksteine im erfolgreichen Börsenjahr 2003. Dazu passt, dass Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,13 Euro je Aktie vorschlagen werden, so dass auch die Aktionäre am Erfolg des Jahres 2003 partizipieren können.

Im laufenden Jahr 2004 wird die Arbeit der Investor-Relations-Abteilung konsequent weitergeführt. Auf Roadshows, Technologiekonferenzen und in Einzelgesprächen wird die zukunftsorientierte und ertragsstarke Strategie vorgestellt. Darüber hinaus werden wir weiterhin eine intensive Zusammenarbeit mit institutionellen und privaten Anlegern pflegen, um so einen Beitrag zur langfristig positiven Entwicklung des Unternehmenswertes zu leisten.

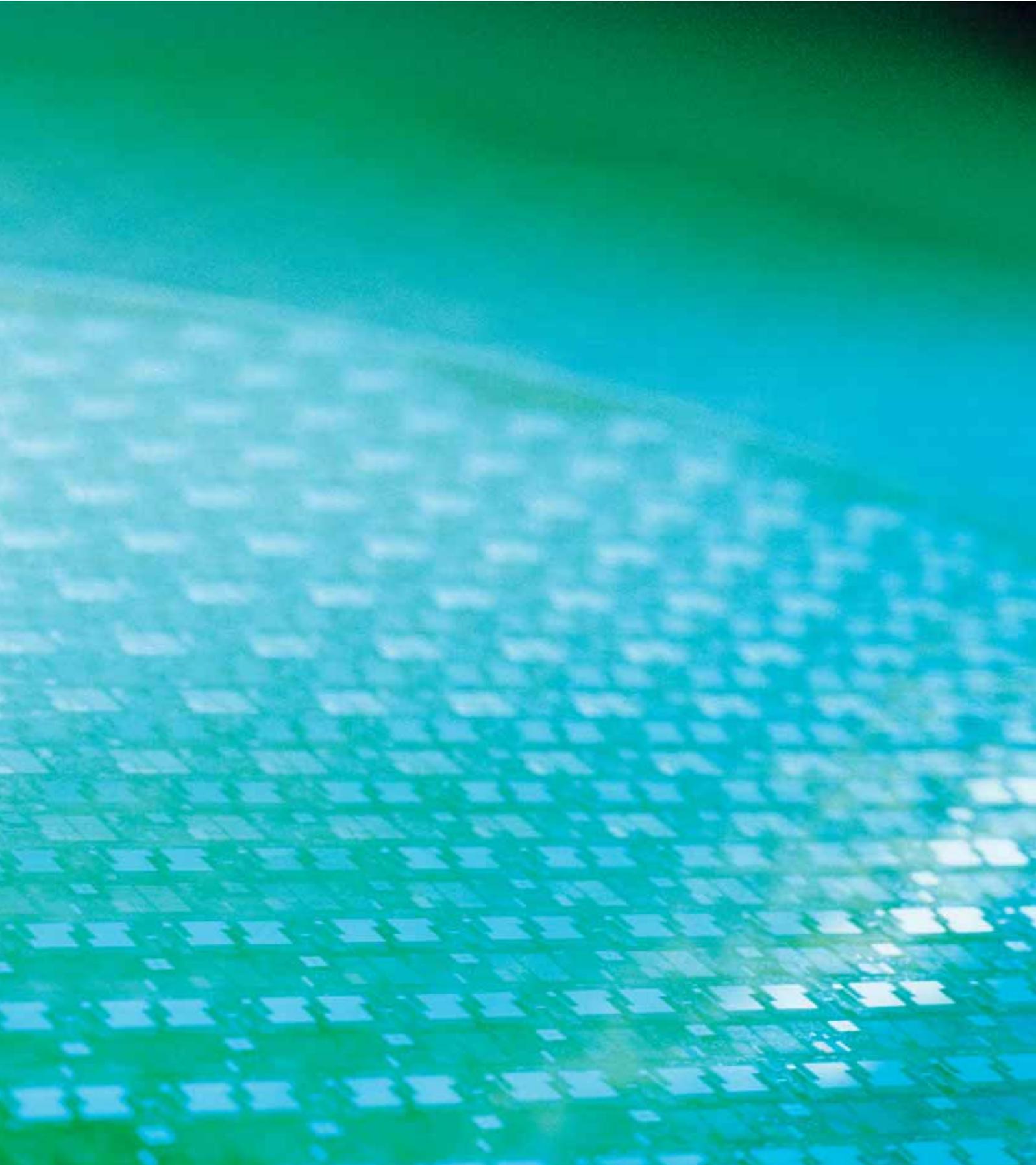
Geographische Verteilung des Freefloats

1	Großbritannien	12 %
2	USA	10 %
3	Deutschland	8 %
4	Schweiz	5 %
5	Niederlande	4 %
6	Luxemburg	2 %
7	Weniger als 1 % bzw. nicht zuzuordnen	



Stand Januar 2004







Maßgeschneiderte Entwicklung

Die Jahrzehnte lange ELMOS-Erfahrung im automobilen Geschäft ermöglicht es, kundenspezifische Aufgabenstellungen zu analysieren und in ihre Teilfunktionen zu gliedern. An dieser Schnittstelle zwischen Applikation und Halbleiterwelt kreiert ELMOS den optimalen Integrationsansatz auf Halbleiterbasis. Hierdurch entstehen individuelle Produkte, die das Ingenieurwissen und die technologischen Möglichkeiten des Unternehmens ideal ausnutzen. Für die geplante Anwendung erhält der Kunde eine nach Kosten und Nutzen optimierte Lösung.

Bericht des Aufsichtsrates der ELMOS Semiconductor AG, Dortmund, zum Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2003

Sehr geehrte Aktionäre,

der Aufsichtsrat der ELMOS Semiconductor AG hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr intensiv mit der Lage des Unternehmens befasst. Wir haben den Vorstand beraten und die Geschäftsführung überwacht. In Entscheidungen von wesentlicher Bedeutung waren wir eingebunden. Der Vorstand hat uns regelmäßig und umfassend unterrichtet.

In Nachfolge des im Dezember 2002 verstorbenen Aufsichtsratsmitglied Prof. Dr. Karsten Ehlers wählte auf Vorschlag des Aufsichtsrates die Hauptversammlung am 30. April 2003 Herrn Dr. Karl-Thomas Neumann, Leiter Elektrik-Elektronik-Entwicklung der Volkswagen AG, als neues Mitglied in den Aufsichtsrat.

Der Aufsichtsrat hat sich in vier Sitzungen am 30. April 2003, am 19. September 2003, am 19. Dezember 2003 und am 26. Februar 2004 sowie aufgrund schriftlicher und mündlicher Berichte des Vorstands eingehend über die Entwicklung des am 31. Dezember 2003 abgelaufenen Geschäftsjahres, die Lage der Gesellschaft und aktuelle geschäftspolitische Entscheidungen unterrichten lassen, diese mit dem Vorstand beraten und den Vorstand überwacht. Auch außerhalb der Aufsichtsratssitzungen wurde der Aufsichtsratsvorsitzende vom Vorsitzenden des Vorstands über die wesentlichen Geschäftsvorgänge informiert.

Die langfristige Geschäftsentwicklung der ELMOS-Gruppe wurde am 19. Dezember 2003 ausführlich mit dem Vorstand behandelt. Im Rahmen der Gespräche im Aufsichtsrat standen die Entwicklung der Tochtergesellschaften sowie die Absatz-, Ergebnis- und Liquiditätentwicklung im Vordergrund. Weitere Schwerpunkte waren die Pläne zur langfristigen Absicherung der Produktionskapazität sowie das ELMOS-Risikomanagementsystem und die Erfüllung des wiederholt geänderten Deutschen Corporate Governance Kodex durch die Gesellschaft. Am

19. Dezember 2003 wurde von der Gesellschaft eine aktualisierte Erklärung gemäß §161 AktG bezüglich der Erfüllung der Empfehlungen des Corporate Governance Kodex veröffentlicht, mit der bekannt gegeben wird, dass ELMOS lediglich in vier Punkten von den Soll-Empfehlungen abweicht: beim Selbstbehalt der D&O-Versicherung der Organmitglieder, bei der Bildung von Aufsichtsratsausschüssen und beim individualisierten Ausweis aller Einkünfte der Mitglieder des Vorstandes und der Mitglieder des Aufsichtsrates. Die Erklärung kann auf der Internetseite der Gesellschaft eingesehen werden.

Ferner hat der Aufsichtsrat sich in seiner Sitzung am 26. Februar 2004 unter Hinzuziehung von Ernst & Young AG, Dortmund, ausführlich mit dem Stand der Erfüllung der Anforderungen des KonTraG durch die Gesellschaft befasst. Der Aufsichtsrat ist zu der Überzeugung gekommen, dass die Gesellschaft die wesentlichen Anforderungen des KonTraG derzeit erfüllt. Auch eine Überprüfung des Vergütungssystems für die Vorstände und der Effizienz der Aufsichtsratsstätigkeit war Gegenstand der Beratungen.

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 19. Dezember 2003 den Beschluss des Vorstands über die Ausgabe von bis zu 240.000 Aktienoptionen für Mitarbeiter unterhalb des Vorstands genehmigt. In der gleichen Sitzung wurde vom Aufsichtsrat beschlossen, für die Vorstände insgesamt 60.000 Aktienoptionen zu den gleichen Konditionen wie für die Mitarbeiter auszugeben.

Dem vom Vorstand aufgestellten und vom Abschlussprüfer Ernst & Young AG, Dortmund, geprüften Bericht des Vorstands über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen nach § 312 AktG wurde von Ernst & Young AG, Dortmund, der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt, wonach die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig sind, bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften die Leistung der Gesellschaft nicht unangemessen hoch war und bei den im Bericht aufgeführten Maßnahmen keine Umstände für eine wesentlich andere Beurteilung als die durch den Vorstand sprechen.

Der Prüfbericht lag dem Aufsichtsrat vor. Der Aufsichtsrat hat den Bericht in seiner Sitzung am

26. Februar 2004 auch selbst geprüft und nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung keine Einwendungen gegen die Schlussklärung des Vorstands erhoben, dass bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften die Leistung der Gesellschaft nicht unangemessen hoch war und bei den im Bericht aufgeführten Maßnahmen keine Umstände für eine wesentlich andere Beurteilung als die durch den Vorstand sprechen, und hat damit dem Ergebnis der Prüfung durch die Abschlussprüfer zugestimmt.

Vorstand und Aufsichtsrat haben im abgelaufenen Geschäftsjahr erhebliche Anstrengungen zur Stabilisierung der Ertragslage der Gesellschaft unternommen. Der vorgelegte Jahresabschluss zeigt ein erfreulich gutes Ergebnis. Es wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 8.110.042,30 Euro erzielt. Die Eigenkapitalquote der ELMOS Semiconductor AG beträgt nunmehr 78 Prozent der Bilanzsumme, im ELMOS-Konzern liegt sie bei 61 Prozent.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2003 wurden unter Einbeziehung der Buchführung von Ernst & Young AG, Dortmund, die von der Hauptversammlung am 30. April 2003 zum Abschlussprüfer bestimmt worden waren, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Aufsichtsrat und Wirtschaftsprüfer haben an der Bilanzsitzung des Vorstands am 26. Februar 2004 teilgenommen. Der Prüfbericht lag dem Aufsichtsrat vor. Dem Ergebnis dieser Prüfung stimmt der Aufsichtsrat zu.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten und von Ernst & Young AG, Dortmund, geprüften und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss und den Lagebericht in seiner Sitzung am 26. Februar 2004 geprüft und gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Der Aufsichtsrat hat ebenfalls den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht geprüft. Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung werden seitens des Aufsichtsrates keine Einwendungen erhoben. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn in Höhe von 28.571.482,26 Euro eine Dividende in Höhe von 0,13 Euro pro Aktie auszuschütten und den Restbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Die im April 2004 auslaufenden Anstellungsverträge der Vorstände Knut Hinrichs und Dr. Klaus Weyer werden mit Zustimmung des Aufsichtsrates für einen weiteren Zeitraum von 5 Jahren verlängert.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeitern für die im abgelaufenen Geschäftsjahr geleistete Arbeit, den gezeigten Einsatz und den erreichten Erfolg.

Dortmund, den 26. Februar 2004

Prof. Dr. Günter Zimmer
Vorsitzender des Aufsichtsrates

Mitglieder des Aufsichtsrates



Dr. Roland Mecklinger

Dr. Wolfgang Heinke

Dr. Karl-Thomas Neumann,

Prof. Dr. Günter Zimmer

Herbert Sporea

Dr. Burkhard Dreher

Mitglieder des Aufsichtsrates:

Prof. Dr. Günter Zimmer,
Vorsitzender des Aufsichtsrats,
Duisburg
Dr. Burkhard Dreher,
stellv. Vorsitzender, Dortmund
Dr. Wolfgang Heinke,
Reutlingen
Dr. Roland Mecklinger,
Steinfeld-Hausen
Dr. Karl-Thomas Neumann,
Meine
Herbert Sporea,
Altwittenbek







Die ELMOS-Technologie

Die modulare Technologie von ELMOS ermöglicht kostengünstige Lösungen in Silizium. Herzstücke der ELMOS-eigenen CMOS-Technologie sind die Hochvoltfestigkeit sowie die Integration digitaler und analoger Schaltungskonzepte. Die optimierte ELMOS-Technologie orientiert sich konsequent an den Erfordernissen des Automobilmarktes. Kontinuierliche Weiterentwicklungen ermöglichen Lösungen auch für zukünftige Bedürfnisse in der Automobilelektronik, wie Hochtemperaturfestigkeit und die neue Bordnetzspannung 42V.

Jahresabschluss nach HGB für das Geschäftsjahr 01.01. bis 31.12.2003 ELMOS Semiconductor AG, Dortmund

Bestätigungsvermerk HGB

Zu dem Jahresabschluss und dem Bericht über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns haben wir folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Bericht über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns der ELMOS Semiconductor AG, Dortmund, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2003 bis 31. Dezember 2003 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Bericht über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Regelungen in der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Bericht über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach §317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Bericht über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Bericht über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns überwiegend auf der Basis von Stichproben

beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Berichts über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Bericht über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft und stellt die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Dortmund, 20. Februar 2004

Ernst & Young AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Brorhilker
Wirtschaftsprüfer

Muzzu
Wirtschaftsprüfer

AKTIVA	31.12.2003 EUR	31.12.2002 TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Software und Lizenzen	7.426.664,77	4.622
2. Geleistete Anzahlungen	7.215.230,19	11.276
	14.641.894,96	15.898
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	8.742.724,32	8.344
2. Technische Anlagen und Maschinen	12.743.920,77	26.906
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.349.962,51	835
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.266.544,92	14.949
	26.103.152,52	51.034
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	32.348.283,47	32.093
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	163.940,71	205
3. Beteiligungen	325.780,77	328
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.009.309,37	810
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	724.344,00	724
6. Sonstige Ausleihungen	91.350,00	0
	34.663.008,32	34.160
	75.408.055,80	101.092
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.709.388,08	5.738
2. Unfertige Erzeugnisse	10.441.530,08	10.422
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	2.886.890,44	4.272
	18.037.808,60	20.432
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.667.596,26	15.559
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	35.810.231,76	26.134
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	15.550,03	0
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.111.109,28	3.047
	56.604.487,33	44.740
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	15.246.163,18	6.928
	89.888.459,11	72.100
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	2.924.476,78	555
AKTIVA GESAMT	168.220.991,69	173.747

Bilanz nach HGB

PASSIVA	31.12.2003 EUR	31.12.2002 TEUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	19.300.000,00	19.300
II. Kapitalrücklage	84.000.000,00	84.000
III. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	102.223,64	102
IV. Bilanzgewinn	28.571.482,26	20.462
	131.973.705,90	123.864
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.192.857,00	1.107
2. Steuerrückstellungen	2.052.564,62	7.717
3. Sonstige Rückstellungen	3.438.484,86	3.372
	6.683.906,48	12.196
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.713.999,39	13.874
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	27.789,51	122
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.504.700,72	7.488
4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	5.100.000,00	8.300
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.088.013,78	393
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.136,06	7
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.126.739,85	7.503
	29.563.379,31	37.687
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0	0
PASSIVA GESAMT	168.220.991,69	173.747

Gewinn- und Verlustrechnung nach HGB

	2003 EUR	2002 TEUR
1. Umsatzerlöse	102.979.637,29	95.431
2. Verminderung (-) oder Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-1.365.502,92	-729
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	987.397,15	758
4. Sonstige betriebliche Erträge	9.657.006,05	5.548
	112.258.537,57	101.008
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-11.199.181,64	-10.884
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-19.546.346,25	-12.994
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-22.117.893,93	-21.727
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen und für Unterstützung, davon für Altersversorgung EUR 87.969,00 (Vj. TEUR 88)	-3.959.989,55	-3.659
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-9.549.722,27	-12.135
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-32.882.705,76	-22.294
	-99.255.839,40	-83.693
	13.002.698,17	17.315
9. Erträge aus Beteiligungen		
davon von verbundenen Unternehmen EUR 225.000,00 (Vj. TEUR 450)	1.212.627,05	450
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
davon von verbundenen Unternehmen EUR 1.184.640,35 (Vj. TEUR 980)	1.370.961,58	1.091
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-401.000,00	-800
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen EUR 89.106,86 (Vj. TEUR 0)	-1.337.823,44	-1.144
	844.765,19	-403
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	13.847.463,36	16.912
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-5.561.661,54	-6.673
15. Sonstige Steuern	-175.759,52	-114
	-5.737.421,06	-6.787
16. Jahresüberschuss	8.110.042,30	10.125
17. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	20.461.439,96	10.336
18. Bilanzgewinn	28.571.482,26	20.461

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des AktG und der Satzung aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Erworbene **immaterielle Vermögensgegenstände** sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen (3 Jahre, lineare Methode) vermindert.

Das **Sachanlagevermögen** ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. In die Herstellungskosten selbsterstellter Anlagen sind neben den Einzelkosten auch anteilige Gemeinkosten einbezogen. Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer auf der Grundlage steuerlich anerkannter Höchstsätze abgeschrieben. Soweit steuerlich zulässig, wird für bewegliche Anlagegüter die degressive Abschreibungsmethode angewandt. Der Übergang zur linearen Methode erfolgt in dem Jahr, für welches die lineare Methode erstmals zu höheren Jahresabschreibungsbeträgen führt. Die übrigen Anlagegüter werden linear abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Wert von EUR 410,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben; ihr sofortiger Abgang wird unterstellt. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig. Bei beweglichen Vermögensgegenständen wird die Halbjahresregelung von R 44 Abs. 2 EStR in Anspruch genommen.

Bei den **Finanzanlagen** werden die Anteilsrechte und Wertpapiere zu Anschaffungskosten bzw. niedrigeren beizulegenden Werten und die Ausleihungen grundsätzlich zum Nennwert angesetzt.

Die **Vorräte** werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bzw. zu den niedrigeren Tageswerten angesetzt. Die Bestände an **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen** sind zu Einstandspreisen oder zu niedrigeren Tagespreisen am Bilanzstichtag aktiviert.

Die **unfertigen und fertigen Erzeugnisse** sind auf der Basis von Einzelkalkulationen, die auf der aktuellen Betriebsabrechnung beruhen, zu Herstellungskosten bewertet, wobei neben den direkt zu-rechenbaren Materialeinzelkosten, Fertigungslöhnen und Sondereinzelkosten auch Fertigungs- und Materialgemeinkosten sowie Abschreibungen entsprechend dem steuerrechtlichen Mindestumfang berücksichtigt werden. In allen Fällen wurde verlustfrei bewertet, d. h. es wurden von den voraussichtlichen Verkaufspreisen Abschläge für noch anfallende Kosten vorgenommen.

Alle erkennbaren Risiken im **Vorratsvermögen**, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, sind durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen; das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt.

Die **Rückstellungen für Pensionen und Vorruhestandsverpflichtungen** werden in steuerlich zulässiger Höhe ausgewiesen. Den nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelten Teilwerten gemäß § 6a EStG liegt unter Verwendung der Sterbetafeln 1998 ein Rechnungszinsfuß von 6 Prozent zugrunde.

Die **Steuerrückstellungen** und die **sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Zuschüsse auf Entwicklungsleistungen werden als **Erhaltene Anzahlungen** ausgewiesen.

Fremdwährungen wurden zu Umrechnungskursen am Tage ihrer Entstehung oder zu niedrigeren bzw. höheren Stichtagskursen bilanziert.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt:

Entwicklung des Anlagevermögens nach HGB

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				
	1.1.2003 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR	31.12.2003 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Software und Lizenzen	10.090.095,52	801.901,72	4.306.781,18	1.928.025,97	13.270.752,45
2. Geleistete Anzahlungen	11.276.114,48	245.896,89	-4.306.781,18	0,00	7.215.230,19
	21.366.210,00	1.047.798,61	0,00	1.928.025,97	20.485.982,64
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und Bauten	9.415.211,36	163.487,43	1.053.296,13	0,00	10.631.994,92
2. Technische Anlagen und Maschinen	90.836.569,50	2.344.672,36	9.217.472,80	30.732.428,05	71.666.286,61
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.929.747,52	1.145.228,64	71.470,29	* 683.996,66	5.462.449,79
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	14.949.349,18	6.762.396,55	-10.342.239,22	8.102.961,59	3.266.544,92
	120.130.877,56	10.415.784,98	0,00	39.519.386,30	91.027.276,24
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	32.093.026,34	255.257,13	0,00	0,00	32.348.283,47
2. Ausleihungen an ver- bundene Unternehmen	204.940,71	59.000,00	0,00	100.000,00	163.940,71
3. Beteiligungen	557.348,77	78.432,00	0,00	0,00	635.780,77
4. Ausleihungen an Unter- nehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.380.488,08	519.821,29	0,00	0,00	1.900.309,37
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	724.344,00	0,00	0,00	0,00	724.344,00
6. Sonstige Ausleihungen	0,00	100.000,00	0,00	8.650,00	91.350,00
	34.960.147,90	1.012.510,42	0,00	108.650,00	35.864.008,32
	176.457.235,46	12.476.094,01	0,00	41.556.062,27	147.377.267,20

* davon fiktiver Abgang geringwertiger Wirtschaftsgüter in Höhe von EUR 122.488,77

Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte		
1.1.2003 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR	31.12.2003 EUR	31.12.2003 EUR	31.12.2002 TEUR
5.468.102,87	1.587.561,41	0,00	1.211.576,60	5.844.087,68	7.426.664,77	4.622
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.215.230,19	11.276
5.468.102,87	1.587.561,41	0,00	1.211.576,60	5.844.087,68	14.641.894,96	15.898
1.070.995,60	818.275,00	0,00	0,00	1.889.270,60	8.742.724,32	8.344
63.930.948,49	6.539.552,14	-7.756,30	11.540.378,49	58.922.365,84	12.743.920,77	26.906
4.094.912,31	604.333,72	7.756,30	* 594.515,05	4.112.487,28	1.349.962,51	835
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266.544,92	14.949
69.096.856,40	7.962.160,86	0,00	12.134.893,54	64.924.123,72	26.103.152,52	51.034
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.348.283,47	32.093
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.940,71	205
229.000,00	81.000,00	0,00	0,00	310.000,00	325.780,77	328
571.000,00	320.000,00	0,00	0,00	891.000,00	1.009.309,37	809
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.344,00	724
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.350,00	0
800.000,00	401.000,00	0,00	0,00	1.201.000,00	34.663.008,32	34.160
75.364.959,27	9.950.722,27	0,00	13.346.470,14	71.969.211,40	75.408.055,80	101.092

Angaben zum Anteilsbesitz	Währung	Beteiligungen %	Eigenkapital in Tausend	Ergebnis in in Tausend
Inland				
GED Gärtner Elektronik Design GmbH, Frankfurt / Oder	EUR	73,90	289	14
ELMOS Central IT Services GmbH & Co. KG, Dortmund	EUR	100,00	173	574
ELMOS Facility Management GmbH & Co. KG, Dortmund	EUR	100,00	92	414
Gesellschaft für Halbleiterprüftechnik mbH, Dortmund	EUR	100,00	--	**--
attoSENSOR GmbH, Penzberg	EUR	30,00	-1.085	***-286
Advanced Appliances Chips GmbH, Riedstadt	EUR	33,33	--	***--
Exedra Grundstücksverwaltungsgesell- schaft mbH & Co. Vermietungs KG, Mainz	EUR	100,00	-1	*-7
Epigone Grundstücksverwaltungsgesell- schaft mbH & Co. Vermietungs KG, Mainz	EUR	100,00	-13	*-22
MECHALESS Systems GmbH, Karlsruhe	EUR	49,00	100	***1.009
Ausland				
ELMOS France S.A., Nanterre (F)	EUR	74,97	1.780	726
ELMOS Services B.V., Venlo (NL)	EUR	100,00	1.506	617
European Semiconductor Assembly (eurasem) B.V. Nijmegen (NL)	EUR	98,50	15.285	-743
ELMOS USA Inc., Michigan (USA)	USD	100,00	--	***--
* Zahlen des Geschäftsjahres 2002				
** es liegen bis jetzt keine Jahresabschlüsse der Gesellschaft vor				
*** die Zahlen basieren auf einem vorläufigen Jahresabschluss der Gesellschaft zum 30. September 2003				

Forderungen und Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben bis auf einen Betrag von TEUR 627 (Vj. TEUR 463) eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind aktivierte Forderungen auf Erstattung von verauslagten Entwicklungskosten in Höhe von TEUR 1.492 (Vj. TEUR 1.416) sowie ein Aktivwert aus Rückendeckungsversicherung in Höhe von TEUR 627 (Vj. TEUR 463) enthalten.

Eigenkapital

Das in der Bilanz zum 31. Dezember 2003 aus 19.300.000, auf den Inhaber lautenden, nennwertlosen Stückaktien bestehende Grundkapital in Höhe von EUR 19.300.000,00 ist voll eingezahlt.

Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 5. April 2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu EUR 9.650.000,00 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 9.650.000 Stück neuer, auf den Inhaber lautender Aktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlage kann das Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder teilweise in dem Beschluss über die Erhöhung des Grundkapitals ausgeschlossen werden, wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlage zehn vom Hundert des Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.

Darüber hinaus ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlage zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen auszuschließen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegen.

Das Grundkapital ist um EUR 1.000.000,00, eingeteilt in 1.000.000 nennwertlose Stückaktien, die auf den Inhaber lauten, mit einem auf die einzelne Aktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00, bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung von Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Führungsorgane und an Mitarbeiter verbundener Unternehmen. Sie wird nur insoweit durchgeführt, wie im Rahmen des Aktienoptionsprogramms der Gesellschaft nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 22. September 1999 Optionsrechte ausgegeben werden und die Inhaber dieser Optionsrechte diese ausüben. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Optionsrechten entstehen, am Gewinn teil.

Das Grundkapital ist um maximal bis zu EUR 5.000.000,00 eingeteilt in bis zu 5.000.000 auf den Namen lautende Stückaktien bedingt erhöht (bedingtes Kapital II). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Optionsscheinen oder Wandlungsrechten aus bis zum 25. April 2007 durch die Gesellschaft oder eine unmittelbare oder mittelbare inländische oder ausländische 100-prozentige Beteiligungsgesellschaft der Gesellschaft gemäß der Beschlussfassung der Hauptversammlung vom 26. April 2002 begebenen Options- oder Wandelschuldverschreibungen Gebrauch machen oder wie die zur Wandlung verpflichteten Inhaber der von der Gesellschaft oder deren unmittelbaren oder mittelbaren inländischen oder ausländischen 100-prozentigen Beteiligungsgesellschaften bis zum 25. April 2007 auszugebenden Wandelschuldverschreibungen ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Aus-

übung von Options- bzw. Wandlungsrechten oder durch Erfüllung von Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil.

Es bestehen Bezugsrechte gemäß § 192 Abs. 2 Nr. 3 AktG aus einem Aktienoptionsprogramm für Vorstandsmitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter zum Erwerb von 518.157 Aktien.

Bilanzgewinn

Im Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag von TEUR 20.461 enthalten; im Übrigen verweisen wir auf den unten stehenden Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns.

Rückstellungen

Die Pensionsrückstellungen wurden für Mitglieder des Vorstandes gebildet.

Die Steuerrückstellungen betreffen Ertragsteuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für Urlaubsansprüche, Tantiemen, Berufsgenossenschaft, Garantieleistungen, Lizenzen, nachkommende Rechnungen, Verluste aus schwebenden Geschäften, Aufsichtsratsvergütung und steuerliche Risiken gebildet.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten und die Besicherung der Verbindlichkeiten sind im nachfolgenden Verbindlichkeitspiegel im Einzelnen dargestellt.

Die Verbindlichkeiten enthalten keine gegenüber Gesellschaftern.

Verbindlichkeitspiegel in TEUR

Art der Verbindlichkeit	Gesamt 31.12.2003	Restlaufzeit			Gesamt 31.12.2002
		unter 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre	
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.714	12.158	556	0	13.874
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	28	28	0	0	122
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.505	5.505	0	0	7.488
4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	5.100	5.100	0	0	8.300
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.088	4.088	0	0	393
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2	2	0	0	7
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.127	2.127	0	0	7.503
(Vorjahr)	(7.503)	(7.503)	(0)	(0)	
– davon aus Steuern	354	354	0	0	5.071
(Vorjahr)	(5.071)	(5.071)	(0)	(0)	
– davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	556	556	0	0	592
(Vorjahr)	(592)	(592)	(0)	(0)	

Angabe von Art und Form der Sicherheiten

Die Darlehen sind durch Sicherungsübereignungen diverser angeschaffter Maschinen und Geräte sowie einer Grundschuld am gewerblichen Objekt Emil-Figge-Straße 83 / Heinrich-Hertz-Str. 1 und Joseph-von-Fraunhofer-Str. 9, 44227 Dortmund (Eigentümer: Exedra Grundstücksgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG) gesichert. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind, bis auf branchenüblich verlängerte Eigentumsvorbehalte von Lieferanten im Wesentlichen nicht besichert. Die sonstigen Verbindlichkeiten sind ebenfalls nicht besichert.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse

Die Gesellschaft hat 2003 eine Bürgschaft für eine Kreditlinie in Höhe von USD 1.500.000,00 übernommen, welche einem verbundenen Unternehmen gewährt wurde. Zum Abschlussstichtag hat das verbundene Unternehmen die Kreditlinie in Höhe von USD 1.366.614,00 in Anspruch genommen.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gesellschaft hat Leasingverträge für das Betriebs- und Verwaltungsgebäude, für Betriebsvorrichtungen und das Parkhaus sowie für ein weiteres Bürogebäude abgeschlossen, deren Laufzeiten sich bis 2006, 2010, 2020 und 2021 erstrecken. Außerdem hat die Gesellschaft Leasingverträge für technische Anlagen und Maschinen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung abgeschlossen, deren Laufzeiten sich bis 2007 erstrecken. Daneben bestehen Leasingverträge für den Fuhrpark, Büromaschinen und technische Anlagen und Maschinen in betriebsüblichem Umfang.

Infolge der am Bilanzstichtag bestehenden nicht-kündbaren oben genannten Verträge summieren sich die in den folgenden Jahren zu zahlenden Beträge wie folgt:

Leasingverträge

Jahr	TEUR
2004	13.698
2005	12.600
2006	16.568
2007	4.518
2008	3.712
Folgejahre	44.802

Aus erteilten Investitionsaufträgen besteht ein Bestellobligo von TEUR 4.757.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Umsatzerlöse

nach Sparten:	2003	2002
	TEUR	TEUR
Produktion	98.275	91.094
Entwicklung	4.233	3.966
Sonstiges	472	371
Nettoumsatzerlöse	102.980	95.431

Umsatzerlöse

nach Regionen:	2003	2002
	TEUR	TEUR
Inland	54.936	56.717
Übrige EU-Länder	32.935	25.659
USA	9.893	9.086
Übrige Länder	5.216	3.968
Nettoumsatzerlöse	102.980	95.431

Sonstige betriebliche Erträge

Bei den periodenfremden Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Erträge aus Anlagenabgängen (TEUR 3.856), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (TEUR 44), Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (TEUR 379) sowie Erträge aus der Aktivierung Mieterdarlehen (TEUR 299). Darüber hinaus werden im Wesentlichen Erträge aus Währungsdifferenzen, Projektförderungen, privater Pkw-Nutzung, Erhöhung des Aktivwertes der Rückdeckungsversicherung, Weiterberechnungen, Mieterträgen, Währungsdifferenzen und aus Schadenserstattungen ausgewiesen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Bei den periodenfremden Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um Aufwendungen aus Anlagenabgängen (TEUR 61) sowie Forderungsverluste (TEUR 685).

Sonstige Angaben

Aufsichtsrat

Prof. Dr. Günter Zimmer, Duisburg,
Institutsleiter (Vorsitzender)
Dr. Burkhard Dreher, Dortmund,
Dipl.-Volkswirt (stellvertretender Vorsitzender)
Herbert Sporea, Kiel,
Kaufmann
Dr. Roland Mecklinger, Steinfeld-Hausen,
Diplom-Ingenieur
Dr. Wolfgang Heinke, Reutlingen,
Diplom-Physiker
Dr. Karl-Thomas Neumann, Meine,
Diplom-Ingenieur (seit 30. April 2003)

Herr Prof. Dr. Günter Zimmer übt drei weitere Aufsichtsratsmandate (Wacker Siltronic AG, MANIA Technologie AG, active photonics AG), Herr Dr. Burkhard Dreher weitere drei (Deutsche Steinkohle AG, Harpen AG, Siepe AG), Herr Herbert Sporea übt zwei weitere Mandate aus (TOP Business AG und Beiratsmitglied der MECHALESS Systems GmbH seit Oktober 2003) und Herr Dr. Roland Mecklinger ein weiteres Aufsichtsratsmandat (OpenShop AG) aus.

Vorstand

Diplom-Kfm. Knut Siegfried Hinrichs, Glückstadt
(Vorsitzender)

Dr. rer.-nat. Klaus Weyer, Schwerte

Dr. rer.-nat. Peter Thoma, Unterschleißheim

Diplom-Ing. Reinhard Senf, Iserlohn

Gesamtbezüge des Vorstands

Die Bezüge des Vorstands teilen sich in fixe Bezüge und variable, erfolgsorientierte Bezüge auf, die sich prozentual aus dem Ergebnis des Konzerns vor Steuern ableiten. Eine langfristige Bindung wird durch die Ausgabe von Aktienoptionen erreicht, die jährlich vom Aufsichtsrat gemeinsam und in Übereinstimmung mit dem Aktienoptionsprogramm für die Mitarbeiter unterhalb des Vorstands beschlossen wird.

Demnach betragen die Bezüge des Vorstands für 2003 insgesamt TEUR 1.189. Hiervon entfällt auf den fixen Bestandteil TEUR 798 und auf den variablen Teil TEUR 391.

Bislang wurden von Seiten des Vorstands 60.000 Aktienoptionen gezeichnet.

Die Mitglieder des Vorstandes halten die folgende Anzahl an Aktien der ELMOS Semiconductor AG:

Aktienbestand Vorstand	Stück
Knut Hinrichs	0
Dr. Klaus Weyer	16.206
Dr. Peter Thoma	6.200
Reinhard Senf	2.700

Gesamtbezüge des Aufsichtsrats

Die Bezüge des Aufsichtsrats beliefen sich für 2003 insgesamt auf TEUR 158. Hiervon entfallen auf den fixen Bestandteil TEUR 90 (inkl. Spesen und Auslagen) und auf den variablen Teil TEUR 68.

An Aufsichtsratsmitglieder wurden in 2003 keine Aktienoptionen ausgegeben.

Für sonstige Dienstleistungen – insbesondere Beratungen – vergütete die Gesellschaft an Mitglieder des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2003 TEUR 147.

Die folgenden Mitglieder des Aufsichtsrates halten die angegebene Anzahl an Aktien der ELMOS Semiconductor AG:

Aktienbestand Aufsichtsrat	Stück
Herbert Sporea	2.265
Dr. Burkhard Dreher	1.900

Mitarbeiter

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Mitarbeiter:

Mitarbeiter:	2003	2002
Gewerbliche Arbeitnehmer	160	154
Angestellte (inkl. Teilzeitkräfte umgerechnet auf Vollzeit)	300	321
	460	475
Auszubildende	25	24
	485	499

Konzernverhältnisse

Die ELMOS Semiconductor AG befindet sich im mittelbaren Mehrheitsbesitz der EFH ELMOS Finanzholding GmbH, Dortmund, die nach § 290 Abs. 2 Nr. 2 HGB zur Aufstellung eines Konzernabschlusses verpflichtet ist. Die Aufstellung eines Konzernabschlusses durch die EFH ELMOS Finanzholding GmbH, Dortmund, zum 31. Dezember 2003 erfolgte bislang nicht.

Gewinnverwendungsvorschlag

Der Vorstand schlägt (in Übereinstimmung mit dem Aufsichtsrat) vor, den Bilanzgewinn von EUR 28.571.482,26 wie folgt zu verwenden:

Es soll eine Ausschüttung in Höhe von EUR 0,13 pro Aktie vorgenommen werden. Der Rest soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Erklärung gemäß § 161 AktG zum Corporate-Governance-Kodex

Die ELMOS Semiconductor AG hat für 2003 die nach § 161 AktG vorgeschriebene Erklärung abgegeben und den Aktionären zugänglich gemacht.

Vorstand und Aufsichtsrat der ELMOS Semiconductor AG erklären gemäß § 161 Aktiengesetz:

„Die ELMOS Semiconductor AG entspricht den Empfehlungen der »Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex« (kurz: »DCKG«) mit folgenden Ausnahmen:

- Die derzeit gültige D&O-Versicherung für Aufsichtsrat und Vorstand sieht keinen Selbstbehalt für die Organmitglieder vor (DCKG Nr. 3.8). Vor dem Hintergrund der unklaren Rechtslage hinsichtlich der persönlichen Haftung eines einzelnen Organmitglieds wird eine Anpassung der Versicherung zur Zeit nicht vorgenommen.
- Obgleich die Vergütung der Vorstandsmitglieder sowohl im Internet wie auch im Geschäftsbericht aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung (Aktioptionen) ausgewiesen werden, erfolgen diese Angaben summiert und nicht individualisiert (DCGK 4.2.4).
- Abweichend von den Empfehlungen sieht die Geschäftsordnung des Aufsichtsrates der ELMOS Semiconductor AG die Bildung von fachlich qualifizierten Ausschüssen und eines Prüfungsausschusses erst ab einer Anzahl von mehr als sechs Aufsichtsratsmitgliedern vor (DCGK Nr. 5.3.1 und 5.3.2).

- Auch die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten neben einer festen eine erfolgsorientierte Vergütung. Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder wird, aufgegliedert nach ihren Bestandteilen, sowohl im Internet wie auch im Geschäftsbericht aufgeführt, jedoch nicht individualisiert. Die von der ELMOS Semiconductor AG an die Mitglieder des Aufsichtsrates gezahlten Vergütungen für persönlich erbrachte Leistungen, insbesondere für Beratungs- und Vermittlungsleistungen, werden nicht individualisiert im Anhang zum Konzernabschluss angegeben (DCGK Nr. 5.4.5).“

Dortmund, im Februar 2004

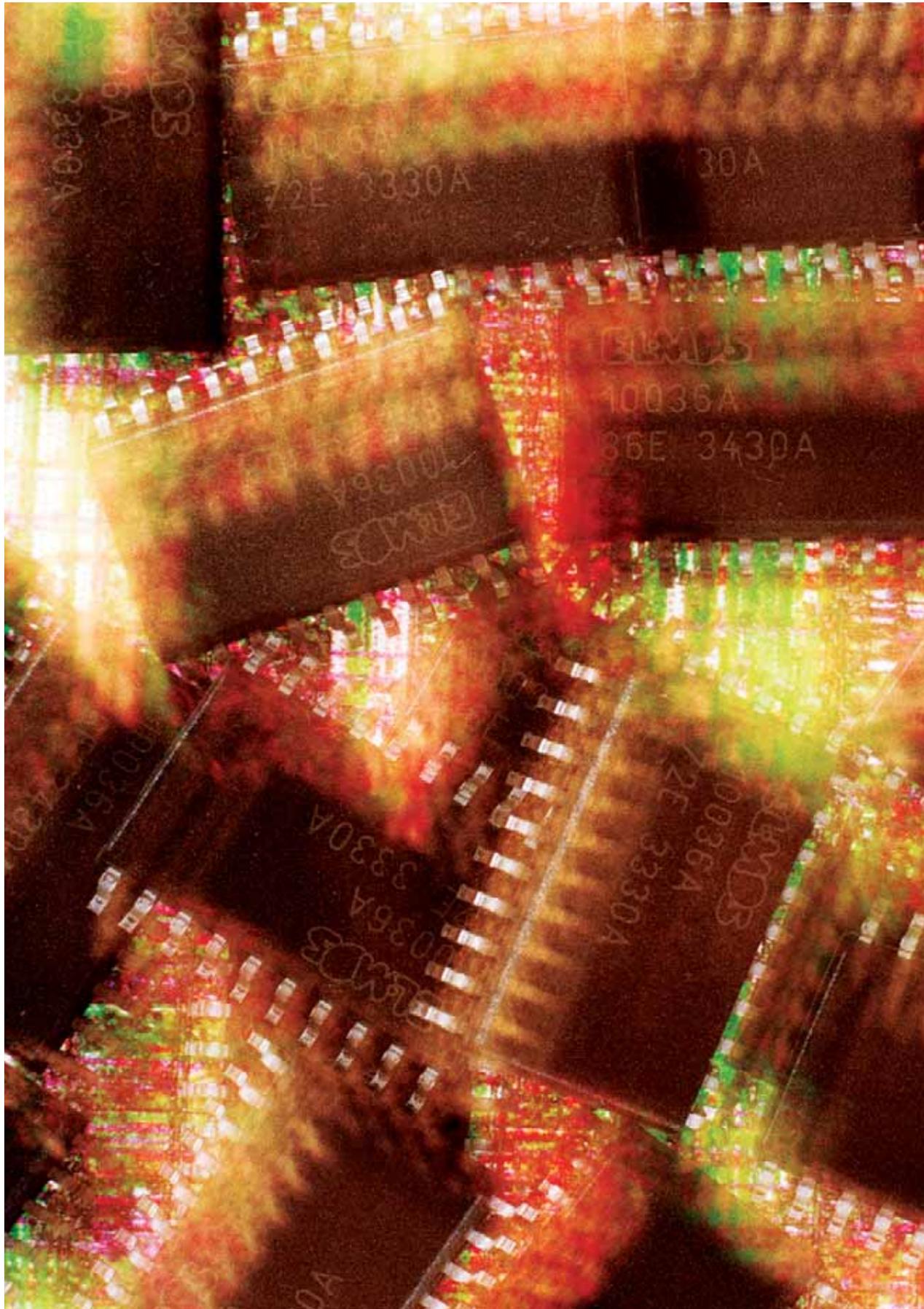
Der Vorstand

Knut Hinrichs

Dr. Klaus Weyer

Dr. Peter Thoma

Reinhard Senf





Produkte

ELMOS-Halbleiterchips verbessern Systeme in den Fahrzeugbereichen Sicherheit, Komfort, Umweltschutz und Kommunikation. Zahlreiche erfolgreiche Lösungen beweisen in nahezu allen europäischen Automobilen die ELMOS-Kompetenz. So vereinfachen ELMOS-Schnittstellenbausteine die Kommunikation im Fahrzeug. Multiplex-Bussysteme ersetzen die früher üblichen Punkt-zu-Punkt-Verbindungen in der Fahrzeugelektrik und ersetzen kilometerlange Kupferkabel. Derartige Spezialchips erweitern die Funktionalität, erhöhen die Sicherheit und Zuverlässigkeit und reduzieren gleichzeitig die Systemkosten.

Bericht über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2003 der ELMOS Semiconductor AKTIENGESELLSCHAFT, Dortmund

1. Geschäft und Strategie

a) Geschäftstätigkeit, Rahmenbedingungen sowie Ziele der Unternehmensleitung

Die ELMOS Semiconductor AG entwickelt, produziert und vertreibt hochintegrierte anwendungsspezifische mikroelektronische Schaltkreise vornehmlich für die Automobilindustrie. Auch im Jahr 2003 entfielen 91 Prozent vom Umsatz auf dieses Marktsegment.

ELMOS hat sich in den vergangenen 19 Jahren eine führende Marktposition als Halbleiterhersteller im europäischen Markt für Automobilelektronik erarbeitet. So werden elektronische Schaltkreise, sogenannte ASICs von ELMOS von nahezu allen europäischen Fahrzeugherstellern genutzt. Stetig wachsende Anforderungen an die Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und Umweltverträglichkeit eines Kraftfahrzeugs aber auch insbesondere an Sicherheit und Komfort der Fahrzeuginsassen führen zu immer mehr Elektronik im Auto. Halbleiterbausteine von ELMOS sind ideal geeignet, solche Systeme kompakt, zuverlässig und kostengünstig aufzubauen.

Seit Firmengründung ist es Strategie der ELMOS, mit eigenem Know-how geschützte Nischenmärkte zu bedienen. Sie ist auf der einen Seite durch eine konsequent an den Marktbedürfnissen optimierte Fertigungstechnologie und auf der anderen Seite durch die kundenspezifische Produktentwicklung gekennzeichnet. So werden ELMOS-Produkte in der Regel im Kundenauftrag für einen speziellen Anwendungsfall entwickelt und auch exklusiv für diesen Kunden produziert. Hierzu betreibt die ELMOS Semiconductor AG als Zentrale in Dortmund eine eigene Produktionsstätte für Halbleiterbauelemente.

Dieses Geschäftsmodell orientiert sich an den Anforderungen der Automobilindustrie sowie an den Bedürfnissen der Kunden nach Innovation, Qualität, Flexibilität und Liefertreue. Ziel der Unternehmensleitung ist, als kompetenter Partner der Kunden mit maßgeschneiderten, integrierten Schaltungen einem profitablen Geschäft nachzugehen und die eigenen Marktanteile zu erhöhen. Die daraus resultierende enge Kunden-Lieferantenbeziehung spiegelt sich in der verteilten Struktur der ELMOS-Gruppe wider. Diverse Niederlassungen, Tochterfirmen und Partnerfirmen an mehreren Standorten in Deutschland, Europa und den USA dienen der Vertriebs- und Applikationsunterstützung beim Kunden vor Ort.

Darüber hinaus unterstützen die produzierenden Tochterfirmen eurasem B.V. in den Niederlanden und SMI Inc. in den USA das Technologie- und Produktportfolio. Die dort entwickelten und produzierten speziellen Gehäusetechnologien und mikromechanischen Bauelemente (MEMS) werden bevorzugt in der Sensorik eingesetzt. Unter dem Motto „ASIC *plus* – more than a chip!“ wird somit ein erweitertes Geschäftsmodell für die Branche bereitgestellt. Hier will die Unternehmensleitung das Synergiepotenzial bei der Vermarktung der Kombination aus Halbleiterbauelementen, Sensoren und funktionalen Verpackungen als ganzheitlichen Systemansatz für ein weiteres kundenorientiertes Wachstum nutzen.

b) Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Nach dem Krisenjahr 2001 der Halbleiterindustrie mit einem Umsatzrückgang von 32 Prozent gegenüber dem Rekordjahr 2000 mit rund 204,4 Milliarden USD, wuchsen die Gesamtumsätze von rund 139,0 Milliarden USD in 2002 auf rund 166,4 Milliarden USD in 2003 weltweit wieder an. Damit konnte die Branche im abgelaufenen Jahr 2003 mit einem Umsatzanstieg von über 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr an zurückliegende hohe Wachstumsraten anknüpfen. Dennoch blieben die Umsätze 2003 noch um rund 19 Prozent hinter den Umsätzen des Jahres 2000 zurück.



Einen Nischenmarkt der globalen Halbleiterindustrie stellten Halbleiterchips für die Automobilindustrie dar. Mit einem Anteil von rund 8 Prozent vom Gesamtmarkt wuchsen die Umsätze für automobiler Halbleiter 2002 von etwa 13,2 Milliarden USD, 2003 auf rund 13,8 Milliarden USD an, dies entspricht einem Wachstum von rund 5 Prozent.

Dieses, im Vergleich zum Gesamtmarkt, wesentlich niedrigere Wachstum reflektiert zugleich die Entwicklung der automobilen Absatzmärkte. So hatten die europäischen Kraftfahrzeughersteller im abgelaufenen Jahr nicht nur mit einem ungünstigeren Wechselkursverhältnis Euro vs. U.S.-Dollar zu kämpfen. Auch die konjunkturelle Lage drosselte das Verhalten der Konsumenten in vielen Märkten.

So reduzierte sich 2003 die Anzahl der Neuzulassungen in Deutschland um rund 1 Prozent und in Frankreich um etwa 6 Prozent. Positiv hingegen entwickelten sich Spanien und Großbritannien, was insgesamt zu einem Rückgang der Neuzulassungen von rund 1 Prozent in Westeuropa führte. Trotz massiver „Incentive“-Aktionen verloren auch die USA in der Neuzulassungsstatistik rund 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Positiv hingegen entwickelten sich die fernöstlichen Märkte, insbesondere China, so dass die Weltnachfrage stagnierte.

Von diesem Trend setzten sich einige Fahrzeughersteller ab, die insbesondere im Premiumsegment erneut mit erfreulichen Absatzzahlen aufwarten konnten. So steigerte beispielsweise die BMW Group die Stückzahlen um rund 5 Prozent.

Dem weltweit stagnierenden Stückzahlmarkt stand erneut der anhaltende Trend nach mehr Elektronik im Fahrzeug gegenüber, von dem auch die ELMOS-Gruppe profitierte. Dies führte zu dem oben angeführten Wachstum des automobilen Halbleitermarktes. Für die Zukunft wird erwartet, dass der Anteil an Elektrik / Elektronik am Fahrzeugwert 2000 von rund 22 Prozent auf etwa 35 Prozent vom Fahrzeugwert im Jahr 2010 ansteigen wird – und damit auch der Anteil an Halbleiterbauelementen.

c) Darstellung des Geschäftsverlaufes

Die ELMOS-Gruppe konnte auch 2003 mit ihrem kundenspezifischen Ansatz ihren Marktanteil ausbauen und den Umsatz gegenüber dem Vorjahr um fast 11 Prozent auf rund 121,4 Millionen Euro steigern.

Dabei stiegen die Umsatzerlöse der ELMOS Semiconductor AG im Halbleiter-Kerngeschäft auf 102,3 Millionen Euro. Das nachhaltige Interesse der Kunden an individuellen Lösungen zeigt sich in der wiederholt hohen Anzahl neuer Entwicklungsprojekte. So konnten auch im abgelaufenen Jahr 31 Entwicklungsprojekte mit einem Umsatzvolumen über den Lebenszyklus von rund 227 Millionen Euro akquiriert werden.

Insgesamt sind im abgelaufenen Jahr 24 Entwicklungsprojekte in die Produktion überführt worden. Die Auslastung der Produktionskapazitäten konnte auf 69 Prozent zum Jahresende gesteigert werden. Im Ganzen wurden im Berichtsjahr über 80.000 Wafer gefertigt. Parallel hierzu wurden Kostensenkungsmaßnahmen innerhalb der gesamten ELMOS-Gruppe zur Effizienzsteigerung und Personaleinsparung durchgeführt.

Neben der Optimierung der Geschäftstätigkeit am Standort Dortmund lag ein wesentlicher Fokus der unternehmerischen Bemühungen auf den 2001 erworbenen Tochtergesellschaften SMI in den USA und eurasem in den Niederlanden. Die beiden Unternehmen, die Schwerpunkte des erweiterten ELMOS-Geschäftsmodells darstellen, wurden im Berichtsjahr planmäßig weiter ausgebaut. Nach Erwerb wurden inzwischen in die eurasem rund 12,8 Millionen Euro, in die SMI nebst ELMOS California originär rund 15,4 Millionen Euro in Gebäude und Maschinen investiert.

eurasem beschäftigte zum Jahresende 161 Mitarbeiter und erzielte 11,3 Millionen Euro Umsatz. Der Beitrag zum Gesamtkonzernumsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr lag bei 4,4 Millionen Euro. eurasem ist so ausgerüstet, dass ein wesentlicher Teil der bisher in Fernost für ELMOS abgewickelten Assembly-Leistungen auf eurasem übertragen werden kann. eurasem deckte am Jahresende 2003 rund 54 Prozent der Assembly-Leistungen für ELMOS ab. Neben der konzerninternen Assemblierung ist die Gesellschaft auch in der Verarbeitung von Sondergehäusen für Drittkunden tätig.

Trotz kontinuierlicher Verbesserung war das Betriebsergebnis der eurasem im letzten Quartal noch negativ. Der Jahresfehlbetrag der Gesellschaft betrug 0,8 Millionen Euro in 2003. Mit steigender Auslastung und den eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen erwartet die Geschäftsleitung im Jahr 2004 ein deutlich verbessertes Ergebnis. Dies soll auch durch die Verbreiterung des Geschäftsfeldes der eurasem geschehen. Hierzu ist geplant, zusätzlich zu den Assembly- auch Testkapazitäten am Standort Nijmegen aufzubauen.

Die Tochterfirma SMI in Milpitas, Kalifornien, beschäftigte zum Jahresende 75 Mitarbeiter für die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von mikromechanischen Bauelementen. Die Gesellschaft trug im abgelaufenen Geschäftsjahr 9,3 Millionen Euro gegenüber 7,3 Millionen Euro im Vorjahr zum Gesamtkonzernumsatz bei. Dies entspricht auf Euro-Basis einem Umsatzwachstum von rund 27 Prozent, auf USD-Basis sind es sogar 56 Prozent.

Der Jahresfehlbetrag 2003 der Gesellschaft beträgt unverändert nur 0,2 Millionen Euro und resultiert vor allem aus umbaubedingten Störungen im Produktionsprozess. Das Betriebsergebnis des ersten und des dritten Quartals waren sogar positiv. Die Aus- und Umbauarbeiten konnten im Berichtsjahr beachtlich voran getrieben werden.

Durch den Ausbau der Fabrik und der im Jahr 2004 weiter zu führenden Umstellung von 100mm auf 150mm Waferdurchmesser ist SMI einer der wenigen MEMS-Anbieter mit einer modernen eigenen Fertigungslinie und besitzt somit im Silicon Valley

ein Alleinstellungsmerkmal. Dies ermöglicht SMI die Akquisition von weiteren Foundry-Aufträgen, die zusammen mit der steigenden internen Produktionsmenge zu einer besseren Nutzung der Produktionskapazitäten führt. Neue Produkte wurden im Berichtsjahr am Markt vorgestellt und werden 2004 erste Umsatzbeiträge liefern.

Auch die US-Tochter ELMOS NA in Detroit konnte im Berichtsjahr ihre Erschließung der amerikanischen Automobil-Zulieferindustrie fortsetzen. Die Mitarbeiterzahl verblieb bei 24. Aufgrund der spezifischen Eigenarten des Geschäftsmodells waren auch 2003 durch signifikante Vorfinanzierung von Entwicklungsleistungen planmäßig Verluste zu verzeichnen. Erträge aus eigenen Serienprodukten für amerikanische Kunden wurden erstmals gegen Ende 2003 erzielt. Dadurch wurden erste Deckungsbeiträge für die Entwicklungsaufwendungen eingenommen.

Sowohl die Anteile an SMI als auch die an ELMOS NA werden seit 2003 durch die ELMOS USA Inc., Michigan / USA als 100-prozentige Tochtergesellschaft der ELMOS Semiconductor AG gehalten.

Die ELMOS Semiconductor AG hält eine 30-prozentige Beteiligung an der Firma attoSENSOR in Penzberg. attoSENSOR entwickelt innovative Sensorensysteme für die Positionsbestimmung unter Verwendung von patentiertem Know-how und ASICs von ELMOS. Die für die attoSENSOR-Produkte laufenden ASIC-Entwicklungen wurden 2003 abgeschlossen. Nach zahlreichen Verzögerungen der Entwicklungsarbeiten in den vergangenen Jahren aufgrund unvorhergesehener Schwierigkeiten waren damit endlich die Voraussetzungen gegeben, um die Vertriebsaktivitäten zu forcieren und diese Produkte am Markt einzuführen. Es konnten erste Umsätze durch Musterstückzahlen mit Industriekunden für Anwendungen in der Transporttechnik erzielt werden, die die Basis für die 2004 erwarteten Umsätze sind. Das Geschäftsjahr war durch Vorleistungen gekennzeichnet und schloss mit einem Verlust in Höhe von rund 0,4 Millionen Euro ab.



Damit folgt attoSENSOR mit etwa zwei Jahren Verzögerung dem Geschäftsplan, der die Situation des Jahres 2003 bereits für 2001 erwartet hatte. Auf der anderen Seite zeigen die Vertriebsserfolge, die sich durch die Alleinstellungsmerkmale der Produkte begründen, die Richtigkeit des eingeschlagenen Wegs. Das Jahr 2004 wird höhere Umsätze ausweisen, die jedoch noch nicht zu einem positiven Betriebsergebnis führen werden. Dies wird erst im Jahr 2005 erwartet.

Zur finanziellen Überbrückung dieser Anlaufphase wird im Laufe des Jahres 2004 eine Kapitalerhöhung bei attoSENSOR notwendig werden. Es wurde eine weitere Teilwertberichtigung im Konzern in Höhe von rund 0,2 Millionen Euro auf den Beteiligungsansatz vorgenommen.

Zur Absicherung der Investitionen in die Akquisition der HALIOS-Technologie wurde mit Vertrag vom 7. August 2003 eine 49-prozentige Beteiligung an der MECHALESS GmbH in Karlsruhe gezeichnet. Innerhalb der MECHALESS werden die Software- und Hardware-Aktivitäten der HALIOS-Erfinder und die ELMOS-Tätigkeiten im Bereich der optischen Sensorsysteme zusammengeführt, optimiert und gezielt vermarktet. Auf Basis erster Muster und dem in Serienproduktion befindlichen Regensensor konnte MECHALESS im zurückliegenden Jahr zahlreiche neue Entwicklungsprojekte und Machbarkeitsstudien in den Bereichen Automotive, Industrie und Telekommunikation gewinnen, darunter auch drei ASIC-Aufträge für ELMOS.

Zur Erweiterung der Entwicklungskapazitäten hat ELMOS 2002 eine Option auf den Erwerb einer qualifizierten Mehrheit an der DMOS GmbH, einem ASIC-Designhaus mit 18 Mitarbeitern in Dresden, erworben. DMOS ist exklusiv im Bereich der ASIC-Entwicklung für die ELMOS-Gruppe tätig.

d) Auftragseingang und Auftragsbestand

Der Auftragseingang der ASIC-Produktion des Jahres 2003 belief sich auf 115,6 Millionen Euro und lag damit um 19 Prozent über dem Auftragseingang des Vorjahres. Auf Jahresbasis stieg die Book-to-bill-Rate deutlich auf einen Wert von 1,13 gegenüber dem Vorjahr mit dem Wert von 1,03.

e) Produktion

Seit Mitte des Geschäftsjahres 1999 produziert ELMOS ausschließlich auf der 150mm-Wafer-Linie in Dortmund. Diese wurde in den Jahren 2000 bis 2003 planmäßig ausgebaut, um für die nächsten Technologie-Generationen und den steigenden Kapazitätsbedarf der Produktion vorbereitet zu sein.

Die Produktionsräume und -anlagen am Standort Dortmund befinden sich für Prozesse mit Strukturbreiten bis 0,35 Mikrometer auf dem modernsten Stand der Technik. Sie bilden damit eine solide Plattform für die ELMOS-Produktion der nächsten zehn Jahre. Die Maschinen-Kapazität lag zum Jahresende bei etwa 400 Waferstarts pro Tag, wovon etwa 275 Waferstarts pro Tag genutzt wurden (rund 69 Prozent). Die Kapazität kann durch Rekrutierung weiterer Mitarbeiter und durch geringfügige Investitionen in Maschinen auf bis zu 500 Waferstarts pro Tag erweitert werden.

f) Forschung und Entwicklung

Zukunftssichernd sind die Konzernaufwendungen für Forschung und Entwicklung, die auch im Jahr 2003 auf einem relativ hohen Niveau von rund 20,4 Millionen Euro bleiben. Sie stiegen damit im Vergleich zum Vorjahr auf eine Quote von rund 17 Prozent vom Gesamtumsatz an. Sie spiegeln die ELMOS-Anstrengungen wider, die Einführung neuer Technologien und Produkte deutlich zu beschleunigen. Besonderen Anteil an den Kosten haben neben den zahlreichen Entwicklungen neuer Produkte die Aktivitäten zur Entwicklung neuer Prozesstechnologien mit kleineren Strukturgrößen und FLASH-Option sowie die Weiterentwicklung der Silicon-On-Insulator-Technologie.

Die Integration der Motorola HC12 / Star12-Zellbibliotheken und die Portierung der Motorola Design-Methodik in die ELMOS-Designumgebung wurde erfolgreich abgeschlossen. Erste Produkte werden bei einem Kooperationspartner entwickelt.

g) Personal- und Sozialbereich

ELMOS beschäftigte im Geschäftsjahr 2003 konzernweit im Mittel insgesamt 874 Mitarbeiter (davon 25 Auszubildende) gegenüber im Mittel 830 Mitarbeitern in 2002. Die ELMOS Semiconductor AG in Dortmund beschäftigte im Jahresmittel 485 Mitarbeiter.

Eine langfristige Bindung an das Unternehmen und eine Erfolgsbeteiligung der Mitarbeiter wird über jährliche Aktienoptions-Programme erreicht. Diese Programme sehen die Ausgabe von Aktienoptionen an Mitarbeiter unterhalb des Vorstands und zu identischen Bedingungen an den Vorstand vor. Der Ausgabebetrag pro Option bestimmt sich aus dem 10-Tage-Mittel des amtlichen Börsenkurses der ELMOS-Aktie vor dem Beschlussstag und einer Ausübungshürde in Höhe von 20 Prozent. Die Optionen können frühestens nach einer Frist von zwei Jahren ausgeübt werden und haben eine Laufzeit von fünf Jahren. Die Ausübung kann nur in bestimmten Ausübungszeiträumen erfolgen. Für dieses Aktienoptions-Programm steht durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22. September 1999 ein bedingtes Kapital bis zu einem Betrag von 1,0 Million Euro zur Verfügung.

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 19.12.2003 den Beschluss des Vorstands über die Ausgabe von bis zu 240.000 Aktienoptionen für Mitarbeiter unterhalb des Vorstands sowie 60.000 Aktienoptionen für den Vorstand zu einem Ausgabekurs von 11,59 Euro genehmigt. Von Seiten der Mitarbeiter und des Vorstands wurden 286.160 Aktienoptionen aus dem Jahr 2002 im Jahr 2003 gezeichnet. Insgesamt wurden bisher 518.157 Aktienoptionen aus den Jahren 1999 bis 2002 gezeichnet, jedoch bisher keine Optionen ausgeübt.

2. Lage der Gesellschaft

a) Ertragslage

Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte der Konzern mit 121,4 Millionen Euro den Umsatz des Vorjahres von 109,7 Millionen Euro um rund 11 Prozent übertreffen. Die regionale Verteilung der Umsätze im Gesamtkonzern zeigt eine Steigerung auf rund 55 Prozent in Deutschland zum Ende des Jahres 2003 nach etwa 52 Prozent im Vorjahr auf. Dies ging zu Lasten des europäischen Auslands, welches 2002 von gut 28 Prozent 2003 auf nunmehr 24 Prozent nachgab. Auch die Umsatzbeiträge in Amerika gaben – währungsbedingt – leicht nach, sie erreichten im abgelaufenen Jahr 15 Prozent nach gut 16 Prozent im Jahr 2002. Sie teilten sich je zur Hälfte auf ELMOS NA, Segment ASICs, und SMI, Segment Mikromechanik, auf.

Die Mehrerlöse von 11,7 Millionen Euro gingen 2002 mit einem unterproportionalen Anstieg der Herstellkosten von rund 4,1 Millionen Euro einher, so dass die Bruttomarge von 49 Prozent 2002 um drei Prozent auf absolut rund 51 Prozent vom Umsatz des Jahres 2003 gesteigert werden konnte, derweil das Bruttoergebnis mit 61,4 Millionen Euro gar um 14 Prozent höher lag.

Dies ermöglichte es der Gesellschaft, die Aufwendungen für die Entwicklung neuer Produkte und Prozesse mit 20,4 Millionen Euro um rund 16 Prozent zu steigern. Damit gelingt es dem Unternehmen, die drei Ziele Umsatz, Ertrag und wachsende Aufwendungen für ein langfristig ertragreiches Wachstum in Einklang zu bringen.

Das Betriebsergebnis stieg 2003 auf 21,6 Millionen – oder knapp 18 Prozent vom Umsatz –, gleichbedeutend mit einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr von rund 3,3 Millionen Euro.

Dank der eingeführten Kostensenkungsprogramme, die im Berichtsjahr einen einmaligen außerordentlichen Aufwand von rund 1,0 Millionen Euro erforderten, erreichte der Jahresüberschuss im Konzern rund 10,0 Millionen Euro und übertraf damit den Vorjahreswert von 8,9 Millionen Euro. Dies ist um so bemerkenswerter, da finanzielle Belastungen durch den weiteren Aufbau der Töchter und höhere Leasingaufwendungen hinzu kamen.



Im Einzelabschluss der ELMOS Semiconductor AG liegt das Jahresergebnis mit 8,1 Millionen Euro unter dem Vorjahresniveau. Dies resultiert hauptsächlich aus den im Berichtsjahr neu angefallenen Leasingaufwendungen, dem Anstieg der bezogenen Entwicklungsleistungen sowie den Restrukturierungskosten im Personalbereich.

b) Finanzlage

Im zurückliegenden Geschäftsjahr wurden im Konzern insgesamt Investitionen in Höhe von 25,3 Millionen Euro getätigt. Davon entfielen auf das Segment Halbleiter 17,5 Millionen Euro, auf Mikromechanik und Assembly jeweils rund 3,9 Millionen Euro. Für den Erwerb weiterer Grundstücksflächen und Gebäude am Standort Nijmegen, in denen ab 2005 neben den Assembly-Aktivitäten auch das Testen der gehäusten Bauelemente vorgenommen werden soll, wurden rund 1,7 Millionen Euro aufgewandt. Bilanzwirksam nach US-GAAP mit 3,4 Millionen Euro wurde außerdem die Aufstockung des Verwaltungsgebäudes der ELMOS in Dortmund, die im vierten Quartal vom Finanzinvestor abgerechnet wurde.

Sale- and Lease-back Transaktionen mit einem Gesamtwert von 29,5 Millionen Euro wurden im Geschäftsjahr 2003 getätigt. Zusammen mit dem operativen Cash-Flow konnten damit nicht nur die Investitionen finanziert werden, sondern darüber hinaus auch Steuer-Rückstellungen in Höhe von 11,9 Millionen Euro für Vorjahre und 3,1 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2003 getilgt werden. Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten in der ELMOS-Gruppe wurden um 4,5 Millionen Euro zurück geführt.

Zwei im Jahr 2003 als Finance-Lease qualifizierte Leasingmaßnahmen führten zu einer Zunahme der langfristigen Bankverbindlichkeiten in Höhe von 6,6 Millionen Euro. Die Liquidität der ELMOS-Gruppe stieg von 9,0 Millionen Euro um 8,4 Millionen Euro auf 17,4 Millionen Euro am Ende des Berichtsjahres. Im Geschäftsjahr 2003 konnte die effektive Steuerquote der ELMOS-Gruppe trotz der 1,5-prozentigen Erhöhung des Ertragsteuersatzes in Deutschland von 42,98 Prozent auf nunmehr 40,79 Prozent reduziert werden.

c) Vermögenslage

Im abgelaufenen Geschäftsjahr ist das Anlagevermögen der ELMOS Semiconductor AG im Wesentlichen aufgrund von Sale-and-Lease-back Transaktionen zurückgegangen. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind im Geschäftsjahr vor allem wegen gewährter Darlehen und erhöhter Geschäftstätigkeit angestiegen.

Die Eigenkapitalquote des ELMOS Konzerns beträgt zum 31. Dezember 2003 fast 61 Prozent; in der ELMOS Semiconductor AG erhöhte sich die Eigenkapitalquote auf 78 Prozent der Bilanzsumme. Es kann deshalb davon ausgegangen werden, dass die Gesellschaft auch mehrere schwierige Jahre mit schwacher Marktnachfrage durchstehen könnte. Damit ist der erfolgreiche Fortbestand des Unternehmens für die nächsten Jahre gesichert.

Das gezeichnete Grundkapital der Gesellschaft beträgt 19.300.000,00 Euro und ist eingeteilt in 19.300.000 Stückaktien ohne Nennwert mit einem rechnerischen Wert von einem Euro. Alle Aktien sind voll eingezahlt.

d) Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres

Es sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung zu berichten.

3. Risikobericht

a) Risikomanagementsystem

Die ELMOS AG hat im Berichtsjahr das im Vorjahr eingerichtete umfassende Risikomanagementsystem, das die Anforderungen des § 91 (2) AktG erfüllt, Zug um Zug auf die Unternehmen im Konzern angewendet und weiter verfeinert. Das Risikomanagementsystem und seine Anwendung wurde von unserer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Jahresende kritisch auf Konformität mit den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches und des Aktiengesetzes geprüft und für geeignet befunden. Es sieht die regelmäßige Erfassung und Bewertung von neuen und bekannten Risiken durch die verantwortlichen Mitarbeiter vor und legt ein geschlossenes Reporting-System fest. Damit werden Vorstand und Aufsichtsrat regelmäßig über die Risikolage informiert und können geeignete Maßnahmen zur Risikominderung beziehungsweise Risikovermeidung oder -abwehr beschließen. Dieses Risikomanagementsystem wird auch 2004 kontinuierlich erweitert und verbessert werden.

b) Abhängigkeit von der Automobilindustrie

Das Kerngeschäft der Gesellschaft steht in direktem Zusammenhang mit der Nachfrage der Automobilindustrie nach ASICs. Diese Nachfrage ist einerseits abhängig von den produzierten Stückzahlen an Personenkraftwagen und wird andererseits von dem anhaltenden Trend zu mehr Elektronik im Auto gesteuert. Durch die Zunahme an elektronischer Ausrüstung im Auto wie z.B. Airbag-Systeme, elektronische Fahrwerkstabilisierung (ESP, DSC), Komfortfunktionen etc., steigen die Stückzahlen an verkauften ASICs auch dann, wenn die Zahl der produzierten PKWs abnimmt.

Dabei ist zu beobachten, dass die Automobilindustrie häufig in absatzschwächeren Zeiten die Fahrzeuge mit höherwertiger Ausrüstung zum Komplettpreis anbietet, so dass auch bei stagnierender oder zurückgehender Automobilproduktion die Zahl der verkauften ASICs nicht unbedingt sinkt. Die Nachfrage nach ASICs ist damit relativ robust und unterliegt nur bedingt den Schwankungen der Kfz-Stückzahlen.

Die nähere Betrachtung des weltweiten Halbleitermarktes zeigt, dass nur 6 bis 8 Prozent der Chips in der Automobilelektronik eingesetzt werden. Dies macht dieses Marktsegment für die global tätigen, großen Halbleiterhersteller weniger interessant. Gleichzeitig sind 6 bis 8 Prozent des Gesamthalbleitermarktes aber gleichbedeutend mit rund 17,3 Milliarden USD im Jahr 2005, so eine Datenerhebung von Dataquest, und stellen somit ein riesiges Wachstumspotential für ELMOS dar. Selbst unter der Berücksichtigung, dass ELMOS-Produkte – also kundenspezifische ASICs – nur etwa 1/3 dieses Marktes ausmachen, wird der adressierbare weltweite Markt 2005 rund 6 Milliarden USD betragen.

Europa ist weiterhin der dominierende Markt für Automobilelektronik und ELMOS ist hier inmitten der Innovationszentren der Fahrzeughersteller gut positioniert.

Der Automobilmarkt unterlag in der Vergangenheit als Folge von Zusammenschlüssen von Herstellern, restriktiver Umweltgesetzgebung und anderen Faktoren, beachtlichen Schwankungen. Die ELMOS-Kundenstruktur lässt sicherlich eine gewisse Abhängigkeit von einigen großen Automobilzulieferern erkennen. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass es sich dabei – aufgrund der Bedeutung und der Spezialisierung der ASICs von ELMOS für das Produkt des Automobilzulieferers – um eine gegenseitige Abhängigkeit handelt, so dass größere Umsatzvolumina mit einigen Großkunden auch auf vielversprechende langfristige Kundenbeziehungen mit entsprechenden Umsatzpotenzialen hindeuten. Da die Automobilzulieferer selbst unter erheblichem Kostendruck stehen und die gleichzeitige Entwicklung eines ASICs durch zwei Lieferanten erhebliche Mehrkosten zunächst im Entwicklungsbereich und später wegen der geringeren Stückzahlen für den einzelnen ASIC-Lieferanten auch im Fertigungsbereich bedeuten, kommt es nur sehr selten vor, dass ein und derselbe ASIC an zwei Lieferanten gleichzeitig vergeben wird.



c) Wettbewerb und Mitarbeiter

Eine Vielzahl von Wettbewerbern im Halbleitermarkt für automobiler Anwendungen bietet ähnliche Produkte wie ELMOS auf ähnlicher technologischer Grundlage an. Darüber hinaus ist nicht auszuschließen, dass große Halbleiterhersteller, die bisher noch gar nicht oder nur zu einem geringen Prozentsatz im automobilen Halbleitermarkt tätig sind, in Zukunft versuchen werden, in dieses Marktsegment einzudringen. Derartige Versuche konnten im Jahr 2003 bei mehreren Wettbewerbern beobachtet werden. Da diese Großproduzenten aus Rentabilitätsgründen sich allerdings auf großvolumige Projekte fokussieren müssen, ist ihr Engagement im Nischenmarkt der kundenspezifischen Schaltungen stets relativ gering. Damit erscheint das Risiko für ELMOS vergleichsweise gering.

Die sehr entwicklungsintensive Geschäftstätigkeit des Unternehmens führt zu einem stark ausgeprägten und sehr spezifischen Ingenieur-Know-how – jedoch nur teilweise zu Patenten. Somit ergibt sich für ELMOS eine erhöhte Abhängigkeit von bestimmten Mitarbeitern. Das Fluktuationsrisiko reduziert sich bei ELMOS durch die erkennbar hohe Motivation und Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen. Die Mitarbeiter sind über ein Aktienoptions-Programm am Erfolg der ELMOS beteiligt.

d) Entwicklung neuer Produkte und Technologien

Bei der kundenspezifischen Entwicklung von Produkten ist zu berücksichtigen, dass bei der Akquisition eines neuen Auftrages die Einmalkosten im Entwicklungsbereich heute in der Regel nicht mehr in vollem Umfang als Vorabzahlung von den Kunden erlangt werden können. Es wird zwar in aller Regel ein erheblicher Teil der Entwicklungskosten vom Kunden zeitnah erstattet, ein gewisser Teil kann jedoch meist nicht mehr vorab gedeckt werden und muss über die späteren Stückzahlen in der Serie amortisiert werden. Hier besteht ein gewisses Risiko, dass bei Entwicklungen, die nicht in eine Lieferbeziehung einmünden, nicht amortisierte Kosten bei der Gesellschaft verbleiben.

Der Markt für die ELMOS-Produkte ist durch ständige Weiterentwicklung und Verbesserung der Produkte gekennzeichnet. Der ELMOS-Erfolg ist deshalb stark von der Fähigkeit abhängig, neue komplexe Produkte preisgünstig zu entwickeln, sie rechtzeitig im Markt einzuführen und zu erreichen, dass diese Produkte von führenden Zulieferern der Automobilindustrie ausgewählt werden.

Der zukünftige Erfolg von ELMOS ist auch von der Fähigkeit abhängig, neue Entwicklungs- und Produktionstechnologien zu entwickeln. ELMOS entwickelt analoge und digitale Halbleiterstrukturen und -funktionen für ihre selbst entwickelte modulare Hochvolt-CMOS-Prozesstechnologie. Wie auch die Konkurrenten muss ELMOS ihre Technologie ständig weiterverbessern und neue Prozesstechnologien für die fortschreitende Verkleinerung der Strukturen im Submikronbereich entwickeln.

Sollte ELMOS zukünftig nicht in der Lage sein, neue Produkte und Produktverbesserungen zu entwickeln, zu produzieren und abzusetzen, dürfte dies signifikante Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben.

Durch die Fähigkeit von ELMOS, ASICs für alle Arten von elektronischen Geräten im Automobil zu entwickeln und zu fertigen, sind ELMOS-Produkte in fast allen elektronischen Komponenten eines PKW vertreten, so dass das Risiko des Wegfalls eines Auftrages für eine einzelne elektronische Komponente breit gestreut und praktisch nicht vorhanden ist. Zwar könnte ein mehrjähriger Einbruch der Automobilindustrie, der die Automobilunternehmen veranlasst, keine neuen elektronischen Produkte zu entwickeln, die Gesellschaft in ihrer Entwicklung nachhaltig beeinträchtigen. Ein derartiger Einbruch ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht abzusehen, insbesondere weil – wie bereits oben erwähnt – die Automobilindustrie in schlechteren Zeiten eher dazu neigt, die technische Ausstattung zu erhöhen. Außerdem ersetzen kundenspezifische ASICs von ELMOS in zunehmendem Maße elektronische Standardbauteile, so dass ELMOS stärker als der Gesamtmarkt wachsen und ihren Marktanteil vergrößern kann. So können selbst Risiken, die mit dem even-

tuellen Verlust von Entwicklungsaufträgen für ASICs in der Automobilindustrie verknüpft sind, reduziert werden.

Die derzeitige Fertigungskapazität von ELMOS kann für das geplante Wachstum des jetzt begonnenen Geschäftsjahres 2004 und auch noch für die Jahre 2004/5 als ausreichend angesehen werden. Ab 2006 wird jedoch voraussichtlich eine Ausweitung der Produktionskapazitäten erforderlich, um das weiter geplante Wachstum zu ermöglichen. Hierzu werden derzeit Verhandlungen mit der Fraunhofer Gesellschaft geführt mit dem Ziel, die Fertigungslinie des Institutes in Duisburg anzumieten und zu betreiben. Damit erhält ELMOS Zugang zu einer zusätzlichen Fertigungskapazität für 200mm Wafer, die für ein geplantes Umsatzwachstum bis in die Jahre 2007/2008 ausreicht.

e) Beschaffung

Die von ELMOS für die Fertigung benötigten Rohstoffe sind weltweit bei verschiedenen Lieferanten verfügbar und unterliegen keinem Monopol. Branchentypisch ist dabei eine gewisse Abhängigkeit von einzelnen fernöstlichen Partnern im Assembly-Bereich. Hier hat ELMOS mit dem Erwerb der eurasem jedoch die Weichen für eine vertikale Vertiefung der Wertschöpfungskette gestellt. eurasem hat zum Jahresende 2003 etwa 54 Prozent der von ELMOS benötigten Assembly-Dienstleistungen erbracht. Dadurch wird ELMOS zunehmend von den fernöstlichen Partnern bzw. von Dollarschwankungen unabhängiger.

f) Produkthaftung

Die von ELMOS produzierten ASICs werden als Komponenten in komplexe elektronische Systeme integriert. Fehler oder Funktionsmängel der von ELMOS hergestellten ASICs oder der elektronischen Systeme, in die sie integriert sind, können direkt oder indirekt Eigentum, Gesundheit oder Leben Dritter beeinträchtigen. ELMOS ist nicht in der Lage, ihre Haftung gegenüber Abnehmern oder Dritten in ihren Absatzverträgen zu reduzieren oder auszuschließen.

ELMOS verfolgt konsequent eine Null-Fehler-Strategie und investiert stetig in die Erkennung und Vermeidung von Fehlerquellen und Fehlern. So werden die einzelnen Halbleiterchips hinsichtlich ihrer Qualität und Funktion im Werk im Regelfall gleich mehrfach bei unterschiedlichen Temperaturen getestet. Obwohl die Gesellschaft die nach TS 16949, VDA 6.1 und QS 9000 zertifizierten Qualitätskontrollsysteme sowie weitreichende Testverfahren vor der Auslieferung ihrer Produkte einsetzt, können sich Produktfehler möglicherweise erst nach Installation und Gebrauch der Produkte durch den Endverbraucher zeigen.

Wenn solche Produktfehler auftreten, kann dies teure und zeitaufwendige Produktmodifikationen nach sich ziehen und zu Störungen der Kundenbeziehungen sowie zum Verlust von Marktanteilen führen. Ein Qualitätsproblem ganzer Chargen könnte zudem zu Regressansprüchen der Kunden im Millionenbereich führen. Dieses Risiko ist angemessen versichert. All dies könnte jedoch negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben.

g) Betriebsunterbrechung

Neben den bereits dargestellten und erläuterten Geschäftsrisiken ist unseres Erachtens das einzige betriebliche Risiko, das die Entwicklung des Konzerns wesentlich beeinträchtigen und den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnte, das Risiko der Zerstörung der Fertigungsanlagen durch Feuer oder andere Katastrophen. Zwar ist das Betriebsunterbrechungsrisiko durch solche Ereignisse angemessen versichert, jedoch bestünde in einem solchen Fall eine erhebliche Gefahr des Verlustes von Schlüsselkunden. Dieses Risiko ist nicht versicherbar.

Es ist geplant, dieses Risiko dadurch deutlich zu reduzieren, dass zukünftig eine weitere Fertigungslinie (200mm-Linie) beim Fraunhofer-Institut in Duisburg von ELMOS betrieben und später in einem separaten Gebäude am Standort Dortmund eine weitere Produktionslinie errichtet wird. Dann würde ELMOS über mehrere unabhängige Fertigungslinien verfügen und würde im Falle einer Störung einer Linie zumindest noch über die anderen Produktionskapazitäten verfügen.



Die üblichen versicherbaren Risiken wie Feuer, Feuerbetriebsunterbrechung, Wasser, Sturm, Diebstahl, Haftpflicht, insbesondere Produkthaftpflicht, auch in den USA, sowie die Kosten eines etwaigen Rückrufs sind angemessen versichert. Weitere Risiken, die die Entwicklung des Unternehmens / Konzerns wesentlich beeinträchtigen oder den Fortbestand des Unternehmens / Konzerns gefährden können, sind derzeit nicht erkennbar.

h) Beteiligungsbereich

Durch die hohe Allokation von finanziellen Mitteln in die ausländischen Tochtergesellschaften besteht die erhöhte Pflicht, mit entsprechenden Controlling-Instrumenten und kontinuierlichen Soll-Ist-Analysen mögliche finanzielle Risiken frühzeitig zu erkennen bzw. zu minimieren. Insbesondere für die bislang nicht profitabel agierenden Tochtergesellschaften SMI, eurasem und ELMOS NA sind Geschäftspläne und Budgets erstellt worden, deren Erreichen sicherstellen wird, dass hieraus keine bestandsgefährdenden Risiken resultieren. Für das Geschäftsjahr 2004 ist die Integration der Tochtergesellschaften eurasem und ELMOS NA in das bestehende Rechnungswesen der Muttergesellschaft geplant. Die übrigen Tochtergesellschaften sollen sukzessive folgen.

4. Prognosebericht

Für das Jahr 2004 wird allgemein mit einem starken Aufwärtstrend der Halbleitermärkte gerechnet. Aufgrund des jährlich um rund 10 Prozent steigen Markt für automobiler Halbleiter weiter steigen, für die automobilen Halbleiterchips wird ein zweistelliges Umsatzwachstum erwartet.

Die gut gefüllte Produkt-Pipeline aus den Design-Wins der letzten Jahre und die hohe Book-to-bill-Rate unterstreichen dies. So werden auch 2004 wieder ungefähr 30 neue ASICs von der Entwicklung in die Serienproduktion überführt werden. Mit der größeren Liefermenge ist eine höhere Auslastung der Fertigungskapazitäten in Dortmund verbunden, was zu einer weiteren Verbesserung der Ertragssituation führen wird.

Bei eurasem soll im Geschäftsjahr 2004 mit dem Aufbau eines Testbereichs für assemblierte Produkte begonnen werden. Dazu werden alle Büro- und Nebenflächen des Hauptgebäudes zu Produktionsflächen umgestaltet und die Büro- und Nebenräume in das im Herbst 2003 erworbene Nachbargebäude verlegt. Durch die Zusammenlegung gleicher Funktionsbereiche von eurasem und ELMOS sollen Kosten eingespart und Synergien besser genutzt werden. Verstärkt werden sollen die Anstrengungen bei der Entwicklung von Sondergehäusen, die Produkte im Sinne der „ASIC *plus*“- Strategie ermöglichen. Durch die Veränderung des eurasem-Geschäftsmodells erwarten wir ab 2005 eine starke Profitabilität.

Für SMI stehen für das Jahr 2004 die Fortsetzung der schrittweisen Umstellung der laufenden Produktion auf 150mm-Wafer und die dafür notwendigen Maschineninstallationen an. Dadurch erwarten wir eine Verbesserung der Bruttomarge insbesondere im Foundry-Geschäft für Dritte. Nach Abschluss der notwendigen Qualifikationen im ersten Halbjahr 2004 wird hier auch mit dem Anlauf neuer langfristiger Produktionsaufträge gerechnet. Weiter erwarten wir den Beginn der Serienfertigung der im abgelaufenen Geschäftsjahr vorgestellten eigenen Produkte, wie des co-integrierten Drucksensors und des extrem kleinen Sensorchips. Der Umsatz sollte daher den Vorjahresumsatz um mindestens 20 Prozent übertreffen und ein positives Ergebnis erreicht werden.

Die Investitionen im Jahr 2004 werden sich auf vergleichbarem Niveau wie im Vorjahr bewegen. So sind für den Ausbau des Reinraums und Kapazitätserweiterungen in Dortmund nur noch kleinere Investitionen erforderlich. Bei eurasem werden Mittel für die Einrichtung des Testbereichs und die Verlagerung der Büro- und Nebenräume benötigt.

Insgesamt soll das Jahr 2004 für die ELMOS-Gruppe mit einem Umsatzwachstum von 15 bis 20 Prozent das Vorjahr deutlich übertreffen. Dank der besseren Nutzung von Produktionskapazitäten und der Fortschritte bei den Tochterunternehmen sollen Rohertrag und Betriebsergebnis die Zielwerte von 50 bzw. 20 Prozent erreichen.

5. Beziehungen zu verbundenen Unternehmen

Gemäß § 312 AktG haben wir einen Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen aufgestellt, der mit folgender Erklärung gemäß § 312 Abs. 3 AktG abschließt:

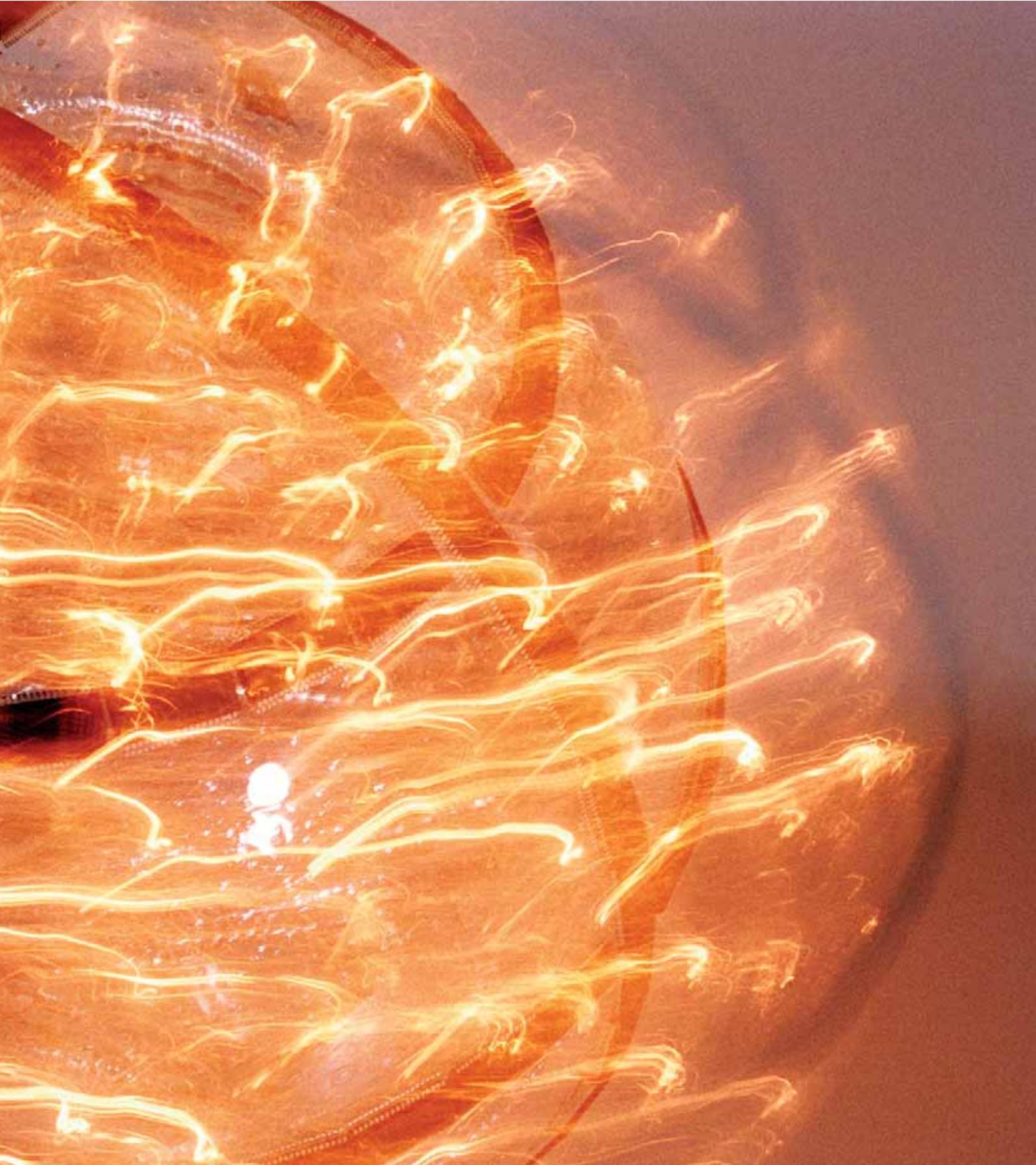
„Wir erklären, dass unsere Gesellschaft nach den Umständen, die uns in dem Zeitpunkt bekannt waren, in dem die Rechtsgeschäfte vorgenommen und die Maßnahmen getroffen wurden, bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung erhalten hat. Nachteile im Sinne von § 312 AktG haben sich aus den Beziehungen zu verbundenen Unternehmen für uns nicht ergeben.“

Dortmund, im Februar 2004

Der Vorstand

Knut Hinrichs	Dr. Klaus Weyer
Dr. Peter Thoma	Reinhard Senf







Internationalisierung

Ein erfolgreiches Unternehmen wie ELMOS arbeitet natürlich weltweit, denn die Internationalisierung der Automobilindustrie erzwingt die Entwicklung und Fertigung von individuellen Halbleiterlösungen für den Weltmarkt. So generieren diese erfolgreichen Chiplösungen für Schlüsselkunden zwangsläufig die Nachfrage im benachbarten Europa. Im Zuge der Globalisierung folgen neue Kunden in den Vereinigten Staaten von Amerika; Kontakte in Japan schaffen die Basis für den Zugang zum asiatischen Markt.

Konzernabschlüsse nach US-GAAP der ELMOS Semiconductor Aktiengesellschaft und der Tochtergesellschaften zum 31. Dezember 2003 und 2002

Bestätigungsvermerk der Abschlussprüfer

An die Aktionäre der ELMOS Semiconductor Aktiengesellschaft und Tochtergesellschaften

„Wir haben die vorliegende Konzernbilanz der ELMOS Semiconductor Aktiengesellschaft (»die Gesellschaft«) und Tochtergesellschaften zum 31. Dezember 2003 sowie die dazugehörige Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung, die Entwicklung des konsolidierten Eigenkapitals sowie die Kapitalflussrechnung für das zu diesem Zeitpunkt endende Geschäftsjahr geprüft. Die Erstellung des Konzernabschlusses und des Berichts über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns nach den US-amerikanischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Rechnungslegung (US-GAAP) liegt in der Verantwortung der Geschäftsleitung der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf Grundlage unserer Prüfungshandlungen eine Beurteilung über den Konzernabschluss und den Bericht über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns sowie die Erfüllung der Befreiungsvoraussetzungen nach § 292a HGB abzugeben.

Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach den deutschen Prüfungsvorschriften und unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach sind die Prüfungen so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Konzernabschlüsse frei von wesentlichen Fehlaussagen sind. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie die Nachweise für die Wertansätze und Angaben im Konzernabschluss auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfungen umfassen auch eine Beurteilung der angewandten Bilanzierungs- und Konsolidierungsmethoden und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung des Konzernabschlusses. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfungshandlungen eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bilden.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Konzernabschluss in Übereinstimmung mit den in den Vereinigten Staaten von Amerika allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns sowie der Zahlungsströme des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2003.

Unsere Prüfung, die sich auch auf den vom Vorstand für das zum 31. Dezember 2003 endende Geschäftsjahr aufgestellten Bericht über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns erstreckt hat, hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach unserer Überzeugung gibt der Bericht über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns zusammen mit den übrigen Angaben des Konzernabschlusses insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft und des Konzerns und stellt die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.

Außerdem bestätigen wir, dass der Konzernabschluss und der Bericht über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns für das zum 31. Dezember 2003 endende Geschäftsjahr die Voraussetzungen für eine Befreiung der Gesellschaft von der Aufstellung eines Konzernabschlusses und Konzernlageberichts nach deutschem Recht erfüllen. Die Prüfung des für die Befreiung von der handelsrechtlichen Konzernrechnungslegungspflicht erforderlichen Einklangs der Konzernrechnungslegung mit der 7. EU-Richtlinie haben wir auf der Grundlage der Auslegung durch den Kontaktausschuss für Richtlinien der Rechnungslegung der Europäischen Kommission vorgenommen.“

Dortmund, 20. Februar 2004

Ernst & Young AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Brorhilker
Wirtschaftsprüfer

Muzzu
Wirtschaftsprüfer

Konzernbilanz nach US-GAAP

	31.12. 2003	31.12. 2002
	EUR	EUR
Aktiva		
Umlaufvermögen:		
Liquide Mittel	17.426.927	9.038.828
Wertpapiere des Umlaufvermögens (<i>Erläuterung 2</i>)	8.438.742	2.020.843
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen nach Wertberichtigungen auf zweifelhafte Forderungen von EUR 353.269 in 2003, EUR 987.559 in 2002	26.566.875	22.787.802
Vorräte (<i>Erläuterung 3</i>)	22.132.468	24.080.701
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögensgegenstände	8.757.505	5.865.241
Umlaufvermögen, gesamt	83.322.517	63.793.415
Latente Steuern (<i>Erläuterung 7</i>)	12.709.374	13.913.236
Immaterielle Vermögensgegenstände		
Geschäfts- oder Firmenwerte nach Abschreibungen (<i>Erläuterungen 2, 15</i>)	7.622.344	7.622.344
Software (<i>Erläuterung 2</i>)	28.715.741	25.516.046
Abzüglich kumulierter Abschreibungen	(7.445.770)	(6.232.719)
	28.892.315	26.905.671
Beteiligungen (<i>Erläuterung 4</i>)	342.739	468.792
Anlagevermögen:		
Grundstücke	6.565.486	4.432.392
Gebäude und Einbauten	60.185.797	56.068.821
Technische Anlagen und Maschinen	96.317.333	112.869.248
Anlagen im Bau	6.219.503	15.824.461
Abzüglich kumulierter Abschreibungen	(89.226.962)	(85.754.221)
	80.061.157	103.440.701
Aktiva, gesamt	205.328.102	208.521.815

Siehe Erläuterungen zu den Konzernabschlüssen

Konzernbilanz nach US-GAAP

	31.12. 2003	31.12. 2002
	EUR	EUR
Passiva		
Kurzfristige Verbindlichkeiten:		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.638.171	22.156.828
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.945.390	11.462.149
Rückstellungen für Löhne und Gehälter, Sozialleistungen und Steuern	3.758.365	3.060.320
Sonstige Rückstellungen	4.255.810	5.734.989
Steuerrückstellungen	1.853.268	11.944.904
Anteil der langfristigen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr (<i>Erläuterung 5</i>)	4.017.395	2.909.167
Kurzfristige Verbindlichkeiten, gesamt	39.468.399	57.268.357
Langfristige Verbindlichkeiten abzüglich des Anteils mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr (<i>Erläuterung 5</i>)	38.898.265	37.157.851
Langfristige Verbindlichkeiten	2.104.340	1.560.607
Minderheitsanteile	178.496	93.914
Eigenkapital:		
Grundkapital	19.300.000	19.300.000
Kapitalrücklage	84.716.644	84.615.844
Kumulierte erfolgsneutrale Veränderungen des Eigenkapitals (<i>Erläuterung 12</i>)	(8.613.429)	(10.734.523)
Bilanzgewinn	29.275.387	19.259.765
Eigenkapital, gesamt	124.678.602	112.441.086
Passiva, gesamt	205.328.102	208.521.815

Siehe Erläuterungen zu den Konzernabschlüssen

Konzern Gewinn- und Verlustrechnung nach US-GAAP

	2003	2002
	EUR	EUR
Umsatzerlöse, netto (<i>Erläuterung 13</i>)	121.395.405	109.705.247
Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen	59.991.098	55.898.081
Bruttoergebnis vom Umsatz	61.404.307	53.807.166
Forschungs- und Entwicklungskosten	20.374.131	17.545.991
Marketing- und Vertriebskosten	6.642.202	5.993.627
Allgemeine Verwaltungskosten	12.809.220	12.015.157
Betriebsergebnis	21.578.754	18.252.391
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Erträge)	3.812.961	3.649.075
Wechselkursverluste (Erträge), netto	134.089	(88.049)
Sonstige Aufwendungen (Erträge), netto	356.152	(965.645)
Ergebnis vor Ertragsteuern, Nettoanteil am Verlust der nicht konsolidierten Tochtergesellschaften und Minderheitsanteilen	17.275.552	15.657.010
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (<i>Erläuterung 7</i>)		
Steueraufwendungen	6.307.541	6.846.877
Latente Steuern (Erträge)	592.536	(166.249)
	6.900.077	6.680.628
Jahresüberschuss vor Nettoanteil am Verlust nicht konsolidierter Tochtergesellschaften und Minderheitsanteilen	10.375.475	8.976.382
Verluste aus der Bewertung at equity	247.090	199.294
Minderheitsanteile bei konsolidierten Tochtergesellschaften	112.763	(85.882)
Jahresüberschuss	10.015.622	8.862.970
Unverwässertes Ergebnis je Aktie	0,52	0,46
Voll verwässertes Ergebnis je Aktie	0,52	0,46

Siehe Erläuterungen zu den Konzernabschlüssen

Entwicklung des konsolidiertes Eigenkapitals nach US-GAAP

	Aktien	Gezeichnetes Kapital	Kapital- rücklage	Kumulierte erfolgsneutrale Verände- rungen des Eigenkapitals	Bilanz- gewinne	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Stand 31. Dezember 2000	19.286.300	19.286.300	84.279.098	30.542	16.410.961	120.006.901
Jahresüberschuss					11.550.755	11.550.755
Gezeichnetes Kapital	13.700	13.700	336.746			350.446
Barausschüttungen					(17.564.921)	(17.564.921)
Veränderungen bei nicht realisierten Gewinnen aus Wertpapieren des Umlaufvermögens (nach Steuern)				(1.241.278)		(1.241.278)
Fremdwährungsanpassungen				17.362		17.362
Stand 31. Dezember 2001	19.300.000	19.300.000	84.615.844	(1.193.374)	10.396.795	113.119.265
Jahresüberschuss					8.862.970	8.862.970
Veränderungen bei nicht realisierten Gewinnen aus Wertpapieren des Umlaufvermögens (nach Steuern)				(9.068.169)		(9.068.169)
Fremdwährungsanpassungen				(472.980)		(472.980)
Stand 31. Dezember 2002	19.300.000	19.300.000	84.615.844	(10.734.523)	19.259.765	112.441.086
Jahresüberschuss					10.015.622	10.015.622
Aufwand aus Aktienoptionen			100.800			100.800
Veränderungen bei nicht realisierten Gewinnen aus Wertpapieren des Umlaufvermögens (nach Steuern)				3.203.498		3.203.498
Fremdwährungsanpassungen				(1.082.404)		(1.082.404)
Stand 31. Dezember 2003	19.300.000	19.300.000	84.716.644	(8.613.429)	29.275.387	124.678.602

Konzernkapitalflussrechnung nach US-GAAP

	2003	2002
	EUR	EUR
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit:		
Jahresüberschuss	10.015.622	8.862.970
Abschreibungen	14.571.630	14.905.388
Latente Steuern	592.537	(166.249)
Minderheitsanteile	112.763	(85.882)
Eigenkapitalentwicklung bei nicht konsolidierten Tochtergesellschaften	247.090	199.294
Aufwand aus Aktienoptionsprogramm	100.800	0
Veränderungen im Netto-Umlaufvermögen:		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	(3.779.074)	(5.658.622)
Vorräte	1.948.233	1.720.111
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögensgegenstände	(2.875.869)	1.405.668
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	(3.516.759)	2.014.573
Sonstige Rückstellungen	(781.134)	(502.226)
Steuerrückstellungen	(10.091.636)	3.292.317
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	6.544.203	25.987.342
Cashflow aus Investitionstätigkeiten:		
Investitionen in das Anlagevermögen	(25.341.827)	(34.138.299)
Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	29.983.506	4.818.105
Erwerb von Wertpapieren des Umlaufvermögens	(1.088.507)	0
Erträge aus der Veräußerung von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	932.690
Erträge aus der Veräußerung einer Beteiligung	0	153
Erwerb von Beteiligungen	(137.432)	(875.150)
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	3.415.740	(29.262.501)
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit:		
Rückzahlung der zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleisteten Einlage	0	(10.550.000)
Gewinnausschüttung durch konsolidierte Tochter- gesellschaft an Minderheitsgesellschafter	(75.000)	(150.000)
Zunahme langfristiger Verbindlichkeiten	6.605.921	2.629.156
Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	(3.213.545)	(3.553.207)
Aufnahme kurzfristiger Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	(4.518.657)	6.468.319
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	(1.201.281)	(5.155.732)
Abnahme / Zunahme der liquiden Mittel	8.758.662	(8.430.891)
Effekt aus Wechselkursänderungen der liquiden Mittel	(370.563)	(811.089)
Liquide Mittel zu Beginn des Geschäftsjahres	9.038.828	18.280.808
Liquide Mittel am Ende des Geschäftsjahres	17.426.927	9.038.828

Siehe Erläuterungen zu den Konzernabschlüssen

Erläuterungen zu den Konzernabschlüssen

1. Gesellschaftsrechtliche Grundlagen

Die ELMOS Semiconductor Aktiengesellschaft (»die Gesellschaft« oder »ELMOS«) entwickelt, produziert und vertreibt Application Specific Integrated Circuits (ASIC's). Die Gesellschaft hat Vertriebsgesellschaften in Frankreich, den Vereinigten Staaten von Amerika und den Niederlanden und kooperiert in der Entwicklung und Herstellung von ASIC-Chips mit anderen deutschen Unternehmen.

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

2. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erstellung der Konzernabschlüsse

Die vorliegenden Konzernabschlüsse wurden in Übereinstimmung mit US-amerikanischen Rechnungslegungsgrundsätzen (»US-GAAP«) erstellt. In Übereinstimmung mit den laut Handelsgesetzbuch (HGB) vorgeschriebenen, allgemein anerkannten deutschen Rechnungslegungsgrundsätzen führt die Gesellschaft ihre Bücher in Euro. Deutsche Rechnungslegungsgrundsätze unterscheiden sich in einigen Aspekten von US-amerikanischen Rechnungslegungsgrundsätzen. Die Gesellschaft hat alle Anpassungen, die zur Darstellung der Konzernabschlüsse nach US-GAAP erforderlich waren, durchgeführt.

Die Aufstellung von Konzernabschlüssen in Übereinstimmung mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger Rechnungslegung erfordert Schätzungen und Annahmen durch die Geschäftsführung der Gesellschaft, die die Ausweise in den Konzernabschlüssen sowie die dazugehörigen Erläuterungen beeinflussen. Die tatsächlichen Ergebnisse können von den vorgenommenen Schätzungen und Annahmen abweichen.

Konsolidierung

Alle Gesellschaften, an denen ELMOS eine Mehrheitsbeteiligung hält, wurden in den Konzernabschluss einbezogen. Alle wesentlichen Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Transaktionen zwischen den konsolidierten Gesellschaften wurden im Konzernabschluss eliminiert.

Beteiligungen von mehr als 20 Prozent, aber nicht mehr als 50 Prozent, wurden, falls wesentlich, unter Anwendung der Equity-Methode erfasst.

Im Januar 2003 hat das U.S. Financial Accounting Standards Board die Interpretation Nr. 46, »Consolidation of Variable Interest Entities an interpretation of ARB No. 51« (FIN 46) veröffentlicht. FIN 46 stellt die Anwendung des Accounting Research Bulletin (ARB) Nr. 51, »Consolidated Financial Statements«, hinsichtlich derjenigen einzubeziehenden Gesellschaften klar, deren Eigenkapitalgeber keine Kontrolle gemäß dem control-Konzept ausüben. Es erfordert die Konsolidierung von Gesellschaften, deren überwiegender Teil der erwarteten Verluste und Gewinne von dem berichtenden Konzern aufgrund gesellschaftsrechtlicher oder anderer vertraglicher Vereinbarungen bzw. finanzieller Interessen übernommen werden.

Die Gesellschaft ist verpflichtet, FIN 46 im Laufe des am 31. Dezember 2003 endenden Geschäftsjahres anzuwenden.



Die Anwendung dieser Interpretation führt zur Konsolidierungspflicht für folgende Gesellschaften, die im Bereich der Forschung bzw. Entwicklung tätig sind:

DMOS GmbH, Dresden

Die Gesellschaft hat mit der DMOS GmbH, Dresden (DMOS) mit Wirkung zum 1. November 2002 eine Vereinbarung über Forschungs- und Entwicklungsleistungen zu bestimmten Projekten geschlossen.

Die Vereinbarung sieht neben Vorauszahlungen in Form von besicherten Darlehen zum Kauf von Sachanlagevermögen auch gleichmäßige monatliche Raten über die Dauer von 36 Monaten zur Finanzierung der Geschäftstätigkeit und Abgeltung der Entwicklungsleistungen der DMOS vor.

Die Vereinbarung enthält ebenfalls Spezifizierungen zu den Dienstleistungen und dem Abnahmeprocédere der Entwicklungsergebnisse durch die Gesellschaft. DMOS wird ab 2003 überwiegend Leistungen für die Gesellschaft als sog. „primary beneficiary“ erbringen.

Die Gesellschaft ist wirtschaftlicher und rechtlicher Eigentümer der Ergebnisse aus der gemeinsamen Projektstätigkeit.

Zudem wird der Gesellschaft eine unbefristete Kaufoption zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der DMOS gewährt, die erstmalig ab Oktober 2005 ausgeübt werden kann.

Die Gesellschaft hält die von den Anteilseignern zur Verfügung gestellten Mittel für ausreichend, um den Geschäftszweck der Forschungs- und Entwicklungstätigkeit erfüllen zu können. Die Gesellschaft trägt über die in der genannten Vereinbarung zugesagten Mittel in Höhe von maximal TEUR 370 pro Quartal keine weiteren Risiken aus Verlusten der DMOS.

Die Stimmrechtsverteilung bei DMOS entspricht den Beteiligungsquoten, ebenso wie die Verteilung von Gewinnen und Verlusten. Weitere Finanzierungsvereinbarungen zwischen DMOS und den Anteilseignern oder Banken bestehen nicht.

Aufgrund von Wesentlichkeitsüberlegungen wurde DMOS nicht in den Konsolidierungskreis aufgenommen. Die geleisteten monatlichen Zahlungen sind in der Gewinn- und Verlustrechnung unter Entwicklungsaufwand ausgewiesen worden.

MECHALESS Systems GmbH, Karlsruhe

Mit Wirkung zum 30. September 2003 hat die Gesellschaft 49 Prozent der Anteile an der MECHALESS Systems GmbH, Karlsruhe (MECHALESS) als sog. „primary beneficiary“ erworben. Die MECHALESS ist auf dem Gebiet der Applikationsentwicklung für Sensoren tätig. Neben der Beteiligung hat die Gesellschaft eine Entwicklungs- und Vertriebsvereinbarung mit der MECHALESS getroffen, auf deren Basis die MECHALESS einen fest vereinbarten Betrag pro Quartal für deren Entwicklungstätigkeit erhält. Die Höhe des quartalsweise zu zahlenden Betrages wird bis 2007 auf Null reduziert und durch eine Umsatzprovision für in Serie gegangene Produkte substituiert.

Die Gesellschaft ist wirtschaftlicher Eigentümer sowohl der verwendeten Basistechnologie als auch der Ergebnisse aus der von ELMOS finanzierten Entwicklungs- und Applikationstätigkeit.

Die Gesellschaft hält die von den Anteilseignern zur Verfügung gestellten Mittel für ausreichend, um den Geschäftszweck der Entwicklungs- und Applikationstätigkeit erfüllen zu können. Weitere Mittelzusagen der anderen Anteilseigner bestehen nicht. Auch haben diese keine Rückgriffsmöglichkeiten auf die Gesellschaft. Die Gesellschaft trägt über die in der Vereinbarung zugesagten Mittel in Höhe von maximal TEUR 400 pro Quartal keine weiteren Risiken aus Verlusten der MECHALESS.

Die Stimmrechtsverteilung bei MECHALESS entspricht den Beteiligungsquoten, ebenso wie die Verteilung von Gewinnen und Verlusten.

Aufgrund von Wesentlichkeitsüberlegungen wurde die MECHALESS nicht in den Konsolidierungskreis aufgenommen, sondern weist die Beteiligung nach der Equity-Methode im konsolidierten Jahresabschluss aus. Die geleisteten Quartalszahlungen sind in der Gewinn- und Verlustrechnung unter Entwicklungsaufwand und Vertriebsaufwand ausgewiesen worden

Liquide Mittel

Die Gesellschaft behandelt alle Kapitalanlagen mit hoher Fungibilität mit einer Fälligkeit von bis zu drei Monaten zum Zeitpunkt des Erwerbs als Barvermögen.

Wertpapiere des Umlaufvermögens

Die Wertpapiere des Umlaufvermögens setzen sich im Wesentlichen aus Anteilspapieren zusammen. Wertpapiere des Umlaufvermögens werden zum Marktwert angesetzt, d. h. zu dem Wert, der zum Bilanzstichtag auf dem Markt erzielbar war. Grundsätzlich investiert die Gesellschaft nur in hochwertige Wertpapiere des Umlaufvermögens. Alle Wertpapiere des Umlaufvermögens der Gesellschaft entsprechen der Definition „available-for-sale“ (zur Veräußerung verfügbarer Wertpapiere) gemäß Statement of Financial Accounting Standards (»SFAS«) Nr. 115, „Accounting for Certain Investments in Debt and Equity Securities“ (Bilanzierung bestimmter Investitionen in schuld- und eigentumsrechtliche Wertpapiere).

Nachfolgend erfolgt eine Aufgliederung der Wertpapiere des Umlaufvermögens:

	Anschaffungskosten	Marktwert
	EUR	EUR
Anteilspapiere		
31. Dezember 2002	19.171.813	2.020.843
Anteilspapiere		
31. Dezember 2003	20.260.320	8.438.742

SFAS Nr. 115 stellt klar, dass ein Unternehmen für die einzelnen Anteilspapiere, die als zur Veräußerung verfügbar (»available-for-sale«) eingestuft werden, abwägen soll, ob eine Wertminderung des Marktwertes unterhalb der fortgeführten Anschaffungskosten nicht nur temporär ist.

Wenn die Wertminderung des Marktwertes als nicht nur temporär beurteilt wird, werden die fortgeführten Anschaffungskosten der einzelnen Wertpapiere auf den Marktwert herab wertberichtigt und die Summe der Wertberichtigung wird erfolgswirksam in der Gewinn- und Verlustrechnung vereinnahmt. Bisher wurde auf den Marktwert der Anteilspapiere erfolgsneutral im „accumulated other comprehensive income“ als Teil des Eigenkapitals abgeschrieben.

Die im Portfolio liegenden Anteilspapiere haben im abgelaufenen Geschäftsjahr eine konstant steigende Wertentwicklung aufgewiesen, die sich im Buchwert zum 31. Dezember 2003 – verglichen mit dem des Vorjahres - niederschlägt. Nach dem Stichtag bis zur Aufstellung des konsolidierten Abschlusses haben sich weitere Kursanstiege ergeben.

Da die Wertpapiere zum 31. Dezember 2003 noch signifikant unter den Anschaffungskosten bilanziert sind und diese Wertminderung am Bilanzstichtag deutlich über ein Jahr besteht, sieht SFAS 115 vor, dass eine Qualifizierung als nur temporäre Wertminderung nur möglich ist, wenn sonstige Faktoren, die sich im Umfeld des Emittenten und dessen fundamentalen Finanzdaten widerspiegeln, eine solche Qualifizierung rechtfertigen.



Die Gesellschaft hat alle verfügbaren Hinweise dahingehend berücksichtigt, ob die Wertminderung des Marktwertes der bilanzierten Anteilspapiere nur temporär ist oder nicht, insbesondere

- die finanzielle Lage und die kurzfristigen Aussichten des Emittenten, insbesondere die aktuellen Cash-Flow-Daten und die geplante Ergebnisentwicklung
- die Absicht und Möglichkeit der Gesellschaft, die Investition für eine Zeitperiode zu halten, die ausreicht, eine vollständige Erholung des Marktwertes zu ermöglichen
- die Bewertungen und Einschätzungen von Analysten und Branchenexperten
- die Wertentwicklung der Anteilspapiere nach dem Bilanzstichtag
- die vergangene Wertentwicklung der Anteilspapiere in 2003 und der Vergleich mit der Wertentwicklung vergleichbarer Wertpapier titles und Indizes.

Auf Basis der durchgeführten Einschätzung zum 31. Dezember 2003 kommt die Unternehmensleitung zu dem Ergebnis, dass die Wertminderung des Marktwertes nur temporär ist. Die Unternehmensleitung führt quartalsweise eine Untersuchung dieses Sachverhaltes durch.

Marktwert von Finanzierungsinstrumenten

Der Buchwert von Finanzierungsinstrumenten wie Forderungen und Verbindlichkeiten entspricht aufgrund der kurzfristigen Fälligkeiten dieser Finanzierungsinstrumente im Wesentlichen dem Marktwert.

Der Buchwert von Verbindlichkeiten gegenüber Banken entspricht im Wesentlichen dem Marktwert, basierend auf den für dieselben oder vergleichbare Begebungen angesetzten Marktpreisen, sowie auf den der Gesellschaft aktuell angebotenen Zinssätzen.

Die Gesellschaft beobachtet die Wertentwicklung der Verbindlichkeiten mit festen und variablen Zinssätzen sowie der lang- und kurzfristigen Verbindlichkeiten. In diesem Zusammenhang erfolgt eine Überprüfung der Geschäfts- und sonstigen Finanzrisiken.

Zur Absicherung gegen Zinssatzschwankungen aus kurzfristig revolvingenden Verbindlichkeiten mit variablen Zinssätzen, hat die Gesellschaft eine Zins-Swap-Vereinbarung über einen Basisbetrag von EUR 20.000.000 abgeschlossen. Die Vereinbarung hat eine Laufzeit von fünf Jahren und endet 2008.

Der Zins-Swap wurde im Konzernabschluss nicht als Hedging Instrument gemäß SFAS No. 133, Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities behandelt. Die Marktwertveränderungen des Zins -Swappgeschäftes, die 2003 nicht signifikant waren, werden sofort erfolgswirksam erfasst und unter Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Der Marktwert des Zins-Swaps, der auf Basis offizieller Preisangeboten ermittelt wurde, beträgt zum 31. Dezember 2003 – EUR 140.000.

Kreditrisiken

Die Gesellschaft bewertet laufend die Kreditwürdigkeit ihrer Kunden und verlangt in der Regel keine Sicherheiten. Die Gesellschaft hat Wertberichtigungen auf mögliche Forderungsausfälle vorgenommen. Derartige Forderungsausfälle entsprachen den Schätzungen und Annahmen der Geschäftsleitung.

Umgliederungen

Verschiedene Vorjahresbeträge wurden zur Anpassung an die Darstellung des laufenden Geschäftsjahres sowie zum Zwecke diverser Korrekturen umgegliedert.

Vorräte

Vorräte werden unter Beachtung des Niederstwertprinzips zu durchschnittlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt.

Anlagevermögen

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Mit Ausnahme von technischen Anlagen und Maschinen werden Gegenstände des Anlagevermögens unter Anwendung der linearen Methode über ihre jeweilige voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben:

Gebäude	25	Jahre
Einbauten	10	Jahre
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5 bis 12	Jahre
Software	3	Jahre

Fremdwährungsumrechnung und -transaktionen

Die Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten der ausländischen Tochtergesellschaften werden zum Stichtagskurs in Euro umgerechnet. Fremdwährungsgewinne und -verluste aus der Umrechnung werden nicht im Jahresüberschuss erfasst, sondern als separater Posten erfolgsneutral im Eigenkapital ausgewiesen. Erlös- und Aufwandspositionen werden zu den durchschnittlichen Fremdwährungskursen während des zugrunde liegenden Zeitraums umgerechnet.

Die Gesellschaft geht von Zeit zu Zeit Devisentermingeschäfte zur Absicherung von Transaktionen in Fremdwährungen ein, die auf den Zeitraum beschränkt sind, in dem das Risiko besteht. Diese Kursicherungsgeschäfte minimieren die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf die Ertragslage der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist nicht an Spekulationsgeschäften beteiligt. Die Devisentermingeschäfte stellen kein Risiko für die Ertragslage der Gesellschaft dar, da die Gewinne und Verluste aus diesen Verträgen in der Regel die Gewinne und Verluste aus den gesicherten Vermögensgegenständen und Verbindlichkeiten ausgleichen.

Zum 31. Dezember 2003 bestanden keine Devisentermingeschäfte. Im Vorjahr bestanden insgesamt 29 Devisentermingeschäfte zum Kauf von US Dollar im Nominalwert von circa USD 3.900.000 und Marktwert von circa USD 3.755.000. Die in 2002 gebuchten Verluste betragen EUR 144.500. Die aus der Abwicklung dieser Devisentermingeschäfte gebuchten Verluste betragen in 2003 EUR 189.180.

Umsatzrealisierung

Die Umsatzrealisierung erfolgt bei Versendung der Produkte an den Kunden bzw. bei Gefahrenübergang auf den Kunden.

Gewährleistung

Rückstellungen für Gewährleistung werden ab dem Verkaufszeitpunkt auf Grundlage des Verhältnisses der Garantiekosten zu den Umsatzerlösen in der Vergangenheit gebildet.

Forschung und Entwicklung

Die Kosten, die mit Forschungs- und Entwicklungsprojekten für neue Produkte verbunden sind, sowie bedeutende Produktverbesserungen werden entsprechend ihres Anfalls in den Aufwand gebucht und sind in den Kosten für Forschung und Entwicklung enthalten. Forschungs- und Entwicklungskosten in Höhe von TEUR 4.233 wurden von Kunden erstattet.



Immaterielle Vermögensgegenstände (Software)

Die anfallenden Kosten für die Produktion und Entwicklung von Computer-Software sowie von Software-Applikationen, welche in andere Produkte eingebettet wird, die verkauft oder anderweitig vermarktet werden – in erster Linie Software, die in Halbleiter eingebettet ist – werden aktiviert, nachdem die technologische Durchführbarkeit bzw. Realisierbarkeit hergestellt ist und die Forschung und Entwicklung hinsichtlich des Produkts, in welchem die Software enthalten ist, beendet ist.

Die Aktivierung findet nur für Projekte statt, die im Kundenauftrag erfolgen. Die Kosten werden ab Produktionsstart auf einer linearen Grundlage über die geschätzte Nutzungsdauer, überwiegend über fünf Jahre, amortisiert.

In 2003 wurden Aufwendungen im Zusammenhang mit Software-Entwicklungen in Höhe von EUR 3.557.000 (Vj. EUR 1.690.000) aktiviert. Die Abschreibungen hierauf betragen in 2003 EUR 477.127 (Vj. EUR 123.115).

Aufwendungen für die Anmeldung von Patenten und den Erwerb von Design- und Prozesstechnologie werden aktiviert. Aufwendungen werden unter Verwendung der linearen Methode über die jeweils kürzere geschätzte betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von Technologien, die Schutzfrist bei Patenten oder die Vertragsdauer, aber maximal über 18 Jahre abgeschrieben. Zum 31. Dezember 2003 beliefen sich die Gesamtaufwendungen für als Gegenstände des Anlagevermögens erworbene zugekaufte Prozesstechnologie auf circa EUR 4.982.018, zum 31. Dezember 2002 beliefen sich diese auf EUR 6.091.704.

Geschäfts- oder Firmenwert

Der Geschäfts- oder Firmenwert stellt den Überhang des Kaufpreises akquirierter Unternehmen über den Verkehrswert dar und wird nicht regelmäßig abgeschrieben, sondern jährlich, soweit sich entsprechende Anhaltspunkte ergeben auch häufiger, auf die Notwendigkeit einer außerplanmäßigen Abschreibung hin überprüft. Der Geschäfts- oder Firmenwert der Gesellschaft resultiert aus der Akquisition der Silicon Microstructures, Inc.

Fördermittel

Die Gesellschaft erhält Fördermittel der öffentlichen Hand, die zur Finanzierung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten sowie den Erwerb von Grundbesitz und Anlagegegenständen verwendet werden. Fördermittel werden bis zum Investitionszeitpunkt als Sonstige Verbindlichkeiten erfasst. Für Forschungs- und Entwicklungsprojekte verwendete Fördermittel werden als Sonstige Erträge erfasst (EUR 565.947 in 2003 und EUR 553.291 in 2002), während Fördermittel für Investitionen in das Sachanlagevermögen als Minderung der Anschaffungskosten erfasst werden.

Mitarbeiterbeteiligung

Die Gesellschaft setzt den sich aus Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen ergebenden Aufwand unter Anwendung der Intrinsic-Value-Methode gemäß Accounting Principles Board Opinion Nr. 25, „Accounting for Stock Issued to Employees“ (Bilanzierung von Mitarbeiteraktien, ABP Nr. 25) an. Gemäß APB Nr. 25 wird kein Aufwand angesetzt, wenn der Ausübungspreis der Aktienoptionen den geschätzten beizulegenden Wert der zugrunde liegenden Aktien am Tag der Gewährung erreicht oder überschreitet.

Pensionsverpflichtungen

Für Mitglieder des Vorstandes besteht eine Direktzusage, die gemäß SFAS 87 mit EUR 1.085.630 (2002: EUR 841.489) unter den Rückstellungen ausgewiesen wird. Der Rechnungszins beträgt 6 Prozent p.a. und die erwarteten Rentenanpassungen 1,5 Prozent p.a. Der in der Gewinn- und Verlustrechnung gebuchte Dienstzeitaufwand betrug EUR 93.263 (2002: EUR 91.145), der Zinsaufwand EUR 86.732 (2002: 78.850). Nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand (prior service costs) ist in Höhe von EUR 64.146 in 2003 und 2002 gebucht worden. Noch nicht erfasste „prior service costs“ werden mit EUR 539.898 (2002: EUR 604.044) beziffert.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Aktive bzw. passive latente Steuern basieren auf zeitlichen Unterschieden zwischen handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Jahresabschlüssen. Sie werden auf Grundlage der Steuersätze und -vorschriften ermittelt, die auf Basis des gegenwärtigen Gesetzesstandes voraussichtlich zum Zeitpunkt der Aufhebung der Unterschiede gelten werden. Die Auswirkung geänderter Steuersätze auf die Bildung latenter Steuern wird in dem Geschäftsjahr erfasst, in dem die geänderten Sätze in Kraft treten.

Ergebnis je Stammaktie

Das unverwässerte Ergebnis je Stammaktie wird auf Grundlage der durchschnittlichen Anzahl der sich im jeweiligen Geschäftsjahr im Umlauf befindlichen Stammaktien berechnet. Das verwässerte Ergebnis je Stammaktie wird auf Grundlage der durchschnittlichen Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Stammaktien zuzüglich aller Aktienoptionen mit verwässerndem Charakter berechnet.

3. Vorräte

Die Vorräte setzen sich wie folgt zusammen:

	31. Dezember 2003	2002
	EUR	EUR
Rohstoffe	6.491.767	7.088.806
Unfertige Erzeugnisse	11.335.590	11.238.125
Fertige Erzeugnisse und Waren	4.305.111	5.753.770
	22.132.468	24.080.701

4. Beteiligungen

Die Gesellschaft ist an den folgenden nicht zum Konsolidierungskreis gehörenden Unternehmen beteiligt:

	31. Dezember 2003	2002
	EUR	EUR
MECHALESS GmbH (MECHALESS) (49%-ige Beteiligung zum 31.12.2003)	78.432	0
attoSensor GmbH, Penzberg (atto- Sensor) (30%- ige Beteiligung zum 31.12.2003 und 31.12.2002)	1	247.091
Sonstige	264.306	221.701
	342.739	468.792

attoSensor GmbH

Am 22. Mai 2001 hat die Gesellschaft eine 10-prozentige Beteiligung bzw. einen Anteil von EUR 7.669 am gezeichneten Kapital der attoSensor GmbH, einem Entwickler und Hersteller von Sensortechnologie mit Sitz in Penzberg (Bayern), erworben. Der Gesamtkaufpreis für die Beteiligung an dieser Gesellschaft betrug EUR 169.039. Darüber hinaus hat die Gesellschaft der attoSensor GmbH ein partiarisches Darlehen in Höhe von EUR 766.938 gewährt und hat dieses Darlehen zum 31. Januar 2002 um EUR 613.550 erhöht. Das Darlehen wird zum 31. Dezember 2020 fällig.

Das Darlehen ist zinsfrei, aber der Gesellschaft stehen jährlich 2 Prozent des Gewinns der attoSensor GmbH zu, während sie an möglichen Verlusten nicht beteiligt ist. Am 8. Januar 2002 hat die Gesellschaft weitere 20 Prozent bzw. einen Anteil von EUR 15.338 am gezeichneten Kapital zu einem Kaufpreis von EUR 307.051 erworben. 2003 hat die Gesellschaft Verluste aus der Beteiligung in Höhe von EUR 247.090 (2002: EUR 229.000) verbucht. Darüber hinaus wurden EUR 153.910 (2002: EUR 571.000) des Darlehens abgeschrieben.

5. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und langfristige Verbindlichkeiten

Zum 31. Dezember 2003 standen der Gesellschaft verschiedene kurzfristige Kreditrahmen in Höhe von zirka EUR 31.986.125 zur Verfügung. Per 31. Dezember 2003 hat die Gesellschaft diese Kreditfazilitäten in Höhe von EUR 21.379.786 mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 4,22 Prozent in Anspruch genommen.

Die langfristigen Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

Langfristige Verbindlichkeiten	31. Dezember 2003	2002
	EUR	EUR
Deutsche Bank, Dortmund, Darlehen EGKS Jahreszinssatz: 3,75% Zahlung: Monatlich Fälligkeit: März 2005	1.666.664	2.777.776
Deutsche Kreditbank AG, Darlehen 6528970 Jahreszinssatz: 4,80% Zahlung: Monatlich Zinsen: EUR 0,00 Fälligkeit: Dezember 2004	65.000	130.000
Deutsche Kreditbank AG, Darlehen 6501274 Jahreszinssatz: 4,30% Zahlung: Monatlich Zinsen: EUR 6.889 Fälligkeit: Dezember 2004	58.454	122.221
Sparkasse Frankfurt, Darlehen 88051570 Jahreszinssatz: 5,65% Zahlung: Monatlich Zinsen: EUR 47.297 Fälligkeit: Dezember 2008	776.061	816.328
Finanzierungsleasing	40.349.481	36.220.693
Gesamt	42.915.660	40.067.018
Abzüglich des Anteils mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	4.017.395	2.909.167
	38.898.265	37.157.851

Diverse darlehensfinanzierte Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens der Gesellschaft sind an verschiedene Kreditinstitute sicherungsübereignet.

Am 22. Dezember 1997 hat die Gesellschaft ihr Geschäftsgebäude (einschließlich Grundstück und Einbauten) für einen Gesamtkaufpreis von EUR 23.008.135 veräußert. Parallel zu dieser Veräußerung hat die Gesellschaft die Einbauten für einen Zeitraum von neun Jahren sowie das Grundstück und das Gebäude für einen Zeitraum von 22,5 Jahren angemietet.

Im Rahmen dieses Mietvertrags ist die Gesellschaft zu jährlichen Gesamtmietzahlungen in Höhe von EUR 1.942.772 (EUR 1.121.180 für Einbauten sowie EUR 821.592 für Grundstück und Gebäude) bis 2006 und in Höhe von EUR 1.917.207 (für Grundstück und Gebäude) bis 2020 verpflichtet. Da die Gesellschaft ab 2018 die Möglichkeit hat, das Gebäude zurückzuerwerben, wurde diese Transaktion als Finanzierungstransaktion und nicht als Veräußerung erfasst, so dass das Gebäude und die Einbauten weiterhin in den vorliegenden Konzernabschlüssen erfasst werden. Der Finanzierungsbetrag ist unter der Position Finanzierungsleasing in Langfristige Verbindlichkeiten erfasst.

Am 7. Juli 2000 hat die Gesellschaft eine Gebäudeerweiterung (einschließlich Einbauten) zu einem Gesamtkaufpreis von EUR 6.287.853 veräußert. Parallel zu dieser Veräußerung hat die Gesellschaft die Einbauten für einen Zeitraum von 7,5 Jahren sowie das Gebäude für einen Zeitraum von 22,5 Jahren angemietet. Im Rahmen dieses Mietvertrags ist die Gesellschaft zu jährlichen Gesamtmietzahlungen in Höhe von EUR 1.074.788 bis 2007 und in Höhe von EUR 60.872 bis 2022 (für Gebäude) verpflichtet. Da die Gesellschaft ab 2020 die Möglichkeit hat, das Gebäude zurück zu erwerben, wurde diese Transaktion als Finanzierungstransaktion und nicht als Veräußerung erfasst, so dass das Gebäude und die Einbauten weiterhin in den vorliegenden Konzernabschlüssen erfasst werden. Der Finanzierungsbetrag ist unter der Position Finanzierungsleasing in den Langfristigen Verbindlichkeiten erfasst.

Am 8. November 2001 hat die Gesellschaft ein weiteres Geschäftsgebäude und das dazugehörige Parkhaus (einschließlich Grundstück und Einbauten) zu einem Gesamtkaufpreis von EUR 11.643.000 veräußert. Parallel zu dieser Veräußerung hat die Gesellschaft die Einbauten sowie Grundstück und Gebäude für einen Zeitraum von 20 Jahren angemietet. Im Rahmen dieses Mietvertrags ist die Gesellschaft zu jährlichen, degressiv fallenden Gesamtmietzahlungen, beginnend mit einer Höhe von EUR 1.016.125 bis 2021 verpflichtet.

Im 4. Quartal des Geschäftjahres 2003 erfolgte die Fertigstellung der Aufstockung des Verwaltungsgebäudes. Die Gesamtinvestitionskosten betragen EUR 3.419.000. Die zu zahlenden Leasingraten betragen EUR 279.000 p.a. bis 2021.

Da die Gesellschaft ab 2021 die Möglichkeit hat, das Gebäude zurückzuerwerben, wurde diese Transaktion als Finanzierungstransaktion und nicht als Veräußerung erfasst, so dass das Gebäude und die Einbauten weiterhin in den vorliegenden Konzernabschlüssen erfasst werden. Der Finanzierungsbetrag ist unter der Position Finanzierungsleasing in den langfristigen Verbindlichkeiten erfasst.

Zinsaufwendungen für Verbindlichkeiten gegenüber Banken und langfristige Verbindlichkeiten betragen 2003 EUR 3.829.431 und 2002 EUR 3.870.847.

Zum 31. Dezember 2003 waren die Fälligkeiten für langfristige Verbindlichkeiten einschließlich Finanzierungsleasing wie folgt:

	Fälligkeit
	EUR
2004	4.017.395
2005	3.482.492
2006	3.081.781
2007	2.469.455
2008	1.532.088
Folgejahre	28.332.449
	42.915.660

6. Miet- und Leasingverträge

Die Gesellschaft hat unkündbare Miet- und Leasingverträge für Fahrzeuge und Geschäftsausstattung abgeschlossen.

Die Gesamtaufwendungen hierfür betragen 2003 EUR 5.937.454 und 2002 EUR 802.707. Zukünftige Mindestzahlungen aus unkündbaren Verträgen mit ursprünglichen Laufzeiten oder Restlaufzeiten von mehr als einem Jahr sind zum 31. Dezember 2003 wie folgt:

	Miet- und Leasingzahlungen ohne Finanzierungsleasing
	EUR
2004	10.908.734
2005	9.308.623
2006	13.101.080
2007	953.669
2008	146.043
Folgejahre	1.449.457
	35.867.606

7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag setzen sich in Deutschland aus Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag zusammen. Die Gesellschaft hat 2003 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag in Höhe von EUR 10.355.900 und 2002 in Höhe von EUR 3.058.187 gezahlt.

Die Aufwendungen (Erträge) aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag setzen sich wie folgt zusammen:

	2003	2002
	EUR	EUR
Steueraufwendungen		
Deutschland	5.561.662	6.674.270
Ausland	745.879	172.607
	6.307.541	6.846.877
Latente Steuern		
Deutschland	1.125.004	1.887.469
Ausland	(532.468)	(2.053.718)
	592.536	(166.249)
	6.900.077	6.680.628

Latente Steuern spiegeln die steuerlichen Auswirkungen aus zeitlichen Unterschieden zwischen den Buchwerten der Aktiva und Passiva in den handelsrechtlichen Abschlüssen einerseits und den in den steuerlichen Abschlüssen verwendeten Werten andererseits wider. Wesentliche Bestandteile der aktiven und passiven latenten Steuern der Gesellschaft sind im Folgenden dargestellt:

	31. Dezember 2003	2002
	EUR	EUR
Aktive latente Steuern:		
Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.196.932	3.325.557
Finanzierungsleasing	9.419.617	9.969.563
Verlustvortrag	12.399.459	11.998.442
	23.016.008	25.293.562
Passive latente Steuern:		
Rückstellungen	0	224.541
Anlagevermögen	7.999.916	9.644.300
Entwicklungskosten für eingebettete Software	1.854.494	750.334
Sonstige	452.224	761.151
	10.306.634	11.380.326
Aktive latente Steuern, netto	12.709.374	13.913.236

Die Unterschiede zwischen dem gesetzlichen Nominalsteuersatz und den von der Gesellschaft tatsächlich zu zahlenden Steuern vom Einkommen und vom Ertrag stellen sich wie folgt dar:

	2003	2002
Gesetzlicher Nominalsteuersatz	41,40%	39,90%
Steuerlich nicht abzugsfähige Abschreibungen auf Beteiligungen	0,60%	0,60%
Unterschiedsbetrag aus ausländischen Steuersätzen	-1,61%	0,40%
Sonstige	0,40%	2,08%
Effektiver Steuersatz	40,79%	42,98%

8. Grundkapital

Das Grundkapital der Gesellschaft besteht zum 31. Dezember 2003 und zum 31. Dezember 2002 aus 19.300.000 Aktien (ausschließlich Stammaktien).

9. Von der Altaktionärin ausgegebene Mitarbeiteraktien

Im Rahmen der Erstemission hat die EFH, die Hauptgesellschafterin der Gesellschaft, die Mitarbeiter der Gesellschaft berechtigt, eine bestimmte Anzahl von Stammaktien aus dem Eigentum der EFH als Ausdruck der Anerkennung der Verdienste der Mitarbeiter bevorzugt zu erwerben. Die Anzahl der bevorrechtigt zu erwerbenden Aktien bestimmt sich aus den Faktoren Betriebszugehörigkeit und dem aktuellen Monatsgehalt. Die EFH wird die Aktien in drei Tranchen, verteilt über einen Dreijahreszeitraum, an die Mitarbeiter ausgeben. Im Rahmen der Mitarbeiterbeteiligung hat die Gesellschaft 1999 EUR 3.259.486 als Aufwand für Mitarbeiteraktien angesetzt.

10. Aktienoptionsprogramm

Die Gesellschaft hat ein Aktienoptionsprogramm für Vorstandsmitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter. Ziel dieses Programms ist es, den Erfolg des Unternehmens dadurch zu sichern, dass die Mitarbeiter Aktien der Gesellschaft erwerben können. Im Rahmen des Programms ist die Gesellschaft zur Gewährung von 1.000.000 neuen Stückaktien berechtigt, von denen im Geschäftsjahr 1999 bereits 116.525 gewährt wurden.

Der Ausübungspreis entspricht 120 Prozent des durchschnittlichen Schlusskurses der Aktien der Gesellschaft an den zehn Handelstagen vor dem Vorstandsbeschluss über die Ausgabe und die Festlegung der Einzelheiten der jeweiligen Tranche. Die Optionen können nur ausgeübt werden, wenn der Schlusskurs der Aktien der Gesellschaft den Ausübungspreis erreicht oder ihn übersteigt. Die Optionen können bei ununterbrochener Betriebszugehörigkeit drei Jahre bzw. zwei Jahre (dritte Tranche) nach ihrer Gewährung ausgeübt werden und erlöschen nach sechs bzw. fünf (dritte Tranche) Jahren.

Zum 31. Dezember 2003 waren 102.222 ausübende Optionen zu einem Ausübungspreis von EUR 34,89 aus einer ersten Ausgabetranche im Umlauf. Aus einer zweiten Ausgabetranche waren 129.775 noch nicht ausübende Optionen zu einem Ausübungspreis von EUR 35,14 im Umlauf. Aus der im Dezember 2002 gewährten dritten Ausgabetranche zum Ausgabepreis von EUR 7,87 waren zum Stichtag noch 286.160 Optionen im Umlauf, die ebenfalls noch nicht ausübbar waren. Im Geschäftsjahr 2003 sind 1.003 Optionen aus der ersten Tranche verfallen; es wurden keine Optionen ausgeübt.

Zum 31. Dezember 2002 waren 103.225 noch nicht ausübende Optionen zu einem Ausübungspreis von EUR 34,89 aus einer ersten Ausgabetranche im Umlauf. Aus einer zweiten Ausgabetranche waren 129.775 noch nicht ausübende Optionen zu einem Ausübungspreis von EUR 35,14 im Umlauf. Im Geschäftsjahr 2002 sind 2.800 Optionen aus der ersten Tranche und 8.550 Optionen aus der zweiten Tranche verfallen; es wurden keine Optionen ausgeübt.

Die Bilanzierung für das Aktienoptionsprogramm erfolgt gemäß Accounting Principles Board Opinion Nr. 25 (APB Nr. 25). Gemäß APB Nr. 25 wurde für die ersten beiden Tranchen kein Aufwand für das Aktienoptionsprogramm in den Konzern-Gewinn- und Verlustrechnungen angesetzt. Für die dritte Tranche ergab sich 2003 ein Aufwand in Höhe EUR 100.800, der in die Kapitalrücklage eingestellt wurde.

Das Als-ob-Ergebnis, das unter der Annahme erstellt wurde, dass die Bilanzierung auf Grundlage des beizulegenden Wertes gemäß Financial Accounting Standards Nr. 123 „Accounting for Stock-Based Compensation“ (Bilanzierung von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen) erfolgt, stellt sich wie folgt dar:

Als-ob-Ergebnis	2003	2002
	EUR	EUR
Jahresüberschuss*	9.345.052	8.223.527
Jahresüberschuss* je Stammaktie		
Unverwässert	0,48	0,43
Voll verwässert	0,48	0,43

* unter Berücksichtigung FAS 123

Der durchschnittliche beizulegende Wert der Aktienoptionen betrug EUR 14,23 für die erste und zweite Tranche und EUR 4,40 für die dritte Tranche. Der beizulegende Wert am Tag der Gewährung wurde unter Anwendung der Black-Scholes-Methode zur Optionspreisberechnung auf Grundlage folgender Annahmen ermittelt:

Annahmen zur Ermittlung des beizulegenden Wertes	Tranche 1+2	Tranche 3
Dividendertrag	1,4 %	2,0 %
Erwartete Volatilität	61,7	59,1
Risikoloser Zinssatz zum Gewährungszeitpunkt	6 %	5,5 %
Erwartete Laufzeit in Jahren	5 Jahre	5 Jahre

Da die Gewährung weiterer Aktienoptionen in Folgejahren zu erwarten ist, lassen die oben genannten Als-ob-Werte keine Rückschlüsse auf die zukünftigen Beträge zu.

11. Ergebnis je Stammaktie

Das verwässerte und unverwässerte Ergebnis je Stammaktie wurde wie folgt ermittelt:

Abstimmung d. Aktien	2003	2002
Durchschnittliche Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Stammaktien	19.300.000	19.300.000
Aktienoptionen mit verwässerndem Charakter*	12.569	0
Durchschnittliche Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Stammaktien einschließlich Verwässerungseffekt	19.312.569	19.300.000

* berechnet nach der treasury stock Methode gem. SFAS 128.

12. Kumulierte erfolgsneutrale Veränderungen des Eigenkapitals

Die Position setzt sich aus erfolgsneutralen Nettoveränderungen (einschließlich Nettoerlösen) des Eigenkapitals zusammen, die nicht aus Transaktionen und Geschäftsvorfällen mit Gesellschaftern resultieren. Bei ELMOS setzen sich die erfolgsneutralen Veränderungen des Eigenkapitals im Wesentlichen aus Fremdwährungsanpassungen sowie nicht realisierten Gewinnen bzw. Verlusten aus den zur Veräußerung stehenden Wertpapieren des Umlaufvermögens zusammen.

Die kumulierten erfolgsneutralen Veränderungen des Eigenkapitals stellen sich wie folgt dar:

	2003	2002
	EUR	EUR
Fremdwährungsanpassungen	(1.507.480)	(425.076)
Nicht realisierte Gewinne aus zur Veräußerung stehenden Wertpapieren des Umlaufvermögens nach Steuern	(7.105.949)	(10.309.447)
Erfolgsneutrale Veränderungen des Eigenkapitals	(8.613.429)	(10.734.523)

13. Segmentinformationen und geographische Daten

Die Gesellschaft teilt ihre Aktivitäten in drei Bereiche ein: Das Halbleitergeschäft wird über die verschiedenen Länderniederlassungen in Deutschland, Frankreich und den USA abgewickelt. Umsätze im Mikromechanik-Sensorbereich erwirtschaftet die Tochtergesellschaft SMI in den USA. Schließlich werden Drittumsätze im Assembly-Bereich bei eurasem erzielt.

Segmentinformationen	Halbleiter	Mikromechanik	Assembly	Gesamt
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse, netto	107.740	9.304	4.351	121.395
Herstellkosten	49.631	6.160	4.200	59.991
Bruttoergebnis vom Umsatz	58.109	3.144	151	61.404
Betriebsergebnis	21.169	291	119	21.579
Umsatzerlöse mit anderen Segmenten	0	236	6.938	7.174
Gesamtvermögen	148.681	24.032	32.615	205.328
Investitionen in das Anlagevermögen	17.533	3.900	3.909	25.342
Abschreibungen	11.334	844	2.394	14.572



Die Gesamtumsätze mit anderen als den verbundenen Unternehmen entwickelten sich – unterteilt in geographische Regionen – in den Geschäftsjahren 2003 und 2002 wie folgt:

	2003	2002
	EUR	EUR
Deutschland	67.289.894	56.861.321
EU-Länder	29.388.986	30.809.026
USA	17.921.405	18.066.326
Sonstige	6.795.120	3.968.574
Gesamt	121.395.405	109.705.247

Zum 31. Dezember 2003 belief sich das bei den Tochtergesellschaften in den Niederlanden erfasste Anlagevermögen auf EUR 11.204.920, das bei den Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika erfasste Anlagevermögen auf EUR 13.059.486 und das bei den Tochtergesellschaften in anderen EU-Ländern erfasste Anlagevermögen auf EUR 122.487. Das Anlagevermögen in Deutschland betrug EUR 55.674.264.

14. Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr 2003 betrug die durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter im Konzern 874.

15. Immaterielle Vermögensgegenstände

Am 29. Juni 2001 veröffentlichte das U.S. Financial Accounting Standards Board die Statements Nr. 141, „Business Combinations“ und Nr. 142 „Goodwill and Other Intangible Assets“. Statement Nr. 141 änderte die Kriterien zur Unterscheidung immaterieller Vermögensgegenstände vom Geschäfts- oder Firmenwert. Gemäß Statement Nr. 142, werden der Geschäfts- oder Firmenwert sowie immaterielle Vermögensgegenstände mit einer unbestimmten Nutzungsdauer nicht mehr planmäßig abgeschrieben, sondern jährlich, bzw. beim Vorliegen von Hinweisen für eine entsprechende Notwendigkeit häufiger, auf eine außerplanmäßige Abschreibung hin überprüft.

Die Gesellschaft wendete diese Verlautbarung während des am 31. Dezember 2003 endenden Geschäftsjahres an. Die Anwendung der Verlautbarung führte dazu, dass keine planmäßigen Abschreibungen auf den Geschäfts- und Firmenwert vorgenommen wurden. Darüber hinaus, wurde 2003 eine Prüfung bezüglich der Notwendigkeit außerplanmäßiger Abschreibungen vorgenommen, die keinen entsprechenden Wertberichtigungsbedarf ergab.

Die Gesellschaft weist per 31. Dezember 2003 und per 31. Dezember 2002 einen Geschäfts- oder Firmenwert in Höhe von EUR 7.622.344 aus.

16. Akquisitionen

European Semiconductor Assembly (eurasem) B.V.

Am 8. Januar 2001 hat die Gesellschaft einen Anteil von 95,84 Prozent bzw. 8.658.365 Aktien der European Semiconductor Assembly (eurasem) B.V., einer Assemblierungsfirma für Halbleiter mit Sitz in Nijmegen, Niederlande, erworben. eurasem hat weitere Anteile von 2,66 Prozent, die sich noch im Streubesitz befanden, zurückerworben und auf die Gesellschaft übertragen. Der Gesamtkaufpreis für 100 Prozent des Anteils betrug 12.000.000 niederländische Gulden (EUR 5,45 Mio.). Das Finanzergebnis und die Bilanz von eurasem wurden in die Konzernabschlüsse der Gesellschaft zum 31. Dezember 2001 aufgenommen. Die Gesellschaft hat die wirtschaftlichen Aktivitäten von eurasem für das gesamte Geschäftsjahr in ihre Gewinn- und Verlustrechnung übernommen. Aus dieser Akquisition ergab sich kein Geschäfts- oder Firmenwert.

Silicon Microstructures, Inc. (SMI)

Am 31. März 2001 hat die Gesellschaft 100 Prozent bzw. 1.000.000 Stammaktien und 190.909 Vorzugsaktien der Silicon Microstructures, Inc. (SMI), einem Entwickler von Sensortechnologie mit Sitz in Fremont, Kalifornien, USA, erworben. Der Gesamtkaufpreis der Aktien betrug USD 6,0 Mio. (EUR 6,8 Mio.). Die erworbenen Aktiva und Passiva von SMI wurden zu zum Akquisitionszeitpunkt geschätzten oder von der Unternehmensführung der Gesellschaft bestimmten Marktwerten verbucht. Der sich ergebende Geschäfts- oder Firmenwert in Höhe von EUR 7.590.639 wird seit dem 1. Januar 2002 nicht mehr planmäßig über 40 Jahre abgeschrieben. Das Finanzergebnis und die Bilanz von SMI wurden erstmals in die Konzernabschlüsse der Gesellschaft zum 1. April 2001 aufgenommen.

Gärtner Electronic Design GmbH (GED)

Zu einem Zeitpunkt vor dem 31. Dezember 2001 erwarb die Gesellschaft 49 Prozent bzw. 65.273 Gesellschaftsanteile der Gärtner Electronic Design GmbH (GED), einem Designhaus für Halbleiter, zu einem Gesamtkaufpreis von EUR 386.724. Am 28. Juni 2002 erwarb die Gesellschaft weitere 25 Prozent bzw. 34.768 Gesellschaftsanteile für einen Gesamtkaufpreis von EUR 412.746. Das Jahresergebnis und die Bilanzdaten wurden mit Wirkung vom 28. Juni 2002 im Konzernabschluss der Gesellschaft konsolidiert. Sechs Monate der betrieblichen Aktivitäten der GED wurden in die Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2002 aufgenommen. Aus der Akquisition resultierte kein Geschäfts- oder Firmenwert. Der Einfluss auf den Jahresüberschuss für die nicht eingeschlossenen sechs Monate ist nicht wesentlich.

17. Bezüge der Leitungsorgane

Entsprechend den Vorgaben des Deutschen Corporate Governance Kodex macht die Gesellschaft die folgenden Angaben:

Bezüge für 2003	Vorstand	Aufsichtsrat
	EUR	EUR
Fixe Bezüge	798.000	*90.120
Variable Bezüge	447.000	67.500
Aktienoptionen	60.000	0

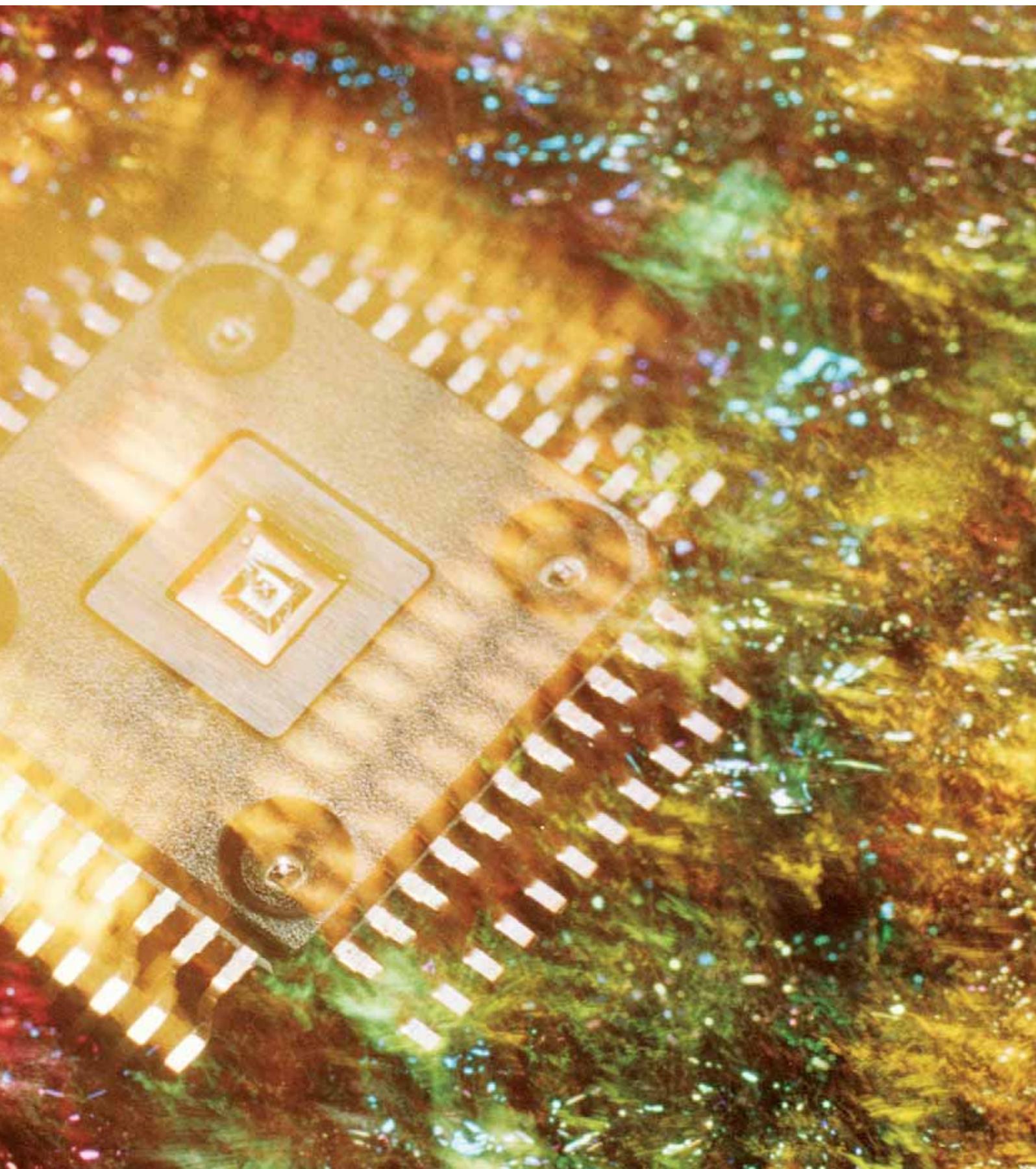
* inkl. Spesen und Auslagen

Entwicklung des Konzernanlagevermögens 31. Dezember 2003

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				
	01.01.2003	Fremd- währungs- anpassung	Zugänge	Um- buchungen	Abgänge
A.I. Immaterielle Vermögens- gegenstände					
Goodwill	7.757.079	0	0	0	0
Software	14.239.931	(263.013)	5.107.828	4.306.781	(1.891.018)
Anlagen im Bau	11.276.115	0	245.897	(4.306.781)	0
	33.273.125	(263.013)	5.353.725	0	(1.891.018)
A.II. Sachanlagen					
1. Grund und Boden					
Grundstücke	4.432.392	(362.991)	1.811	2.494.274	0
Gebäude und Einbauten	56.068.821	(845.357)	6.403.310	(1.440.977)	0
2. Technische Anlagen und Maschinen					
Technische Anlagen und Maschinen	112.869.248	(865.927)	5.786.529	10.021.402	(31.493.919)
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
Anlagen im Bau	15.824.461	0	7.796.451	(11.074.698)	(6.326.711)
	189.194.922	(2.074.275)	19.988.101	0	(37.820.629)
Summe	222.468.047	(2.337.288)	25.341.827	0	(39.711.647)

31.12.2003	Kumulierte Abschreibungen						31.12.2003	Buchwerte 31.12.2003
	01.01.2003	Fremd- währungs- anpassung	Zugänge	Um- buchungen	Abgänge			
7.757.079	134.735	0	0	0	0	134.735	7.622.344	
21.500.510	6.232.719	(12.371)	2.481.819	0	(1.256.397)	7.445.770	14.054.740	
7.215.231	0	0	0	0	0	0	7.215.231	
36.472.820	6.367.454	(12.371)	2.481.819	0	(1.256.397)	7.580.505	28.892.315	
66.751.282	18.198.172	(12.560)	3.124.027	0	0	21.309.638	45.441.644	
6.565.486	0	0	0	0	0	0	6.565.486	
60.185.797	18.198.172	(12.560)	3.124.027	0	0	21.309.638	38.876.158	
96.317.333	67.556.046	(132.762)	8.965.784	0	(8.471.744)	67.917.324	28.400.010	
96.317.333	67.556.046	(132.762)	8.965.784	0	(8.471.744)	67.917.324	28.400.010	
6.219.503	0	0	0	0	0	0	6.219.503	
6.219.503	0	0	0	0	0	0	6.219.503	
169.288.119	85.754.217	(145.322)	12.089.811	0	(8.471.744)	89.226.962	80.061.157	
205.760.939	92.121.672	(157.693)	14.571.630	0	(9.728.141)	96.807.467	108.953.472	







Die Vision

Unter der Devise „Alles aus einer Hand“ bietet ELMOS schon jetzt integrative Ansätze für die Verknüpfung von Halbleiter-, Sensor- und Verpackungstechnologien. Mit ASIC *plus* erfüllt ELMOS das Kundenbedürfnis, „mehr als einen Halbleiterchip“ zu erhalten. Die Voraussetzungen für weitere maßgeschneiderte Lösungen mit noch anspruchsvolleren Anforderungen für den morgigen Bedarf sind bereits geschaffen. Die ELMOS-Vision einer zukunftsweisenden Systemintegration gewinnt Konturen und eröffnet neue Horizonte.

Analog · Analoge elektronische Bausteine erfassen Zustände, wie z.B. Bewegungen, Temperaturen und Geräusche, und wandeln diese in proportionale elektrische Signale um.

Assembly · Weiterverarbeitung der Wafer zu einem verpackten Chip.

ASIC · Application Specific Integrated Circuit = Anwendungsspezifischer integrierter Schaltkreis. Bezeichnet einen Chip, der für einen bestimmten Kunden und eine spezielle Anwendung entwickelt wurde.

ASSP · Application Specific Standard Product = Anwendungsspezifisches Standard Produkt, bezeichnet Chips, die für spezielle Applikationen entwickelt wurden und universell verkauft werden können.

Backend · Halbleiter-Produktionsbereich, in dem die elektrische Funktion auf Waferebene bzw. am verpackten Chip getestet werden.

ASSP · Bipolar CMOS DMOS. BCD verknüpft die Basiselemente der Bipolar, der CMOS und der DMOS (double-diffused MOS Prozesstechnologien zu einer komplexen und universelleren Halbleitertechnologie.

Burn-in · Methode zur künstlichen Alterung von elektronischen Schaltungen und Bauelementen, um Frühdefekte zu entdecken.

Bus · Ein gemeinsam genutztes Kommunikationssystem, welches den Austausch von elektronischen oder optischen Informationen erlaubt.

Chip · Ein elektronischer Schaltkreis, der in Halbleitermaterial realisierte Funktionen beinhaltet.

CMOS · Complementary Metal Oxide Semiconductor = komplementäre Metall-Oxid-Halbleiter. Basistechnologie zur Herstellung von Mikrochips mit hohem Integrationsgrad und geringem Energieverbrauch.

Digital · Digitale Signale werden aus binären Informationen (Nullen und Einsen) zusammengesetzt.

DRAM · Dynamic Random Access Memory = Dynamischer, im Zugriff frei wählbarer Speicher. Der am häufigsten eingesetzte Speichertyp in Computern usw. DRAM-Bausteine verlieren ihren Dateninhalt, wenn der Strom abgeschaltet wird.

Drehrate-Sensor · Drehrate-Sensoren sind mechanisch oder mikromechanisch aufgebaute Sensoren, die unter Analyse der Corioliskraft Dreh- und Schlingerbewegungen beispielsweise von Kraftfahrzeugen oder Flugzeugen erkennen können.

Elektronischer Schaltkreis · Ein Zusammenschluss verschiedener elektrischer Komponenten, die eine bestimmte Funktion in einem elektrischen System übernehmen.

Frontend · Halbleiter-Produktionsbereich, in dem Anlagen und Verfahren für die Herstellung der einzelnen Elemente einer integrierten Schaltung auf einem Wafer benutzt werden.

Gyro · Abkürzung für Gyroscope, siehe Drehrate-Sensor.

Halbleiter · Ein Festkörpermateriale, das physikalisch modifiziert seine elektrischen Eigenschaften ändern kann.

Integrierte Schaltung, IC · Eine elektronische Schaltung, die aus verschiedenen, miniaturisierten elektronischen Bauelementen besteht, welche in einem Halbleitermaterial integriert wurden.

Interface · Bestimmt die Schnittstelle zwischen verschiedenen Systemen und kontrolliert die Verbindung, die Aktionen und den Transfer von Informationen zwischen den Teilsystemen.

JEDEC · Joint Electron Devices Engineering Council, Standardisierungsgremium für Gehäusebauformen.



Layout · Beschreibt mit einfachen geometrischen Formen die zur Herstellung von integrierten Schaltungen benötigten Informationen aus der Schaltungsentwicklung.

LCD · Liquid Crystal Display = Flüssigkristallanzeige, stromsparende Anzeige von Informationen, z.B. beim Mobiltelefon.

Logik · Eine Ansammlung von Transistoren und anderen Bauelementen in einem Schaltkreis, die Boolesche Logikoperationen darstellen, wie z.B. UND, ODER, NICHT, WENN usw.

MEMS · Mikro-Elektronische-Mechanische Systeme

Mikrometer · $1\mu\text{m} = 10^{-6}\text{m}$ = der einmillionste Teil eines Meters.

Mikroprozessor · Eine integrierte elektronische Einheit, die ein elektronisches System kontrolliert und betreibt. Mikroprozessoren sind die zentralen Gehirne komplexer Systeme, wie z.B. Computer.

Mixed-Signal · Eine Kombination von analogen und digitalen Signalen, die gleichzeitig auf ein und demselben Chip generiert, kontrolliert oder modifiziert werden.

MOS · Metal-Oxide-Semiconductor = Metall-Oxid-Halbleiter. Beschreibt den Aufbau des zentralen Kontrollelements für den Feldeffekt in einer speziellen Klasse von Halbleitertransistoren.

OEM · Original Equipment Manufacturer = Erstausrüster oder Zulieferer. Ein Hersteller, der (Teil-) Systeme an einen Wiederverkäufer vertreibt.

ppm · parts per million = eins aus einer Million.

Reinraum · Ein abgeschlossener Gebäudebereich, in dem die Luftfeuchtigkeit, die Temperatur und die Verunreinigungen durch Staubpartikel sehr genau eingehalten und kontrolliert werden.

Sensor · Eine elektrische Baugruppe, die eine reale physikalische Größe, z.B. Bewegung, Hitze oder Licht misst, oder erkennt und anschließend in eine analoge oder digitale Größe umwandelt, beispielsweise in ein elektrisches Signal.

Silizium, Si · Das am häufigsten benutzte Halbleitermaterial, welches für etwa 95 Prozent aller hergestellten Chips eingesetzt wird.

Smart-Power · Symbolisiert den intelligenten Einsatz höherer Spannungen und Ströme in einer elektrischen Schaltung. Bei Smart-Power können Spannungen bis zu einigen 100V sowie die Ströme bis zu einigen 10A auf dem Chip realisiert werden.

SOI · Silicon-on-Insulator = Silizium auf Isolator, Spezielles Ausgangsmaterial für die Halbleiterherstellung, welches eine perfekte vertikale Isolierung mittels nichtleitender Zwischenschichten aufweist.

Transistor · Transfer Resistor = gesteuerter Übergangswiderstand. Grundbauelement der Halbleiterschaltungstechnik für die Verstärkung bzw. zum Schalten von elektronischen Signalen.

UMTS · Universal Mobile Telecommunications System = Universale Telekommunikationssysteme, mit denen künftig Fotos, Straßenkarten und sogar Filme problemlos übertragen werden können.

Wafer · Ausgangsmaterial in der Chipherstellung. Es handelt sich dabei um eine etwa 0,3 bis 1mm dicke Scheibe, die aus einem Siliziumeinkristall gesägt und anschließend poliert worden ist. Typische Durchmesser betragen 150, 200 bzw. 300 mm.

Finanzkalender 2004

Vorläufiges Ergebnis 2003	11.02.2004
Ergebnis 2003	17.03.2004
Bilanzpressekonferenz in Frankfurt und Dortmund	17.03.2004, 10.00 Uhr
Analystenkonferenz in Frankfurt	17.03.2004, 14.00 Uhr
Hauptversammlung in Dortmund	27.04.2004
Quartalsergebnis Q1/2004	12.05.2004
Quartalsergebnis Q2/2004	11.08.2004
Quartalsergebnis Q3/2004	10.11.2004
Analystentag „Chips & More“ in Dortmund	16.11.2004 (geplant)

Impressum

Herausgeber:

ELMOS Semiconductor AG

Heinrich-Hertz-Str. 1

44227 Dortmund

www.elmos.de

Investor Relations Team:

Telefon: 0231 / 7549 – 0

Telefax: 0231 / 7549 – 548

e-mail: invest@elmos.de

Gestaltung:

Innovative Communications GmbH

Düsseldorf

Elke Herzog · Idee und Konzept

Andrea Wark · Grafik Design

Georg Steffens · DTP

